

盛群半導體股份有限公司

一〇六年度年報

刊印日期：中華民國一〇七年四月三十日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://www.holtek.com.tw>

一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓名：李佩縈
職稱：資源管理中心副總經理
聯絡電話：(03)563-1999
電子郵件信箱：pattyli@holtek.com.tw

二、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓名：蔡榮宗
職稱：業務行銷中心副總經理
聯絡電話：(03)563-1999
電子郵件信箱：armstro@holtek.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹市科學園區研新二路 3 號
電話：(03)563-1999
分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座
Block A, 3/F Tin On Industrial Building
777-779 Cheung Sha Wan Rd.
Kowloon, Hong Kong
電話：852-2745-8288
台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2
電話：(02)2655-7070
大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司
中國東莞松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(總部壹號 10 號樓)
電話：86-769-2626-1300

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市博愛路 17 號 3 樓
網址：www.sinotrade.com.tw
電話：(02)2381-6288

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：曾漢鈺會計師、游萬淵會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓 (台北 101 大樓)
網址：www.kpmg.com.tw
電話：(02)8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

七、公司網址

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一〇六年度年報

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
參、公司治理報告	
一、組織系統	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料	8
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
四、公司治理運作情形	18
五、會計師公費資訊	42
六、更換會計師資訊	42
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形	42
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	43
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊	44
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	45
肆、募資情形	
一、資本及股份	47
二、公司債	52
三、特別股	52
四、海外存託憑證	52
五、員工認股權憑證	52
六、限制員工權利新股	52
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	52
八、資金運用計畫執行情形	52

伍、營運概況

一、業務內容-----	53
二、市場及產銷概況-----	70
三、從業員工-----	78
四、環保支出資訊-----	78
五、勞資關係-----	78
六、重要契約-----	81

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表-----	82
二、最近五年度財務分析-----	86
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告-----	88
四、最近年度財務報告-----	88
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告-----	88
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財 務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	88

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	191
二、財務績效-----	192
三、現金流量-----	193
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	193
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫-----	193
六、風險事項分析-----	194
七、其他重要事項-----	195

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	196
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	204
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票 情形-----	204
四、其他必要補充說明事項-----	204
五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	204

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

盛群半導體股份有限公司（以下簡稱本公司）是國內外專業微控制器（MCU）IC 設計領導廠商之一，產品主要包括 8 位元與 32 位元 MCU IC 及其周邊元件之設計、研發與銷售。本公司自 1998 年成立以來，不斷致力於新 IC 產品的研發與技術的創新，加上對終端市場趨勢的密切掌握，才能持續推出電子產品應用所需最具市場競爭力之 MCU 及周邊 IC 與解決方案。

國際貨幣基金（IMF）原先公佈對於 2017 年全球經濟成長的預測是屬於低成長的年度，加上各國貨幣競貶與貿易保護主義抬頭，以及中國十三五對於半導體產業的重點投入，對於全球半導體產業的供需生態產生極大影響；所幸本公司始終秉持專注在『微控制器（MCU）及微控制器周邊元件（MCU Peripherals）』為發展主軸，不斷發揮與提升專業 MCU 公司形象，並擴大 MCU 的應用領域與服務層次創造更多的價值及市場發展空間，讓本公司營收及獲利在 2017 年均締造了雙位數成長的佳績，實屬非常難得的一年。

2017 年本公司全年營收達到新台幣（以下同）46.15 億元；較 2016 年的 41.58 億元成長 11%，毛利率維持 46% 以上水準；歸屬母公司稅後淨利達 9.26 億元較前一年度 7.84 億元增加 18%，每股稅後盈餘 4.10 元較 2016 年 3.47 元亦高出 18%，營收和獲利金額均創下本公司上市掛牌以來的新高。同時本公司的 MCU IC 年度營收首度突破 30 億元關卡，重點產品之一的觸控應用 MCU 年度出貨數量也超過壹億顆，32 位元 MCU 亦達到年銷千萬顆以上的佳績；以上成績在在反應本公司無論在產品開發、銷售通路、產品品質與技術服務等各方面普遍獲得全球客戶與市場的肯定，2017 年盛群（Holtek）品牌知名度與形象均有大幅提升。

2017 年本公司整體營運的概況，分別從產品開發／業務／生產等方面簡要說明如下：

產品開發方面：

2017 年本公司產品開發主要著重於穿戴產品周邊零件整合、健康量測、智能家居及安全防护等應用產品，以公司自有 HT 8 位元與 32 位元（M0+／M3）為核心開發一系列 STD／ASSP／ASIC MCU；在 2017 年共推出了 62 項各類型新的 MCU 及周邊 IC，主要新產品有：無線傳輸應用 MCU（包括 8 位元低功耗藍牙透傳 MCU、32 位元藍牙透傳 MCU、Sub 1Ghz 傳輸及接收 IC）、各式 32 位元 MCU、快充及無線充電專用 MCU、健康量測專用 MCU（包括體脂秤／血糖計／廚房秤／血壓計）、居家安防應用的煙感器／消防／紅外偵測等專用 MCU，另外還包括 DC 無刷／DC 有刷馬達控制的專用 MCU 與驅動 IC 等，上述新推出的 IC 產品將陸續於 2018 年對本公司的營收增添更多的動能。

業務方面：

本公司 2017 年度營收來自中國大陸及香港地區佔比 72%，臺灣地區營收佔比 12%，其它海外地區佔比 16%；整體而言，臺灣地區的營收與 2016 年相比持平，海外地區則小幅成長 4%，主要的營收增長來自日／韓／東南亞／美國／中南美等國家；表現最好的大陸地區則有約 15% 的成長，主要原因除大陸仍是全球消費性電子產品生產製造最大的區域外，中國龐大且強勁的內需，對 IC 需求亦為全球最大的市場，並加上本公司產品銷售渠道深入大陸布局與技術服務到位所致。

生產方面：

2017 年度本公司 IC 出貨量成長約 19%，惟產品多為客製化與多樣差異化，出貨高達 800 多項的產品組合，少量多樣化特殊的生產模式，在晶圓半成品與封裝成品上均無法準確預先建立足夠庫存，加上晶圓產能緊張並因缺料上漲，對晶圓計劃生產與測試封裝等委工作業的調配，在 2017 年同樣面臨高度困難的情況；有賴生產單位與上下游廠商密切配合均能順利達

成業務與客戶端的交貨需求，並維持供貨及交期的穩定，生產單位及上下游廠商對本公司 2017 年營收成長有很優異的貢獻。

2018 年主要營運重點：

2018 年度從 IMF 與世界銀行提出的展望報告預估全球經濟成長性較 2017 年略好，美國經濟由於稅改及貿易政策，企業營運預測持續看好，同時新興市場也仍會有較佳的經濟增長，因此整體來看 2018 年將是正向發展的一年。從半導體產業方面觀察，2017 年由於記憶體／車載／智慧家庭等應用領域蓬勃發展下，全球半導體產值突破四千億美元，年度增加將近 20%，這是歷年罕見的狀況，因此產業相關的專業預測機構仍預期半導體市場 2018 年可望在記憶體／車載／智慧家庭／健康量測等應用強烈需求下將會繼續成長；但 2018 年並不盡然全是前述的各項增長利多，半導體市場仍存在許多不利因素，包括矽晶圓產能不足，矽晶圓成本不斷攀升，以及大陸半導體在提升自給率不斷大幅擴充產能下，將對全球半導體產業發展投下不確定的震撼彈，臺灣半導體產業與本公司都需特別留意產業環境變化。

產品開發主要重點包括觸控／健康量測／RF 無線通訊／安全防護／圖像辨識／四錶／智能玩具及應用模組等，著手開發相關的 MCU／Peripherals／SOC，同時也針對量測產品全面進行升級，並開發相關感測模塊，與提升 MCU 車載規格及超低功耗 MCU 等開發工作。

業務方面，積極推廣現有 MCU 及 Peripheral IC 產品在家電／居家／個人穿戴／鋰電池手持應用／車載／各類儀表等領域，持續深入與擴大市場找出更多客戶，除努力推廣歐／美／日／韓等國家的客戶外，並加強開拓新興發展中國家的新市場與新客戶。2018 年業務布局重點之一是建立印度在地的銷售推廣與技術服務據點，拓展印度市場對本公司降低產品銷售過度集中在中國的風險至為重要，並可藉以擴大全球市場持續增加營收。

生產方面，2018 年面臨矽晶圓成本的攀升將是一項極大的壓力，除不斷開發與推出更有競爭力的新產品外，本公司生產單位積極與長期往來之上下游廠商密切配合，取得廠商合理價格及充足產能的支持，生產成本增加的部份藉由內部管理機制做最佳化的安排，並以滿足客戶訂單需求為優先考量，本公司生產單位已有充足的準備措施以因應各種生產作業變化及困難。

2018 年產品開發／業務／生產各方面運作不斷提升，本公司仍然秉持一貫穩健且積極務實的做事理念，與認真勤奮的工作態度執行各項作業目標，絕不怠懈；全球經濟的發展雖呈現正向發展，但面臨中國半導體產業強勢競爭及挑戰，本公司認為 2018 年只要經營團隊與全體同仁落實設定的工作目標全力以赴，相信仍應能繼續創造出公司向上成長的成績。

本公司衷心感謝各位股東長期給予的信賴與支持，讓經營團隊有信心持續深耕 MCU 領域，持續創造穩定成長的獲利回饋給所有股東。

祝福全體股東 健康如意、旺年旺旺、財源廣進！

董事長 吳啟勇



總經理 高國棟



貳、公司簡介

一、 設立日期：民國八十七年十月一日。

二、 公司沿革

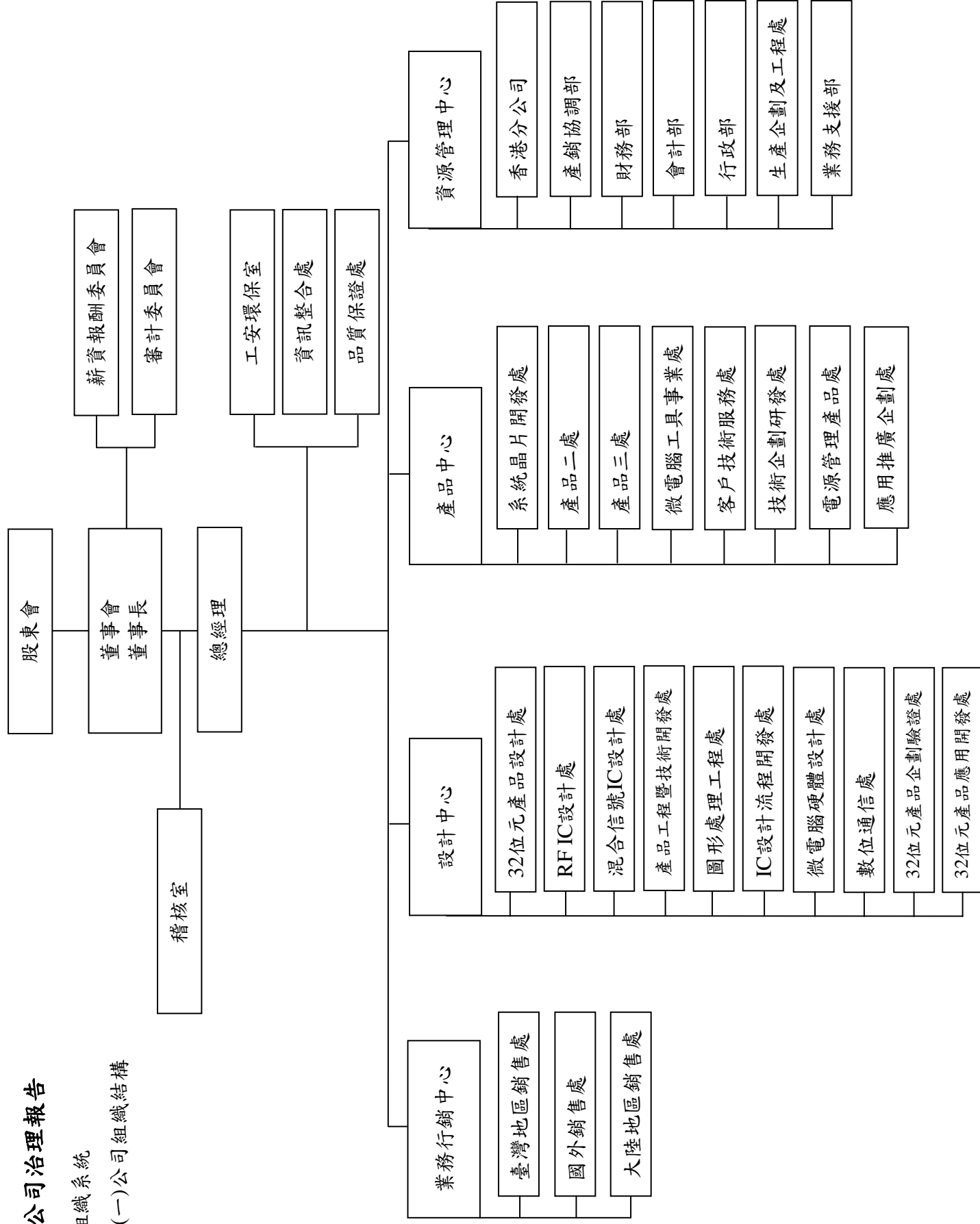
民國八十七年	十月	盛群半導體公司成立，設立實收資本額新台幣四億元。
民國八十八年	三月	現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。
民國八十九年	三月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit OTP MCU。
	四月	設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。
	五月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。 通過國際 ISO 9001 品保認證。
民國九十年	三月	設立上海子公司（盛揚半導體（上海）有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	五月	設立美國子公司（Holtek Semiconductor（USA）, Inc.），從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
民國九十一年	八月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。
	十月	投資蘇州子公司（金科集成電路（蘇州）有限公司），負責大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	十一月	股票正式櫃檯買賣。
民國九十二年	七月	通過國際 ISO 14001 環境管理系統驗證。
	八月	取得 SONY”Green Partner”認證。
	九月	獲頒經濟部第十二屆國家發明獎。
民國九十三年	九月	股票正式上市買賣。
	十二月	GSA 頒發 Outstanding Financial Performance Award。
民國九十四年	六月	取得華碩”Green Partner”認證。
	九月	取得經濟部核定在臺設立研發中心計劃。
	十月	取得三星電子”ECO Partner”認證。
	十一月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於臺灣地區舉行。
	十二月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
民國九十五年	五月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於大陸地區舉行。
	十一月	通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。
民國九十六年	一月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit Flash MCU。
	五月	通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。
	十二月	Holtek 無線 USB 語音傳輸晶片 HT82A850R/HT82A851R 榮獲中國電子業界創新大獎。
民國九十七年	二月	投資廈門子公司（芯群集成電路（廈門）有限公司），負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。
民國九十九年	一月	推出公司第一顆整合型 8-bit Touch Flash MCU。
民國一〇〇年	五月	盛揚半導體（上海）有限公司遷移至深圳，更名為盛揚半導體（深圳）有限公司，從事大陸地區 IC 銷售及技術支持服務。
	六月	推出公司第一顆 Arm® Cortex™ -M3 32-bit Flash MCU。
	七月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十月	推出 Touch Key Flash MCU with LED / LCD Driver。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 18 名。

- 民國一〇一年 六月 設立東莞子公司（合泰半導體（中國）有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 14 名。
101 年度新推出產品：
1. Smoke Detector ASSP Flash MCU。
2. Power Bank ASSP Flash MCU。
- 民國一〇二年 十一月 通過 WPC 聯盟 Qi 標準。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 12 名。
102 年度新推出產品：
1. 20-bit A/D + LCD Flash MCU。
2. Blood Pressure Meter ASSP Flash MCU。
3. Glucose Meter ASSP Flash MCU。
- 民國一〇三年 七月 推出全球最薄 6.5mm 及 4.9mm 光學式指紋辨識系列產品。
全球第五家擁有 UL 60730-1（家庭用電器用品安全機制）軟體認證的半導體公司。
取得經濟部核定在臺設立營運總部。
- 十一月 無線充電微控制器 IC 取得 WPC 無線充電聯盟 Qi 規格認證。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 12 名。
103 年度新推出產品：
1. 1.8V~5.5V Flash MCU。
2. 24-bit A/D LCD Flash MCU。
3. Wireless Power Transmitter（Qi）ASSP Flash MCU。
4. Body Fat ASSP Flash MCU。
- 民國一〇四年 三月 獲選第三屆中堅企業潛力企業。
- 十二月 盛群盃 HOLTEK MCU 創意大賽邁入第十屆擴大舉辦。
104 年度新推出產品：
1. 全球最薄 1mm，擁有超高解析度且唯一量產的光電混合式指紋辨識感測器。
2. Arm® Cortex™ -M0+ 之 32 位元 Flash MCU。
3. Fast Charge Power Bank MCU。
- 民國一〇五年 二月 盛群宣佈與 Sony Mobile 簽署合作意向書
105 年度新推出產品：
1. 96MHz 高效能 Arm® Cortex™ -M3 32 位元 Flash MCU。
2. BLE 透傳模組。
3. Sub-1GHz Tx/Rx SoC & IC。
- 民國一〇六年 四月 榮獲第三屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。
- 七月 取得經濟部核定在臺設立營運總部。
106 年度新推出產品：
1. 一系列 Arm® Cortex® -M3 MCU、M0+ 5V MCU 及 Bridge MCU。
2. A/D NFC™ MCU、Sub-1 GHz 超再生 Rx SoC MCU 及長距離 LoRa® 等產品。
3. USB Type-C PD ASSP MCU 及 15W 無線充電 Tx ASSP MCU。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一) 公司組織結構



(二)各主要部門所營業務

部 門	主要職掌
稽核室	全公司業務及行政之稽核。
工安環保室	工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。
資訊整合處	(A)規劃及維護公司網路資訊流動環境、硬體設施。 (B)研究開發並建立相關之資訊系統。
品質保證處	進出貨檢驗，外包廠品質監控、評鑑，品質活動推行，儀器校正作業，產品可靠度測試及客訴服務。
臺灣地區銷售處	臺灣地區產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。
國外銷售處	海外地區技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推廣銷售與服務。
大陸地區銷售處	大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。
32 位元產品設計處	(A)32 位元微處理器之相關 IP 設計開發與建立。 (B)32 位元微處理器之相關 IC 設計與整合。 (C)撰寫設計報告、偵錯報告、及設計驗證報告。 (D)產生量產測試 patterns。 (E)將設計轉至 FPGA 平台，驗證人員進行仿真。
RF IC 設計處	(A)無線射頻接收機系統設計。 (B)無線射頻接收機 IC 設計、整合和研發。 (C)射頻 IC IP 研發。
混合信號 IC 設計處	(A)Analog IC/IP 技術評估及電路設計。 (B)Memory IC/IP 技術評估及電路設計。 (C)Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (D)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch-up Cell 標準化。
產品工程暨技術開發處	(A)靜電防護工程：新製程 ESD 元件/Latch-up Rule 評估、新專案 ESD/System ESD 方案與改善、ESD 元件驗證、測試與使用管制。 (B)產品工程：產品生產良率提升、產品生產製造管理、新製程(含衍生性)產品下線管控、新製程評估與導入、專案產品下線管控、Shuttle 與 MPW 支援。
圖形處理工程處	(A)圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B)光罩委外製作及圖形佈局工作。
IC 設計流程開發處	(A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。
微電腦硬體設計處	MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。
數位通信處	數位信號處理器開發、數位信號處理演算法開發、通信系統架構分析與模擬、數位調變/解調技術開發、基頻資料封包處理/鏈結層控制器開發。
32 位元產品企劃驗證處	負責 32 位元微處理器產品企劃工作，制定規格並執行相關功能驗證。
32 位元產品應用開發處	提供 32-bit MCU 平台之軟韌體及應用增值服務。
系統晶片開發處	(A)影像及音頻訊號處理的系統技術建立與 SOC 開發。 (B)影像及音頻訊號處理的資料儲存與傳輸的相關技術建立。

部 門	主要職掌
產品二處	負責 HT8 8-bit MCU 標準 MCU 與 ASSP MCU 之市場調查、規劃與開發管控、推廣及產品管理。
產品三處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU、MCU 週邊相關 ASIC 等 IC 產品開發技術，前瞻產品技術之搜尋，關鍵技術研究，關鍵性 IP 建立。 (B)VFD/LED/LCD Display Controller/Driver IC 的相關規格制定、設計開發、產品驗證及軟、硬體技術支援。
微電腦工具事業處	專案技術開發、新技術評估與導入、工具開發技術評估；客服問題處理、落實改善計畫；實驗室維護管理、零件採購與寄送。
客戶技術服務處	對客戶需求提供技術及產品應用整合工作。
技術企劃研發處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU 等相關 IC 產品開發技術相關事宜，包含產品系統技術分析、IC 市場與技術開發評估、IC 規格技術企劃、IC 應用驗證、產品系統驗證、產品應用開發、技術文件及後續產品推廣技術服務等事項。 (B)前瞻產品技術之搜尋、關鍵技術研究、關鍵性 IP 建立與提升產品層次及競爭力。
電源管理產品處	(A)電源管理/白光 LED 背光/LED 照明/Motor Driver 相關產品市場企劃、系統規劃及新產品推廣。 (B)DC-DC PWM Buck Regulator、Boost Regulator、AC-DC Converter IC 設計開發及產品驗證。
應用推廣企劃處	(A)網站美術設計及運作維護。 (B)推廣文件、影片美術設計。 (C)技術文件編譯及翻譯。 (D)產學合作及相關活動企劃。
香港分公司	從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。
產銷協調部	(A)產銷協調，訂單交期及訂單監控。 (B)配貨出貨及貨源調配安排。
財務部	資金管理、客戶信用管理、進出口保稅業務、股務及投資人關係相關作業處理。
會計部	會計帳務處理、預算管理、轉投資管理及財務報表分析。
行政部	人事、教育訓練、總務、採購及員工福利等相關事務；法律事務、智慧財產權建立與維護及各項諮詢服務。
生產企劃及工程處	統籌委外採購及封裝/測試委工、倉儲/物流管理、工具製造、封裝/測試工程等作業事宜。
業務支援部	產品庫存之調節管理、業務資訊分析及產品訂價與成本管理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

日期：107年3月30日 單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	吳敬勇	男	1050527	3年	870907	7,665,809	3.39%	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	-	-	逢甲大學電子工程系 盛群公司董事長	盛群公司董事長 Holek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd、BestComm RF Electronics Inc.等公司之法人董事代表人、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、盛通科技、優方科技、倍創科技等公司之董事長	無	-	-
董事	中華民國	高國棟	男	1050527	3年	870907	6,701,176	2.96%	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子工程師 盛群公司總經理	盛群公司總經理 Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、悠健電子(東莞)、盛通科技、倍創科技等公司之法人董事代表人、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長	無	-	-
董事	中華民國	張治	男	1050527	3年	930601	1,111,785	0.49%	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所 盛群公司設計及產品中心執行副總	盛群公司設計及產品中心副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公司之法人董事代表人	無	-	-
董事	中華民國	林正鋒	男	1050527	3年	870907	1,842,697	0.81%	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系 盛群公司總經理室副總經理	盛群公司總經理室副總經理 Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、香港新崇、新緯科技(深圳)公司之法人董事代表人	無	-	-
董事	中華民國	李佩蓉	女	1050527	3年	990615	1,013,093	0.45%	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企管所 盛群公司資源管理中心副總經理	盛群公司資源管理中心副總經理 Holek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、盛凌投資、Samtek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、Truetek Technology Ltd.、信霖電子商貿(上海)、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、New Wave Electronics Holding Ltd.、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Fortic Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子(北京)、Quandring Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、Bestway Electronics Inc.、香港新崇、金澤高科、添達科技、鈺威科技、欣宏電子、金信科技、BestComm RF Electronics Inc.、盛通科技、Best Solution Electronics Inc.、優方科技、Fine Chip Electronics Inc.、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、嘉芯安科技(深圳)、JXY Electronics Corporation、深圳市集芯源電子、Best Health Electronics Corporation、悠健電子(東莞)、金科集成電路(蘇州)、合泰半導體(中國)、倍創科技等公司之法人董事代表人、芯群集成電路(廈門)等公司之法人監察人代表人、金科集成電路(蘇州)有限公司總經理	無	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選就任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			股數	持股比例
董事	中華民國	王仁宗	男	1050527	3年	930601	2,137,209	0.94%	2,137,209	0.94%	1,500,000	0.66%	-	-	清華大學科管所	定騰科技(股)公司之法人董事代表人、超豐電子(股)公司之法人監察人代表人、崧智科技(股)公司監察人	無	-
獨立董事	中華民國	呂正樂	男	1050527	3年	910417	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 元楨企業(股)公司之獨立董事	無	-
獨立董事	中華民國	邢增田	男	1050527	3年	930601	-	0.01%	27,000	0.01%	-	-	-	-	美國佛羅里達大學電機博士 廣達電腦(股)公司資深副總暨廣達研究院院長	波若威科技(股)公司之獨立董事	無	-
獨立董事	中華民國	郭素豪	男	1050527	3年	1050527	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學電機工程學系教授 南茂科技(股)公司之獨立董事	無	-	

註：本公司已於105年5月27日股東常會全面改選董事並設置審計委員會，依法不再設置監察人，監察人於105年5月27日任期屆滿後卸任。

(二)董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件			是否符合獨立性情形 (註)										兼任其他 公開發 行公司 獨立董 事家數	
	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
吳啟勇			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
高國棟			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
張 治			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林正鋒			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
李佩縈		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
王仁宗			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
呂正樂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
邢智田			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
郭泰豪	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：107年3月30日 單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份股數	持有股份比率	利用他人名義持有股份股數	持有股份比率	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持有股份比率							職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	高國棟	男	87/10/01	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子工程科	Kingtek Semiconductor Holding(BVI)Ltd、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、悠健電子(東莞)、盛通科技、信創科技等公司之法人董事代表人、金料集成電路(蘇州)有限公司董事長	無	-	-
設計及產品中心執行副總	中華民國	張治	男	87/12/11	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所	金料集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公司之法人董事代表人	無	-	-
總經理室副總經理	中華民國	林正鋒	男	87/12/11	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系	Sigmot Holdings Ltd、MCU Holdings Ltd、香港新榮、新緯科技(深圳)公司之法人董事代表人	無	-	-
資源管理中心副總經理	中華民國	李佩榮	女	92/01/06	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企管所	Hotelek Semiconductor Holding(BVI)Ltd、Sigmot Holdings Ltd、MCU Holdings Ltd、盛凌投資、Santek Holdings Ltd、新禾(廈門)電子、Newtek Electronics Ltd、新鼎電子(深圳)、Tuetek Technology Ltd、信霖電子商貿(上海)、E-Micro Technology Holding Ltd、振揚電子(青島)、New Wave Electronics Holding Ltd、Crown Rich Technology Holding Ltd、華瑞昇電子(深圳)、Fortic Electronics Holding Ltd、華榮匯電子(北京)、Quanding Technology Holding Ltd、全鼎電子(蘇州)、Bestway Electronics Inc、香港新榮、金壽高科、滾達科技、鈺威科技、欣宏電子、金信科技、BestComm RF Electronics Inc、盛通科技、Best Solution Electronics Inc、優方科技、Fire Chip Electronics Inc、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、嘉芯安科技(深圳)、JXY Electronics Corporation、深圳市集芯源電子、Best Health Electronics Corporation、悠健電子(東莞)、金料集成電路(蘇州)、合泰半導體(中國)、信創科技等公司之法人董事代表人、芯群集成電路(廈門)等公司之法人監察人代表人、金料集成電路(蘇州)有限公司總經理	無	-	-
業務行銷中心副總經理	中華民國	蔡榮宗	男	99/06/15	292,684	0.13%	206,580	0.09%	-	-	逢甲大學自動控制系	欣宏電子公司之法人董事代表人及合泰半導體(中國)公司之總經理	無	-	-
品質保證處協理	中華民國	吳紹蒞	男	92/06/23	103,845	0.05%	10,080	0.00%	-	-	東海大學物理系	無	無	-	-
設計中心協理	中華民國	吳德傳	男	94/04/15	1,242,317	0.55%	-	-	-	-	成功大學電子研究所	無	無	-	-
設計中心協理	中華民國	余國成	男	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	-	-	逢甲大學電子系	無	無	-	-
產品中心協理	中華民國	王鈺鈿	男	98/07/01	393	0.00%	-	-	-	-	成功大學電機所	無	無	-	-
產品中心協理	中華民國	王明坤	男	100/04/01	175,349	0.08%	-	-	-	-	臺灣技術學院電子系	無	無	-	-
產品中心協理	中華民國	劉源河	男	106/01/01	50,422	0.02%	10,000	0.00%	-	-	臺北工業專科學校電子科	無	無	-	-
會計部門主管	中華民國	李文德	男	101/08/01	9,049	0.00%	-	-	-	-	中正大學國際經濟研究所	無	無	-	-

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事(含獨立董事)之酬金

日期：106 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註10)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註11)		
		報酬(A)(註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	本公司	財務報告內所有公司(註7)			現金金額	股票金額
董事長	吳啟勇	0	0	12,286	0	本公司	財務報告內所有公司(註7)	14,853	0	7,252	0	7,252	0	3.71%	0
董事	高國棟					本公司	財務報告內所有公司(註7)								
董事	張治					本公司	財務報告內所有公司(註7)								
董事	林正鋒					本公司	財務報告內所有公司(註7)								
董事	李佩蓉	0	0	12,286	0	本公司	財務報告內所有公司(註7)	14,853	0	7,252	0	7,252	0	3.71%	0
董事	王仁宗					本公司	財務報告內所有公司(註7)								
獨立董事	呂正樂					本公司	財務報告內所有公司(註7)								
獨立董事	邢智田					本公司	財務報告內所有公司(註7)								
獨立董事	郭泰豪					本公司	財務報告內所有公司(註7)								

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)I
低於2,000,000元	吳啟勇、高國棟、張治、林正鋒、李佩榮、郭泰豪、呂正樂、郭泰豪	吳啟勇、高國棟、張治、林正鋒、李佩榮、王仁宗、郭泰豪	王仁宗、呂正樂、郭泰豪	王仁宗、呂正樂、郭泰豪
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—	吳啟勇、高國棟	吳啟勇、高國棟
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—	張治、林正鋒、李佩榮	張治、林正鋒、李佩榮
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—	—	—
100,000,000元以上	—	—	—	—
總計	9	9	9	9

註1：董事姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務津貼、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、汽油及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務津貼、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、汽油及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(二)總經理及副總經理之酬金

日期：106年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)(註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額占稅後純 益之比例(%) (註8)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	本公司	財務報告內所有 公司(註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)		
董事長	吳啟勇													
總經理	高國棟													
副總經理	張治													
副總經理	林正鋒	12,372	12,372	0	0	4,878	4,878	7,252	0	7,252	0	2.65%	2.65%	0
副總經理	李佩榮													
副總經理	蔡榮宗													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)E
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈、蔡榮宗	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈、蔡榮宗
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	6	6

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

日期：106年12月31日 單位：新台幣仟元

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	董事長	吳啟勇	0	14,217	14,217	1.54%
	總經理	高國棟				
	設計中心 副總經理	張治				
	總經理室 副總經理	林正鋒				
	資源管理中心 副總經理	李佩縈				
	業務行銷中心 副總經理	蔡榮宗				
	品質保證處協理	吳紹菡				
	設計中心協理	吳德傳				
	設計中心協理	余國成				
	產品中心協理	王鈺鈿				
	產品中心協理	王明坤				
	產品中心協理 (註5)	劉源河				
	會計部經理	李文德				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註5：劉源河先生於106年1月1日原職處長升任本公司協理。

(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職 稱	支付酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	
	106 年	105 年
董事	3.71%	3.83%
總經理及副總經理	2.65%	2.49%

1.董事酬金給付政策及訂定酬金之程序：

依本公司章程第二十四條規定：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

由薪資報酬委員會討論依各董事執行業務程度於上述金額內分配董事酬金，再提交董事會決議。

2.總經理及副總經理酬金給付政策及訂定酬金之程序

(1)本公司訂有人事薪資制度，總經理及副總經理之薪資依公司制度由人事單位予以考核，並送交總經理室會議中予以評定，並呈送薪資報酬委員會討論通過提交董事會決議，人事薪資制度參考因素主要為執行業務內容、經歷與績效及貢獻度，其中尤以績效及貢獻度為著。

(2)本公司章程規定年度分派員工酬勞，由人事單位依據人事薪資制度、績效評估辦法、獎懲辦法及員工守則，參考因素主要為職務內容、績效及未來貢獻度，尤以績效及未來貢獻度比重最大，送交總經理室會議中予以評定。

(3)上述之總經理、副總經理及協理級經理人之薪資及員工酬勞於總經理室會議中予以核定後，呈薪資報酬委員會討論通過並提交董事會決議。

3.給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性

(1)董事酬勞係依據在本公司擔任之職位及對本公司營運參與程度及貢獻之價值核發。

(2)總經理及副總經理之酬金，係依據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，依本公司人事規章辦理。

依據本公司訂定董事會績效評估辦法，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：106 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	吳啟勇	5	1	83%	
董事	高國棟	6	0	100%	
董事	張治	4	2	67%	
董事	林正鋒	5	1	83%	
董事	李佩縈	6	0	100%	
董事	王仁宗	6	0	100%	
獨立董事	呂正樂	6	0	100%	
獨立董事	邢智田	5	1	83%	
獨立董事	郭泰豪	5	1	83%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：請參閱本年報第 39 頁~第 40 頁

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司訂有「董事會議事規則」及「董事會績效評估辦法」，已於 100 年 10 月 25 日成立薪資報酬委員會，並於 105 年 5 月 27 日成立審計委員會，以提升董事會運作效能。

四、106 年度獨立董事出席董事會情形如下：

姓名	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
呂正樂	◎	◎	◎	◎	◎	◎
邢智田	◎	◎	◎	◎	☆	◎
郭泰豪	◎	◎	◎	◎	◎	☆

◎親自出席；☆委託出席；*未出席

(二)審計委員會參與董事會運作情形：106 年度審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	呂正樂	6	0	100%	本公司於 105 年 5 月 27 日股東常會通過設置審計委員，取代監察人職務
獨立董事	邢智田	5	1	83%	
獨立董事	郭泰豪	5	1	83%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：請參閱本年度第 40 頁~第 41 頁

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1.本公司每年定期召開審計委員會及董事會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，並將討論事項載明於會議記錄，獨立董事與稽核主管達到充分溝通。

2.本公司進行年度財務報表審閱時，由會計師列席審計委員會及董事會，說明財務報告查核情形、重大資產評價及會計估計等，會計師針對董事所提問題進行討論及溝通。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站與公開資訊觀測站。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益	V	(一) 1.本公司依照公司法及相關法令規定召集股東會，並制定完備的股東會議事規則，本公司設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東建議、疑義及糾紛事項，並於本公司網站揭露聯繫方式，股東均可反應意見，並獲妥善處理。 2.為降低公司訴訟風險及成本，並確保股東權益，本公司設有專職法務單位，並聘請外部專業法律顧問，依內部處理程序處理法務訴訟相關事宜。	(一)無差異。
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(二)本公司依證交法第25條規定，對內部人(董事、經理人及持有股份超過總額10%之股東)所持股權之變動情形，按月申報至公開資訊觀測站，以掌握實際控制公司的主要股東及主要股東之最終控制者名單，以確保經營之穩定。	(二)無差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V	(三)本公司訂定「對子公司之監理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」，與關係企業間之人員、資產及財務管理權責均清楚劃分，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，且實施必要的控管機制，建立適當的防火牆。	(三)無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(四)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並告知公司內部人不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	(四)無差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																													
	是	否																																																																														
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>(一) 1.本公司董事會設置九席董事，其中一席為女性董事，三席為獨立董事，對於公司業務之執行，除依法令或公司章程規定應由股東會決議之事項外，確實依董事會決議為之，並每月/每季檢查是否落實計畫目標。</p> <p>2.每位董事所具專業能力如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>多元化核心項目</th> <th>性別</th> <th>經營管理</th> <th>領導決策</th> <th>產業知識</th> <th>財務會計</th> <th>法律</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事姓名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>吳啟勇</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>高國棟</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>張治</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>林正鋒</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>李佩縈</td> <td>女</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>王仁宗</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>呂正樂</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>邢智田</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>郭泰豪</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(二)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，嗣後將視法令規定及營運需要決定是否設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)</p> <p>1.本公司董事會已於105年1月通過「董事會績效評估辦法」，並自105年度起，於每年12月進行當年度董事會之績效評估，並將其評估結果於次一年度送交董事會報告。</p> <p>2.本公司董事會績效評估至少函括下列五大面向：(一)對公司營運之參與</p>	多元化核心項目	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	董事姓名							吳啟勇	男	V	V	V			高國棟	男	V	V	V		V	張治	男	V	V	V			林正鋒	男	V	V	V			李佩縈	女	V	V	V	V	V	王仁宗	男	V	V	V	V	V	呂正樂	男	V	V	V	V	V	邢智田	男	V	V	V			郭泰豪	男	V	V	V			(一)無差異。
多元化核心項目	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律																																																																										
董事姓名																																																																																
吳啟勇	男	V	V	V																																																																												
高國棟	男	V	V	V		V																																																																										
張治	男	V	V	V																																																																												
林正鋒	男	V	V	V																																																																												
李佩縈	女	V	V	V	V	V																																																																										
王仁宗	男	V	V	V	V	V																																																																										
呂正樂	男	V	V	V	V	V																																																																										
邢智田	男	V	V	V																																																																												
郭泰豪	男	V	V	V																																																																												
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？</p>	V	<p>(二)無差異。</p> <p>(三)無差異。</p>																																																																														

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>程度。(二)提升董事會決策品質。(三)董事會組成與結構。(四)董事的選任及持續進修。(五)內部控制。</p> <p>3.每半年度結束時收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」，由統籌之執行單位資源管理中心將資料統一回收後，針對評估指標之評分制定，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。</p> <p>4.106年度董事會評估結果為董事會運作良好，董事會是否建置適當且足夠之功能性委員會，將適時依公司實際運作來設置。</p> <p>(四)</p> <p>1.本公司每年定期審酌簽證會計師之專業資格及獨立性，連同會計師出具超然獨立聲明書，提報至106年3月審計委員會及董事會。</p> <p>2.本公司經審計委員會及董事會評估簽證會計師無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事，二位會計師除簽證相關費用外，未擔任本公司之董事、經理人或重大影響之職務，亦無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合獨立性及適任性條件。</p>	(四)無差異。
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	<p>本公司由資源管理中心副總經理負責公司治理相關事務；主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展。</p> <p>106年度業務執行情形如下：</p> <p>1.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂會議議題及議程，於會議7日前通知所有董事出席，並提供充分之會議資料。董事會議事錄於會後20日內提供所有董事，並列入公司重要檔案。</p> <p>2.董事進修課程：規劃適宜課程，加強專業知識與實務運作。</p> <p>3.董事會績效評估：建立績效目標以加強董事會運作效率，以提升董事會功能。</p>	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>4.董事責任：落實公司治理、強化董事會職能。</p> <p>5.依法召開股東常會，提供股東會開會通知書、議事手冊、年報及股東會議事錄，並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記。</p>	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	<p>本公司設有投資關係專責單位，包括股東、客戶、供應商及投資人公司相關資訊及溝通管道，公司網站亦設置利害關係人專區與各專責人員連絡方式，以回應利害關係人關切之議題，請參閱本年報第25頁~第26頁。</p>	無差異。
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	V	<p>本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。</p>	無差異。
七、資訊公開	V		
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)無差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司等)？	V	<p>(一)本公司設有中/英文網站(www.holtek.com.tw)，定期揭露及更新公司財務業務、公司治理、與投資人相關資訊。</p> <p>(二)</p> <p>1.本公司定期更新公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。</p> <p>2.本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料及法說會現場影片放置於公開資訊觀測站及公司網站中，提供投資人查詢公司營運及財務資訊。</p>	(二)無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執	V		無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?</p>		<p>摘要說明</p> <p>辨員工及眷屬團體保險，並聘僱專業之護理人員負責員工健康檢查與追蹤管理及健康講座等活動。</p> <p>3.投資者關係：本公司注重股東應有之權益，依法充分揭露公司營運各項訊息，設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東權益之各項事務，並以提升營運績效及股東權益報酬率為長期目標。</p> <p>4.供應商關係：本公司之主要供應商均為國內外知名大廠，往來信用良好，並注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。</p> <p>5.利害關係人之權利：本公司對利害關係人之權利，保持良好之溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益。</p> <p>6.董事進修情形：本公司每年規劃相關課程，提供董事進修，以加強專業知識及實務運作，請參閱本年報第37頁。</p> <p>7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定內部控制制度並有效執行，以降低各項風險，請本年報參閱第194頁~第195頁。</p> <p>8.客戶政策之執行情形：本公司重視國內外客戶之長期合作關係，提供最具有競爭力的產品及服務予客戶，重視客戶應有之權益，並定期審視客戶與本公司間之往來業務及信用狀況，創造雙贏局面。</p> <p>9.公司為董事購買責任保險之情形：本公司經106年10月審計委員會及董事會通過續保董監事責任保險案，106年度投保金額為美金伍佰萬元，並依規定申報於公開資訊觀測站。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>本公司公司治理評鑑結果：第一屆及第二屆為前20%之公司、第三屆為前5%之公司、第四屆已完成自評與檢討，未來將持續配合主管機關對於公司治理評鑑之推動及改善，以強化公司治理。</p>			

十、傾聽利害關係人關切議題及以溝通管道回應

本公司對利害關係人之權利，保持良好之溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益，整合內部各組織之努力，有效地實踐企業社會責任的使命。

利害關係人	關切議題	溝通管道或形式
員工	1.員工福利 2.職涯規劃及發展 3.在職訓練 4.工作權平等及職場安全 5.身心健康	1.公司公告 2.行政部溝通管道 3.勞資會議 4.員工意見箱 5.職工福利委員會 6.醫護人員
客戶	連絡窗口：行政部主管李修銘經理 電話：(03)5631999 分機 1303 1.產品品質及交期 2.工程技術及應用方案能力 3.供應鏈管理 4.銷售服務及隱私 4.公司獲利能力及股利發放 5.公司治理及企業社會責任	電子郵件：liman1103@holtek.com.tw 1.客戶滿意度調查 2.高階主管客戶拜訪 3.客戶稽核 4.代理商業務會議
股東/投資人	連絡窗口：本公司網站設有利害關係人專區，建立業務單位各區域溝通管道、各專責人及電話、e-mail。 1.公司營運概況 2.公司財務資訊 3.公司風險管理 4.公司獲利能力及股利發放 5.公司治理及企業社會責任	1.公司年報 2.股東常會 3.每季法人說明會及不定期受邀之投資論壇 4.公司官網設置利害關係人專區
供應商	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜歡 電話：(03)5631999 分機 1612 1.無衝突礦產聲明 2.綠色產品落實 3.供應商服務及隱私 4.付款能力及財務風險	電子郵件：ir@holtek.com.tw 1.供應商會議 2.高階主管供應商拜訪 3.供應商滿意度調查 4.供應商稽核及品質檢驗 5.供應商ISO認證
政府機構	連絡窗口：採購李修銘經理 電話：(03)5631999 分機 1303 1.公司重大訊息 2.法令遵循 3.公司資訊揭露 4.公司治理相關議題 5.勞資關係及兩性平等 6.稅賦繳納 7.產業升級	電子郵件：liman1103@holtek.com.tw 5.會計師審計及稅務服務 6.法律顧問服務
社會大眾	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜歡 電話：(03)5631999 分機 1612 1.社會參與及產學合作 2.社會公益及慈善捐款	電子郵件：ir@holtek.com.tw 1.產學合作 2.提供職訓及在學學生企業實習機會 1.年度盛群盃 2.弱勢團體捐款及產品採購

與各利害關係人溝通方式

- 1.與股東、員工、客戶、供應商或利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有的合法權益。
- 2.設有投資人關係專責單位，提供股東及投資人公司相關資訊及溝通管道，並於本公司網站建立各利害關係人溝通管道-各專責人及電話、e-mail。
另，注重各股東應有之權益，依法充分揭露公司營運各項訊息，設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東權益之各項事務，並以提升營運績效及股東權益報酬率為長期目標。
- 3.透過各種管道鼓勵員工與管理階層溝通，適度反映員工對公司之意見。
- 4.與客戶及供應商保持長期良好的合作關係，每月定期檢討往來情況，增進合作默契。
- 5.致力於經營發展及實現股東利益最大化，並關注消費者權益、社區環保及公益等議題，並投入人力經費以加強產學合作及社會職能訓練，重視公司之社會責任。
- 6.重視產品品質，並訂有「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」及「客戶退貨處理規範」等作業程序，並且在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決並處理客戶申訴問題之目標。
- 7.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品，維護客戶的權益。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)								兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數	備註
		商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 需相關料 系之公私 立大專院 校講師以 上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所 需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	邢智田			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
獨立董事	呂正樂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	郭泰豪	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

2.薪資報酬委員會之職責：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)第三屆委員任期：105年6月7日至108年5月26日，106年度薪資報酬委員會開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)(註)	備註
召集人	邢智田	4	1	80%	
委員	呂正樂	5	0	100%	
委員	郭泰豪	4	1	80%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、落實公司治理</p> <p>(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？</p>	V	<p>(一)本公司已訂定「企業社會責任實務守則」並成立CSR委員會，每年定期召開會議設定目標並檢討實施成效。106年度具體推動計畫及實施成效：</p> <p>1.榮獲第三屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。</p> <p>2.落實節約能源政策及提升員工環保意識及能力：</p> <p>(1)一樓大廳及辦公室更換LED燈管，降低燈源發熱量，並達到節能目的。</p> <p>(2)積極提倡員工自備餐具，且餐廳全面改用不鏽鋼餐具，減少環境污染。</p> <p>3.參與社會公益活動：</p> <p>(1)106年三節禮盒採購弱勢團體禮盒及推廣臺灣自製農產品為主，並積極尋找合適且符合盛群捐助理念的社福團體，例如：創世社會福利基金會、財團法人心路社會福利基金會等。</p> <p>(2)106年贊助華山基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人癌症希望基金會，為地球環境及社會盡一份心力。</p> <p>4.盛群大學計劃與盛群盃MCU創意大賽：</p> <p>(1)盛群大學計劃- 2017年捐贈微控制器設備予四所大學院校，市值約新台幣300萬元，至少約培育近1,500名學生至職場就業，透過競賽及教授推薦進入盛群任職共8名學生。</p> <p>(2)盛群盃創意大賽-2017年第十二屆盛群盃競賽免費提供參賽隊伍競賽元件(每套市值約新台幣2,500元)，及活動執行經費等支出共新台幣250餘萬元。</p>	(一)無差異。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V	(二)本公司利用內部教育訓練、公司的各項活動聚會來推廣及傳達社會責任。	(二)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V	<p>任理念。</p> <p>(三)本公司由資源管理中心副總經理統籌運作企業社會責任相關政策，並由工安環保室、應用推廣企劃處、行政部、品質保證處及生產企劃及工程處等單位定期蒐集相關法令及社會環境發展議題，制定相關因應行動，再向董事會報告推動與執行成效。</p>	(三)無差異。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V	<p>(四)本公司訂有「員工守則」、「績效評估辦法」、「獎懲辦法」，適時將企業社會責任訓練與員工績效考核系統結合，建立明確有效之獎勵及懲戒制度，讓經營者、部門主管及員工都瞭解各階層責任。</p>	(四)無差異。
二、發展永續環境			
(一)公司是否致力於提升各項資源之利用率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	<p>(一)本公司為純IC設計公司，並無設置製造工廠，仍以污染預防及持續改善為發展基本架構，研發節能省碳之綠色概念產品、改善製程技術降低環境衝擊、提升各項資源之利用率(如運送包裝再使用)並導入綠色供應鏈，除符合法規及相關要求事項，並落實環保教育，確實執行資源回收，珍惜水資源，並訂有IECQ QC080000有害物質流程管理系統，符合國際規範，維護美好地球。</p>	(一)無差異。
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	<p>(二)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司已取得國際ISO9001品保認證，將產品開發及供應之品質系統，持續落實執行。 2.本公司設有專責單位負責致力推動ISO14001環境管理系統的持續改善，秉持企業永續發展之經營理念。 3.本公司要求合作之所有供應商必須取得ISO9001品保認證及ISO14001環保認證，共同推動永續發展合適的環境。 	(二)無差異。
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並	V	<p>(三)</p>	(三)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？		<p>本公司為推動節能減碳，預計107年節省5%電力及水費，執行措施如下：</p> <p>1.辦公室節能措施：</p> <p>(1)隨季節開關空調及設定恆溫於26度，以減低電費，公司同仁也做到隨手關閉電腦、空調與照明電源。</p> <p>(2)辦公室之照明燈光將以LED取代鹵素燈，既能降低燈源發熱量，並達到節能目的。</p> <p>2.電腦機房節能措施：推行伺服器虛擬化，節省電力及相關設備。</p> <p>3.省水措施：給水裝置全部加裝變頻器以穩定水壓，公共洗手間也使用感應式水龍頭，控制用水量可達35%，已有效減少不必要的水資源浪費。</p> <p>4.其他：</p> <p>(1)配合政府政策，自107年使用電子發票作業，符合節能減碳之環保精神。</p> <p>(2)持續推動文件管理電子化系統，減少紙張使用量。</p> <p>(3)確實執行廢棄物如廚餘、空碳粉匣、空碳粉匣、鐵鋁玻璃罐、廢紙與保特瓶等的回收管理與資源分類，並由專業人員負責廢棄物的處理與分類。</p>	
三、維護社會公益			
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	(一)本公司依照勞動相關法規及國際人權公約，制定各項符合法規之制度與措施，以保障員工之各項權益。	(一)無差異。
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	V	(二)本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁與各級主管做雙向的意見表達及溝通，並設置行政部專職人員，提供員工暢通的申訴管道，若發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信或違法行為時，依據本公司訂定「檢舉制度」處理。	(二)無差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並	V	(三)本公司於2006年取得國際OHSAS18001職業安全衛生管理認證，並推	(三)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
對員工定期實施安全與健康教育？		<p>動各項員工安全衛生業務的持續改善活動及安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全，詳細說明請參閱本年第80頁。</p> <p>(四)</p> <p>1.本公司定期每季召開勞資會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識後執行，迄今勞資間關係良好。</p> <p>2.本公司管理制度或營運模式有重大變動時，將召開說明會向員工說明，並設置專職單位回答員工之疑問，讓員工充分瞭解公司制度規章。</p> <p>(五)本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長，詳細說明請參閱本年第78頁~第79頁。</p> <p>(六)</p> <p>1.本公司重視產品品質，並訂有「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」及「客戶退貨處理規範」等作業程序，並在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決及處理客戶申訴問題之目標。</p> <p>2.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品，維護客戶的權益。</p> <p>(七)本公司產品遵循國際環保法規，符合歐盟ROHS與REACH的要求，並在產品包裝上有明確標示，以確保產品不含有傷害人體的有害物質。</p> <p>(八)本公司依據內部規章執行供應商評估及供應商管理等事項，除符合本公司之供應商管理政策才得以成為合格供應商外，持續對供應商要求</p>	(四)無差異。
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	V		
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(五)無差異。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		(六)無差異。
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V		(七)無差異。
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V		(八)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V	<p>遵循綠色環保法規，並推廣採取各種保護環境之政策，共同致力提升企業社會責任。</p> <p>(九)本公司與主力供應商合作通過第三方SGS或INTERTEK的社會責任要求稽核，並定期與供應商開會檢討要求符合環保規定之材料及工廠推行勞工衛生安全管理。</p>	(九)無差異。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V	<p>(一)本公司網站設有企業社會責任專區揭露企業社會責任相關資訊，請至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。</p>	(一)無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂定「企業社會責任實務守則」與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」無差異，運作重點如下： (一)落實公司治理：依據公司治理守則及誠信經營守則辦理各項工作。 (二)發展永續環境：注重生態環境保護與資源有效利用，並落實於實際運作上。 (三)維護社會公益：保障員工權益與創造良好的工作環境，並關心社區發展與消費者權益。 (四)加強企業社會責任資訊揭露：已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露企業社會責任報告書。			
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：106年度具體推動計畫及履行企業社會責任成效如下： 請參閱本公司網站企業社會責任專區： http://www.holtek.com.tw/web/guest/responsibility			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。			

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V	(一)本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「同仁廉潔守則」，本公司董事及經理人需盡善良管理人之注意義務，督促公司防 止不誠信行為，並隨時檢討成效及持續改善，確保誠信經營政策之落 實。	(一)無差異。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V	(二)本公司訂定「檢舉制度」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範不 得藉職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他弊 弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，並透過 內部稽核制度，建立嚴謹的防範制度，防止不誠信行為發生。	(二)無差異。
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V	(三)本公司已訂定「誠信經營守則」，並分析營業範圍內具較高不誠信行 為風險之營業活動，加強相關防範措施，提升公司誠信經營之成效。	(三)無差異。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V	(一)本公司避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對 象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立 即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信 經營政策。	(一)無差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V	(二) 1.本公司由資源管理中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執 行，並由業務行銷中心、設計中心、產品中心及品質保證處等單位協助 負責。 2.本公司針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，禁止提供或	(二)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	<p>收受不正當利益及不提供政治獻金等措施，每年定期向董事會報告，落實誠信經營政策。</p> <p>3.本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂契約，其內容應包括遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(三)本公司訂定「誠信經營守則」及「檢舉制度」，制定防止利益衝突政策，並有適當陳述管道，若發現或接獲檢舉涉有不誠信或違法行為時，由專責人員處理。</p>	(三)無差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V	<p>(四)本公司已建立完整的會計制度、內部控制制度，由內部稽核部門及外部專業單位(如會計師)持續稽查違反誠信經營之情事，截至今日並無違反誠信經營之情事。</p>	(四)無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>(五)</p> <p>1.本公司定期舉辦誠信經營相關之教育訓練課程，課程內容涵蓋資安治理、內線交易防制因應之道、會計制度、內部控制、勞資關係、勞基法及勞工退休制度等相關課程，計88人次，合計438時數。</p> <p>2.若發現有違誠信經營守則嫌疑之情事，均有向其主管或檢舉管道負責單位舉報之責任與義務。並將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。</p>	(五)無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V	<p>(一)</p> <p>1.本公司已訂定「檢舉制度」及「同仁廉潔守則」，其專責單位為行政部，若檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管；若涉及董事或協理級(含)以上之高階主管，應呈報至獨立董事。</p> <p>2.本公司同仁若發現有舞弊或洩漏機密而違反誠信經營規定時，可透過部</p>	(一)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V	<p>門主管或行政部予以檢舉，並指派專責人員受理，調查相關事實證明，若確實違反廉潔守則，除所獲取之各項不正當利益，均應追繳發還被索取人或公司外，並依情節大小，予以不等之處分。</p> <p>(二)</p> <p>1.本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，將立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>2.對於檢舉情事經查證屬實，相關單位應檢討內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生，並由專責單位將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p>(三)本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之身家安全。</p>	(二)無差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	<p>(一)已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」。</p>	(三)無差異。
四、加強資訊揭露	V	<p>(一)已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」。</p>	(一)無差異。
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	<p>(一)已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」。</p>	(一)無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異。		<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異。</p>	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 截至目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。		<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 截至目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。</p>	
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司之「公司治理守則」及相關規章已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，查詢方式請參閱本公司網站(http://www.holtek.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。		<p>(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司之「公司治理守則」及相關規章已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，查詢方式請參閱本公司網站(http://www.holtek.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。</p>	

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事、會計主管及稽核主管之進修情形：

職稱	姓名	就任日期	進修期間	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
董事	高國棟	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
董事	張 治	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
董事	林正鋒	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
董事	李佩縈	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/04/14	台灣董事學會	審計委員會的挑戰及優先任務	3
			106/08/01	台灣董事學會	反避稅時代之稅務治理	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
董事	王仁宗	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/04/14	台灣董事學會	審計委員會的挑戰及優先任務	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
獨立董事	呂正樂	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
獨立董事	邢智田	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/07	社團法人中華公司治理協會	科技發展下的資安治理	3
獨立董事	郭泰豪	105/05/27	106/03/02	社團法人中華公司治理協會	董監如何協助公司面對風險處理危機	3
			106/11/09	社團法人中華公司治理協會	董事對租稅法令與法律責任應有之認識	3
			106/11/09	社團法人中華公司治理協會	最新租稅法令修正暨解析	3
會計主管	李文德	101/08/01	106/05/18 ~ 106/05/19	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	廖明通	103/02/01	106/08/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內稽人員閱讀分析「新 IFRS 財報」與「新財務報表查核報告」實務研討	6
			106/12/14	中華民國內部稽核協會	數位時代環境下的內稽內控實務	6

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

盛群半導體股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：一〇七年三月一日

本公司民國一〇六年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇六年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇七年三月一日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

盛群半導體股份有限公司

董事長：吳啟勇



總經理：高國棟



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會、董事會及審計委員會之重要決議

1.106 年度股東會之重要決議

開會日期	事項	股東會重要決議	執行情形
106.05.26	承認事項	1.通過本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司民國一〇五年度盈餘分配案。	1.決議通過。 2.決議通過每股配發現金股利 3.014 元，訂定 106 年 8 月 15 日為除息基準日，於 106 年 8 月 25 日發放現金股利，發放金額為 681,670,955 元。
	討論事項	1.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 2.通過本公司「公司章程」修訂案。 3.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.通過本公司董事競業禁止解除案。	1.決議通過每股配發現金 0.486 元，訂定 106 年 8 月 15 日為除息基準日，於 106 年 8 月 25 日發放現金股利，發放金額為 109,917,745 元。 2.決議通過，依規定向主管機關辦理公司章程修訂案，並於 106 年 6 月 6 日取得核准函。 3.決議通過，依規定申報至公開資訊觀測站。 4.決議通過。

2.董事會之重要決議

董事會	議案內容及後續處理	獨立董事持反對或保留意見
第七屆 第七次 106.04.24	1.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	無
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	
第七屆 第八次 106.07.24	1.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	無
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	
第七屆 第九次 106.10.30	1.本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 2.本公司「董事會議事規則」修訂案。 3.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	無
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	
第七屆 第十次 106.11.07	1.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	無
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	

董事會	議案內容及後續處理	獨立董事持反對或保留意見
第七屆第十一次 107.01.29	1.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	無
第七屆第十二次 107.03.01	1.討論解除董事競業禁止案。 2.本公司一〇七年股東常會召開日期案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	無
第七屆第十三次 107.04.30	1.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	無

3.審計委員會之重要決議

董事會	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第七屆第七次 106.04.24	1.本公司一〇六年第一季稽核查核報告案。 2.本公司一〇六年第一季合併財務季報告案。 3.金佶科技股份有限公司增加投資案。 4.MCU Holdings Ltd.轉投資 Best Health Electronics Corporation 及 優健電子(廣東)有限公司(名稱暫定)案。 審計委員會決議結果(106年4月21日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無
第七屆第八次 106.07.24	1.本公司一〇六年第二季稽核查核報告案。 2.本公司一〇六年第二季合併財務季報告案。 3.訂定本公司一〇五年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。 4.訂定本公司法定盈餘公積發放現金基準日案。 審計委員會決議結果(106年07月21日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無
第七屆第九次 106.10.30	1.本公司一〇六年第三季稽核查核報告案。 2.本公司一〇六年第三季合併財務季報告案。 3.本公司增加投資欣宏電子股份有限公司案。 4.MCU Holdings Ltd.增加投資 Anchip Technology Corporation 及 嘉芯安科技(深圳)有限公司案。 5.MCU Holdings Ltd.處分 Best Health Electronics Corporation 及 悠健電子(東莞)有限公司部份股權案。 6.本公司孫公司盛通科技股份有限公司現金增資及大陸投資案。 7.本公司新增印度地區投資案。 8.永豐銀行新竹分行短期額度申請案。 9.本公司擬續購買董事責任保險案。	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
	審計委員會決議結果(106年10月27日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第七屆第十次 106.11.07	1.本公司一〇七年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 2.本公司一〇七年營運計畫案。	V	無
	審計委員會決議結果(106年11月6日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第七屆第十一次 107.01.29	1.本公司一〇六年第四季稽核查核報告案。 2.本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司一〇六年合併財務報告及個體財務報告案。	V	無
	審計委員會決議結果(107年01月26日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第七屆第十二次 107.03.01	1.本公司一〇七年一月份稽核查核報告案。 2.本公司一〇六年度營業報告書案。 3.本公司一〇六年度盈餘分派案。 4.本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 5.本公司出具內部控制制度聲明書案。 6.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。	V	無
	審計委員會決議結果(107年02月27日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第七屆第十三次 107.04.30	1.本公司一〇七年二月至三月份稽核查核報告案。 2.本公司一〇七年第一季合併財務報告案。 3.MCU Holdings Ltd.轉投資 Best Power Electronics Corporation 案。	V	無
	審計委員會決議結果(107年04月27日)：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形：無。

五、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺	游萬淵	106/01/01~106/12/31	—

金額單位：新台幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元		—	—	—
2	2,000 千元(含)~4,000 千元		3,657	100	3,757
3	4,000 千元(含)~6,000 千元		—	—	—
4	6,000 千元(含)~8,000 千元		—	—	—
5	8,000 千元(含)~10,000 千元		—	—	—
6	10,000 千元(含)以上		—	—	—

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	106 年度		當年度截至 107 年 3 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	吳啟勇	—	—	—	—
董事兼總經理	高國棟	—	—	—	—
董事兼副總經理	張 治	—	—	—	—
董事兼副總經理	林正鋒	—	—	—	—
董事兼副總經理	李佩縈	—	—	—	—
董事	王仁宗	—	—	—	—
獨立董事	呂正樂	—	—	—	—
獨立董事	邢智田	27,000	—	—	—
獨立董事	郭泰豪	—	—	—	—
副總經理	蔡榮宗	—	—	—	—
協 理	吳紹藩	(27,000)	—	—	—
協 理	吳德傳	(28,000)	—	—	—
協 理	余國成	—	—	—	—
協 理	王鈺鈿	(185,000)	—	—	—
協 理	王明坤	(18,000)	—	—	—
協 理	劉源河	—	—	—	—
會計主管	李文德	—	—	—	—
大股東	聯華電子(股)公司	(30,000)	—	—	—

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(二) 股權移轉資訊

本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10% 以上股東並無辦理股權移轉予關係人之情事。

(三) 股權質押資訊

本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10% 以上股東並無辦理股票質押予關係人之情事。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

107年3月30日；單位：股

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 (註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
聯華電子股份有限公司 洪嘉聰	24,644,257	10.90%	—	—	—	—	無	無	
吳啟勇	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
渣打託管歐洲瑞信證券—文藝復興長期銷售	6,620,000	2.93%	—	—	—	—	無	無	
啟盛投資股份有限公司 陳佳宏	5,172,703	2.29%	—	—	—	—	無	無	
財團法人國家文化藝術基金會 林曼麗	4,538,000	2.01%	—	—	—	—	無	無	
花旗(台灣)託管新加坡政府投資專戶	3,354,000	1.48%	—	—	—	—	無	無	
花旗託管BNP投資操作SNC投資專戶	2,932,290	1.30%	—	—	—	—	無	無	
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	2,794,075	1.24%	—	—	—	—	無	無	
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	2,786,483	1.23%	—	—	—	—	無	無	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

日期：106年12月31日 單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	15,253	100%	—	—	15,253	100%
芯群集成電路(廈門)有限公司(註 1)	—	100%	—	—	—	100%
合泰半導體(中國)有限公司(註 1)	—	100%	—	—	—	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (註 2)	2,000	100%	—	—	2,000	100%
MCU Holdings Ltd.	500	100%	—	—	500	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司(註 3)	—	100%	—	—	—	100%
盛凌投資股份有限公司	40,000	100%	—	—	40,000	100%
Bestway Electronic Inc. (註 4)	800	40%	—	—	800	40%
新棠(香港)有限公司(註 5)	—	—	—	—	—	—
新緯科技(深圳)有限公司(註 6)	—	40%	—	—	—	40%
Santek Holdings Ltd. (註 4)	180	40%	—	—	180	40%
新禾(廈門)電子有限公司(註 7)	—	40%	—	—	—	40%
New Wave Electronics Holding Ltd. (註 4)	800	40%	—	—	800	40%
諾華達電子(深圳)有限公司(註 8)	—	40%	—	—	—	40%
金濤高科有限公司(註 4)	2,400	40%	—	—	2,400	40%
滋達科技有限公司(註 4)	1,275	33%	—	—	1,275	33%
ForIC Electronics Holding Ltd. (註 4)	300	40%	—	—	300	40%
華榮匯電子科技(北京)有限公司(註 9)	—	40%	—	—	—	40%
E-Micro Technology Holding Ltd. (註 9)	300	40%	—	—	300	40%
振揚電子(青島)有限公司(註 10)	—	40%	—	—	—	40%
Newtek Electronics Ltd. (註 4)	1,501	41%	—	—	1,501	41%
新鼎(深圳)電子有限公司(註 11)	—	41%	—	—	—	41%
Truetek Technology Ltd. (註 4)	920	40%	—	—	920	40%
信霖電子商貿(上海)有限公司(註 12)	—	40%	—	—	—	40%
Crown Rich Technology Holding Ltd. (註 4)	80	40%	—	—	80	40%
華瑞昇電子(深圳)有限公司(註 13)	—	40%	—	—	—	40%
Quanding Technology Holding Ltd. (註 4)	60	40%	—	—	60	40%
全鼎電子(蘇州)有限公司(註 14)	—	40%	—	—	—	40%
欣宏電子股份有限公司(註 16)	7,200	40%	—	—	7,200	40%
A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.(註 16)	2,000	40%	—	—	2,000	40%
Innotek Electronics Inc. (註 16)	800	40%	—	—	800	40%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
鉛威股份有限公司(註 15)	5,641	22%	—	—	5,641	22%
高聖科技股份有限公司(註 15)	235	39%	—	—	235	39%
優方科技股份有限公司(註 15)	800	55%	—	—	800	55%
BEST SOLUTION ELECTRONIC INC. (註 17)	200	55%	—	—	200	55%
天宇微機電股份有限公司(註 15)	380	20%	—	—	380	20%
盛通科技股份有限公司(註 15)	4,000	100%	—	—	4,000	100%
BestComm RF Electronics Inc.(註 18)	30	100%	—	—	30	100%
倍創科技股份有限公司(註 15)	1,000	100%	—	—	1,000	100%
Fine Chip Electronics Inc. (註 4)	1	40%	—	—	1	40%
健芳電子科技(上海)有限公司(註 19)	—	40%	—	—	—	40%
Anchip Technology Corporation (註 4)	1	60%	—	—	1	60%
嘉芯安科技(深圳)有限公司(註 20)	—	60%	—	—	—	60%
JXY Electronics Corporation (註 4)	1	40%	—	—	1	40%
集芯源電子科技有限公司(註 21)	—	40%	—	—	—	40%
Best Health Electronics Corporation (註 4)	5	80%	—	—	5	80%
悠健電子(東莞)有限公司(註 22)	—	80%	—	—	—	80%

註 1：係 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 轉投資。

註 2：係 Sigmos Holdings Ltd. 轉投資。

註 3：係 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 轉投資。

註 4：係 MCU Holdings Ltd. 轉投資。

註 5：係 Bestway Electronic Inc. 轉投資。

註 6：係新棠(香港)有限公司轉投資。

註 7：係 Santek Holdings Ltd. 轉投資。

註 8：係 New Wave Electronics Holding Ltd. 轉投資。

註 9：係 ForIC Electronics Holding Ltd. 轉投資。

註 10：係 E-Micro Technology Holding Ltd. 轉投資。

註 11：係 Newtek Electronics Ltd. 轉投資。

註 12：係 Truetek Technology Ltd. 轉投資。

註 13：係 Crown Rich Technology Holding Ltd. 轉投資。

註 14：係 Quanding Technology Holding Ltd. 轉投資。

註 15：係盛凌投資股份有限公司轉投資。

註 16：係欣宏電子股份有限公司轉投資。

註 17：係優方科技股份有限公司轉投資。

註 18：係盛通科技股份有限公司轉投資。

註 19：係 Fine Chip Electronics Inc. 轉投資。

註 20：係 Anchip Technology Corporation 轉投資。

註 21：係 JXY Electronics Corporation 轉投資。

註 22：係 Best Health Electronics Corporation 轉投資。

註 23：上述轉投資事業均係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 5 月 15 日(89)台財證(一)第 36989 號函核准。

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 4 月 3 日(90)台財證(一)第 116941 號函核准。

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 5 月 17 日(91)台財證(一)第 126989 號函核准。

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 27 日(92)台財證(一)第 0920128586 號函核准。

註 5：金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 6：金融監督管理委員會證券期貨局 94 年 6 月 24 日(94)金管證(一)第 0940125322 號函核准。

註 7：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 4 月 1 日(92)台財證(一)第 0920110590 號函核准。

註 8：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 8 月 22 日(92)台財證(一)第 0920138382 號函核准。

註 9：金融監督管理委員會證券期貨局 95 年 6 月 29 日(95)金管證(一)第 0950127323 號函核准。

註 10：財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 11：金融監督管理委員會 96 年 6 月 25 日(96)金管證(一)第 0960031838 號函核准。

註 12：金融監督管理委員會 97 年 7 月 9 日(97)金管證(一)第 0970034273 號函核准。

註 13：金融監督管理委員會 98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。

註 14：行政院金融監督管理委員會 94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。

註 15：行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	屬上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

107 年 3 月 30 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合 計
人 數	1	13	73	15,921	224	16,232
持有股數	260,000	4,302,910	40,318,617	106,191,646	75,095,027	226,168,200
持股比率(%)	0.11%	1.90%	17.82%	46.95%	33.22%	100%

(三)股權分散情形

1.普通股

107年3月30日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率%
1 至 999	4,631	266,958	0.12
1,000 至 5,000	9,116	17,565,054	7.77
5,001 至 10,000	1,144	8,799,292	3.89
10,001 至 15,000	364	4,494,864	1.99
15,001 至 20,000	229	4,248,980	1.88
20,001 至 30,000	201	5,049,453	2.23
30,001 至 50,000	169	6,580,751	2.91
50,001 至 100,000	142	10,172,577	4.50
100,001 至 200,000	98	14,032,745	6.20
200,001 至 400,000	57	15,861,897	7.01
400,001 至 600,000	24	11,584,036	5.12
600,001 至 800,000	10	6,854,116	3.03
800,001 至 1,000,000	7	6,178,818	2.73
1,000,001 股以上	40	114,478,659	50.62
合 計	16,232	226,168,200	100.00

2.特別股：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱，
持股數額及比例

107年3月30日；單位：股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司		24,644,257	10.90%
吳啟勇		7,665,809	3.39%
高國棟		6,701,176	2.96%
渣打託管歐洲瑞信證券—文藝復興長期銷售		6,620,000	2.93%
啟盛投資股份有限公司		5,172,703	2.29%
財團法人國家文化藝術基金會		4,538,000	2.01%
花旗(台灣)託管新加坡政府投資專戶		3,354,000	1.48%
花旗託管 BNP 投資操作 SNC 投資專戶		2,932,290	1.30%
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶		2,794,075	1.24%
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶		2,786,483	1.23%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項 目		年 度		105 年	106 年	當年度截至 107 年 3 月 31 日
每 股 市 價 (註 1)	最 高			56.40	84.50	88.00
	最 低			46.90	49.20	68.10
	平 均			51.15	59.11	78.96
每 股 淨 值 (註 2)	分 配 前			17.62	18.12	19.49
	分 配 後			14.12	註 8	註 8
每 股 盈 餘	加 權 平 均 股 數 (仟 股)			226,168	226,168	226,168
	每 股 盈 餘 (註 3)			3.47	4.10	1.00
每 股 股 利	現 金 股 利			3.50	註 8	—
	無 償 配 股	盈 餘 配 股		—	註 8	—
		資 本 公 積 配 股		—	註 8	—
	累 積 未 付 股 利 (註 4)			—	—	—
投 資 報 酬 分 析	本 益 比 (註 5)			14.74	14.42	—
	本 利 比 (註 6)			14.61	註 8	—
	現 金 股 利 殖 利 率 (註 7)			6.84%	註 8	—

註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：106 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 106 年度盈餘分配中，以未分配盈餘分配，股東紅利新台幣 822,347,575 元全數以現金發放，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金紅利新台幣 3.636 元，另以法定盈餘公積分配，法定盈餘公積新台幣 104,942,045 元，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金新台幣 0.464 元，前述以未分配盈餘及法定盈餘公積分配予股東，以現金發放合計新台幣 927,289,620 元，合計每股擬配發現金新台幣 4.10 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依上述公司章程規定比例提供員工及董事酬勞，帳列當期費用項下，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，於決議年度將差異金額帳列當期費用項下調整之。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)經董事會通過分派 106 年度員工及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣 111,567,218 元及董事酬勞新台幣 12,286,360 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

105 年度員工酬勞提列金額為新台幣 94,738,024 元、董事酬勞提列金額為新台幣

10,526,446 元，皆係以現金發放，其中 105 年度以董事酬勞科目發放金額為新台幣 10,416,446 元，差異係帳列科目調整。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容：前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：前各次發行或私募有價證券截至年報刊印日前一季止之執行情形及與原預計效益之比較：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司為國內專業微控制器 IC 設計領導廠商，營業範圍主要包括微控制器 IC 及其週邊 IC 之設計、研發與銷售，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

產品別	年度
	106 年度
微控制器 IC	74%
週邊 IC	26%
合計	100%

3. 目前產品及服務項目

本公司自有開發重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式標準型及嵌入式 MCU、螢幕顯示 IC 產品、電源管理 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、通訊 IC 產品、RF IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、觸控開關 IC 產品、語音 IC 產品、健康量測產品、安防產品、馬達控制產品、物聯網及金融相關產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性特殊需求的滿足。

另外，本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類之市場需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品之應用範圍擴大到 4C+MG(Medical & Green)領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) 超低工作電壓 1.1V 的 R-F Flash MCU。
- (2) AEC-Q100 高溫 105°C 車規 Flash MCU 認證規劃，正式向車用電子領域邁進。
- (3) EPD Flash MCU。
- (4) 工作電壓 1.8V~5.5V A/D 型及 LCD 型 Flash MCU。
- (5) 高壓 12V A/D 型系列 Flash MCU，內含 LDO 穩壓電路及高壓輸出。
- (6) 24 位元 Delta Sigma A/D with LCD 型 Flash MCU。
- (7) 4.0 代 Touch Key Flash MCU，增強 MCU 抗干擾能力且可達到 CS 動態 6V

Pass 要求。

- (8) 整合電容式感應觸控按鍵+大功率功放語音 Flash MCU 系列。
- (9) 整合人機界面操作的電容感應式觸控 Flash MCU 系列性解決方案。
- (10) 9V 高壓直推型觸控 Flash MCU 解決方案。
- (11) 針對手持穿戴式裝置開發極低功耗之觸控 Flash MCU。
- (12) 各種醫療量測 MCU 及解決方案。
- (13) 嵌入式高精度溫度量測電路。
- (14) 嵌入式 R type 血壓感測模組。
- (15) Proximity Sensor Flash MCU 解決方案。
- (16) 小家電電源專用 MCU 及解決方案。
- (17) 半橋電磁爐/微波爐專用 MCU 及解決方案。
- (18) 移動電源充放電管理專用 MCU 及解決方案。
- (19) 快速充電與識別專用 MCU 及解決方案。
- (20) 中功率無線充電器專用 MCU 及解決方案。
- (21) 鋰電池充放電與太陽能電池管理及解決方案。
- (22) 動力型電池充電器專用 MCU 及解決方案。
- (23) 三節鋰電池保護專用 MCU(SoC)及解決方案。
- (24) AC 電源穩壓 AVR 專用 MCU 及解決方案。
- (25) 安防產品及消防產品之專用 MCU 及解決方案(例：CO 偵測器、感煙/感溫火災探測報警器、PIR/uWave 偵測感應探測器)。
- (26) 超低 RTC 耗電流的標準型 Flash MCU。
- (27) 高資源、大程序空間的標準型 8 位元 Flash MCU。
- (28) 單路及多路可串接的 RGB LED 驅動專用 MCU 及解決方案。
- (29) CAN Bus Flash MCU 及解決方案。
- (30) 高精準 TDC 量測 Flash MCU 及解決方案。
- (31) 超聲波霧化器 Flash MCU 及解決方案。
- (32) E-Banking MCU。
- (33) 加解密 IC 及 MCU。
- (34) 馬達控制 MCU。
- (35) 馬達驅動器系列產品。
- (36) 超聲波流量計 ASSP MCU。
- (37) 超音波測距/倒車雷達專用 MCU。
- (38) 語音 Flash MCU。
- (39) 音樂+語音 Flash MCU 整合 SoC 平台及方案。
- (40) NFC ASSP MCU。
- (41) Voice Flash MCU with Power Amplifier。
- (42) FRS Audio Processor 專用式 Flash MCU 整合 SoC 方案。
- (43) Radio with Audio Processor+ Amplifier 專用無線電 Flash MCU SoC 方案。
- (44) RF Sub-1GHz 及 OOK 超再生接收 I/O+A/D Flash MCU 解決方案。
- (45) RF Sub-1GHz 及 OOK 超外差接收 IC。

- (46) RF Sub-1GHz 及 FSK/GFSK Transceiver 雙向收發 IC。
- (47) RF Sub-1GHz 及 OOK+FSK 無線發射 Flash MCU SoC 方案。
- (48) RF Sub-1GHz TPMS OOK+FSK 無線收發+溫度傳感 Flash MCU SoC 方案。
- (49) RF 2.4GHz 雙向 GFSK IC。
- (50) RF 2.4GHz 雙向 GFSK Flash SoC MCU。
- (51) 低功耗藍牙(BLE)透傳控制器。
- (52) 低功耗藍牙(BLE)透傳 32-bit M0+ Flash MCU。
- (53) LoRa 模塊方案。
- (54) USB Full Speed Flash MCU 系列。
- (55) USB Low Speed Flash MCU 系列。
- (56) USB Bridge 系列 IC。
- (57) USB RGB LED 調色鍵盤 ASSP MCU。
- (58) USB Data Logger Flash MCU 系列。
- (59) 32 位元 MCU 之物聯網應用開發平台及解決方案。
- (60) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及解決方案。
- (61) 32 位元 MCU 產品推出以 ARM® Cortex™-M0+及 M3 核心之 Flash 微控制器。
- (62) 工作電壓 2.5V~5.5V 以 ARM® Cortex™-M0+為核心之 Flash MCU。
- (63) 操作速度可達 96MHz 以 ARM® Cortex™-M3 為核心之 Flash MCU。
- (64) LED 照明驅動 IC。
- (65) 標準 OPA 產品開發。
- (66) Class D Amp 產品開發。
- (67) 電源管理 IC(LDO/DC-DC/AC-DC)。
- (68) 高壓總線傳輸 IC。
- (69) 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)及其 LVDS 介面。
- (70) 金融機具之高速雙面 CIS 類比前置處理器(AFE)。
- (71) 金融機具之高速雙面多通道 CIS 數位前置處理器(DFE)暨其時序產生器。
- (72) 金融機具之高速雙面 CIS 類比前置處理器(AFE)暨其數位前置處理器(DFE)及時序產生器。
- (73) 金融機具之高速貨幣序號(冠字碼)讀出暨影像辨識處理器及其解決方案。
- (74) 高精度穿戴式裝置前置類比處理器(AFE)暨可編程數位濾波器(DF)及快速傅立葉轉換(FFT)。
- (75) 大陸地區新國網電錶管理芯和計量芯 ASSP MCU 開發。
- (76) 霍爾(Hall)元件 SoC 整合 IC。
- (77) 穿戴式周邊整合 IC。
- (78) USB PD ASSP 32 位元 MCU 及行動電源解決方案。
- (79) AC 穩壓電源 ASSP MCU 及解決方案。
- (80) 模組產品類：

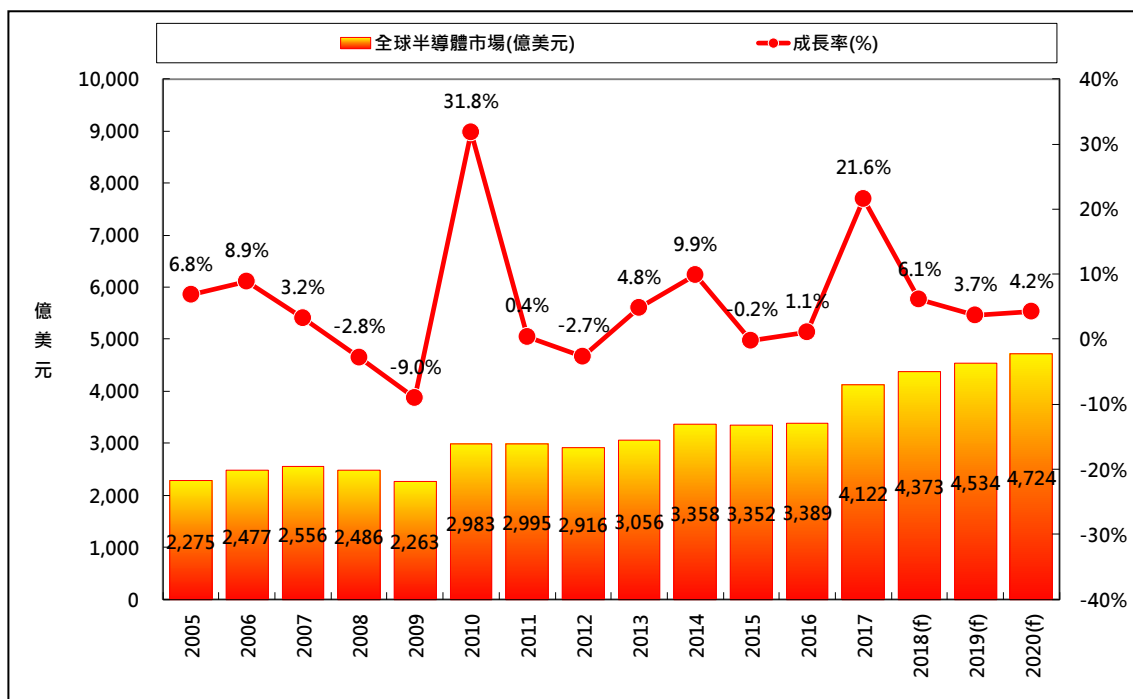
結合各類感測器的應用，並具有需求高精度、需複雜的量產特性校正、特殊小尺寸或應用技術門檻高等性質的應用產品(例：焦電型紅外線感測器人體紅外線感測(PIR)模組、溫濕度感測器模組、霍爾式磁角度感測模組等)。

(二) 產業概況：

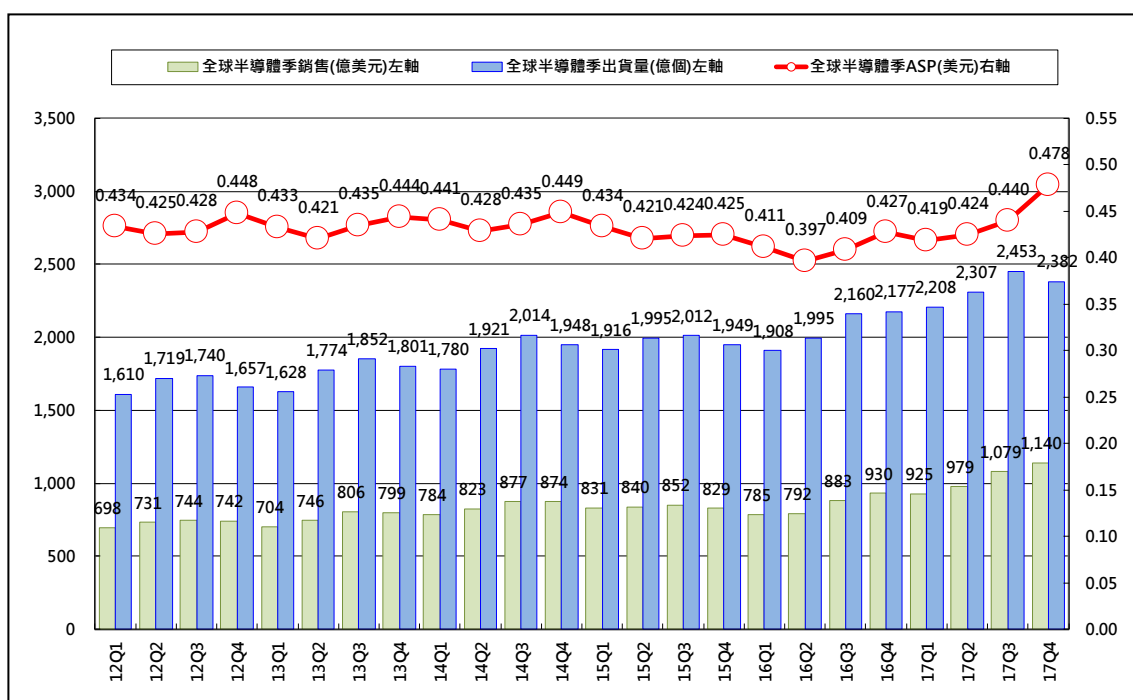
1. 產業之現況與發展

(1) 全球半導體產業市場：

根據全球半導體貿易統計協會(WSTS)統計 2017 年全球半導體銷售額達 4,122 億美元(YoY +21.6%)，其中，積體電路於 2017 年全球銷售額達 3,432 億美元(YoY +24%)，2017 年寫下 2010 年以來首次的兩位數增長紀錄，並預估 2018 年全球各類半導體產品銷售額仍會繼續成長。



資料來源：WSTS；工研院 IEK(2018/02)



資料來源：WSTS；工研院 IEK(2018/02)

根據 WSTS 統計，2017 年美國半導體市場總銷售值達 885 億美元，較 2016 年成長 35.0%；日本半導體市場銷售值達 366 億美元，較 2016 年成長 13.3%；歐洲半導體市場銷售值達 383 億美元，較 2016 年成長 17.1%；亞洲區半導體市場銷售值達 2,488 億美元，較 2016 年成長 19.4%。2017 年全球半導體市場全年總銷售值達 4,122 億美元，較 2016 年成長 21.6%。

SEMI(國際半導體產業協會)表示 2017 年半導體是創紀錄的一年，較前一年有 20% 的成長。在持續不斷新技術、新產能的需求下，SEMI 樂觀預期 2018 年全球半導體市場將再創新高，直到 2019 年則整體市場將挑戰 5,000 億美元紀錄。

展望 2018 年，國際研究暨顧問機構(Gartner)表示，2018 年全球半導體營收預估將達到 4,510 億美元，相較 2017 年的 4,190 億美元增加 7.5%。除了記憶體市場強勁氣勢蔓延持續至 2018 年外，帶動 2018 年營收攀升的另外元件類別則是特殊應用標準產品(ASSP)。過去影響 ASSP 成長預估值的因素包括：電競 PC 和高效能運算應用所使用的繪圖卡前景好轉、車用內容大幅增加，以及有線通訊相關的表現預估更為強勁。此外，由於零組件缺貨、材料清單(BOM)成本上揚，導致廠商最後必須提高平均售價(ASP)，此情勢將造成 2018 年全年市場走勢震盪多變。

(2) 臺灣半導體產業市場：

依據臺灣半導體協會委託工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)，於臺灣半導體產業回顧與展望報告中敘述：

工研院 IEK 統計 2017 年第四季(17Q4)台灣整體 IC 產業產值(含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試)達新台幣 6,755 億元(USD\$22.2B)，較上季(17Q3)成長 5.1%，較去年同期(16Q4)成長 4.9%。其中 IC 設計業產值為新台幣 1,608 億元(USD\$5.3B)，較上季(17Q3)衰退 3.1%，較去年同期(16Q4)成長 0.6%；IC 製造業為新台幣 3,890 億元(USD\$12.8B)，較上季(17Q3)成長 10.4%，較去年同期(16Q4)成長 7.9%，其中晶圓代工為新台幣 3,430 億元(USD\$11.3B)，較上季(17Q3)成長 10.5%，較去年同期(16Q4)成長 9.3%，記憶體與其他製造為新台幣 460 億元(USD\$1.5B)，較上季(17Q3)成長 9.5%，較去年同期(16Q4)衰退 1.7%；IC 封裝業為新台幣 870 億元(USD\$2.9B)，較上季(17Q3)成長 0.6%，較去年同期(16Q4)成長 1.4%；IC 測試業為新台幣 387 億元(USD\$1.3B)，較上季(17Q3)成長 1.8%，較去年同期(16Q4)成長 1.8%(新台幣對美元匯率以 30.4 計算)。

工研院 IEK 統計 2017 年台灣 IC 產業產值達新台幣 24,623 億元(USD\$81.0B)，較 2016 年成長 0.5%。其中 IC 設計業產值為新台幣 6,171 億元(USD\$20.3B)，較 2016 年衰退 5.5%；IC 製造業為新台幣 13,682 億元(USD\$45.0B)，較 2016 年成長 2.7%，其中晶圓代工為新台幣 12,061 億元(USD\$39.7)，較 2016 年成長 5.0%，記憶體與其他製造為新台幣 1,621 億元(USD\$5.3B)，較 2016 年衰退 11.8%；IC 封裝業為新台幣 3,330 元(USD\$11.0B)，較 2016 年成長 2.8%；IC 測試業為新台幣 1,440 億元(USD\$4.7B)，較 2016 年成長 2.9%(新台幣對美元匯率以 30.4 計算)。

2017 年臺灣 IC 產業產值統計結果

單位：億新台幣	17Q1	季成長	年成長	17Q2	季成長	年成長	17Q3	季成長	年成長	17Q4	季成長	年成長	2017	年成長
IC 產業產值	5,714	-11.3%	5.0%	5,726	0.2%	-4.8%	6,428	12.3%	-2.5%	6,755	5.1%	4.9%	24,623	0.5%
IC 設計業	1,398	-12.5%	-3.7%	1,506	7.7%	-11.3%	1,659	10.2%	-7.0%	1,608	-3.1%	0.6%	6,171	-5.5%
IC 製造業	3,208	-11.0%	8.6%	3,060	-4.6%	-3.7%	3,524	15.2%	-1.8%	3,890	10.4%	7.9%	13,682	2.7%
晶圓代工	2,849	-9.2%	14.4%	2,678	-6.0%	-2.1%	3,104	15.9%	-0.6%	3,430	10.5%	9.3%	12,061	5.0%
記憶體製造	359	-23.3%	-22.5%	382	6.4%	-13.4%	420	9.9%	-9.7%	460	9.5%	-1.7%	1,621	-11.8%
IC 封裝業	770	-10.3%	5.5%	825	7.1%	3.1%	865	4.8%	1.8%	870	0.6%	1.4%	3,330	2.8%
IC 測試業	338	-11.1%	10.8%	335	-0.9%	-1.5%	380	13.4%	1.3%	387	1.8%	1.8%	1,440	2.9%
IC 產品產值	1,757	-15.0%	-8.3%	1,888	7.5%	-11.7%	2,079	10.1%	-7.6%	2,068	-0.5%	0.1%	7,792	-6.9%
全球半導體成長率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.6%

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2018/02)

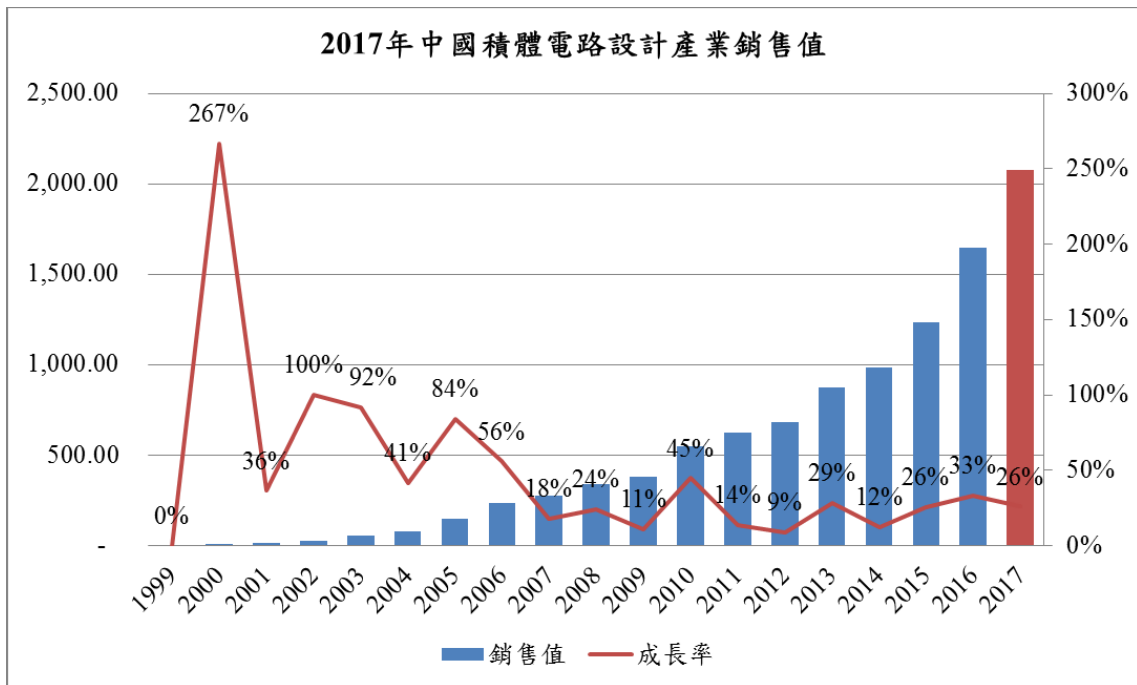
2014 年~2018 年台灣 IC 產業產值

單位：億新台幣	2014	2014 成長率	2015	2015 成長率	2016	2016 成長率	2017	2017 成長率	2018(e)	2018(e) 成長率
IC 產業產值	22,033	16.7%	22,640	2.8%	24,493	8.2%	24,623	0.5%	26,050	5.8%
IC 設計業	5,763	19.8%	5,927	2.8%	6,531	10.2%	6,171	-5.5%	6,578	6.6%
IC 製造業	11,731	17.7%	12,300	4.9%	13,324	8.3%	13,682	2.7%	14,492	5.9%
晶圓代工	9,140	20.4%	10,093	20.4%	11,487	13.8%	12,061	5.0%	12,672	5.1%
記憶體製造	2,591	9.2%	2,207	-14.8%	1,837	-16.8%	1,621	-11.8%	1,820	12.3%
IC 封裝業	3,160	11.1%	3,099	-1.9%	3,238	4.5%	3,330	2.8%	3,480	4.5%
IC 測試業	1,379	8.9%	1,314	-4.7%	1,400	6.5%	1,440	2.9%	1,500	4.2%
IC 產品產值	8,354	16.3%	8,134	-2.6%	8,368	2.9%	7,792	-6.9%	8,398	7.8%
全球半導體成長率	-	9.9%	-	-0.2%	-	1.1%	-	21.6%	-	6.1%

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2018/02)

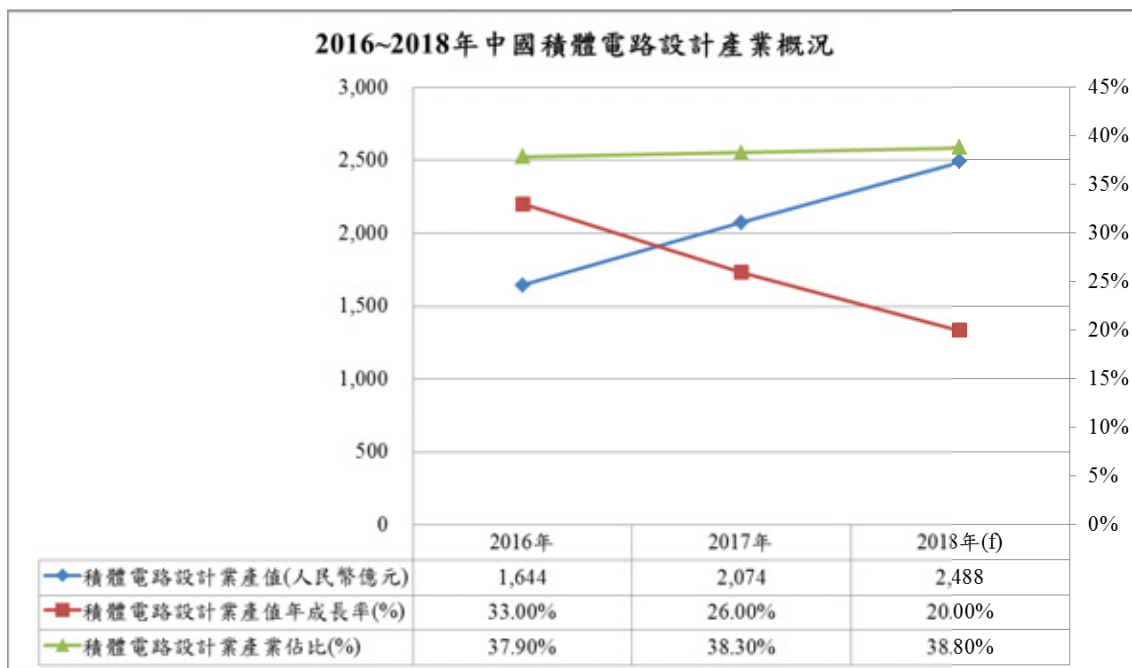
(3) 中國半導體產業市場：

根據中國半導體行業協會統計，2017 年中國積體電路產業銷售額為人民幣 5,411.3 億元，較去年增長 24.8%。其中，積體電路製造業增速最快，2017 年較去年增長 28.5%，銷售額達到人民幣 1,448.1 億元，積體電路設計業和積體電路封測業繼續保持快速增長，增速分別為 26.1%(如下圖)和 20.8%，銷售額分別為人民幣 2,073.5 億元和人民幣 1,889.7 億元。根據海關統計，2017 年中國積體電路進口 3,770 億顆，較去年增長 10.1%，進口金額 2,601.4 億美元，較去年增長 14.6%；2017 年中國積體電路出口 2,043.5 億顆，較去年增長 13.1%，出口金額 668.8 億美元，較去年增長 9.8%。



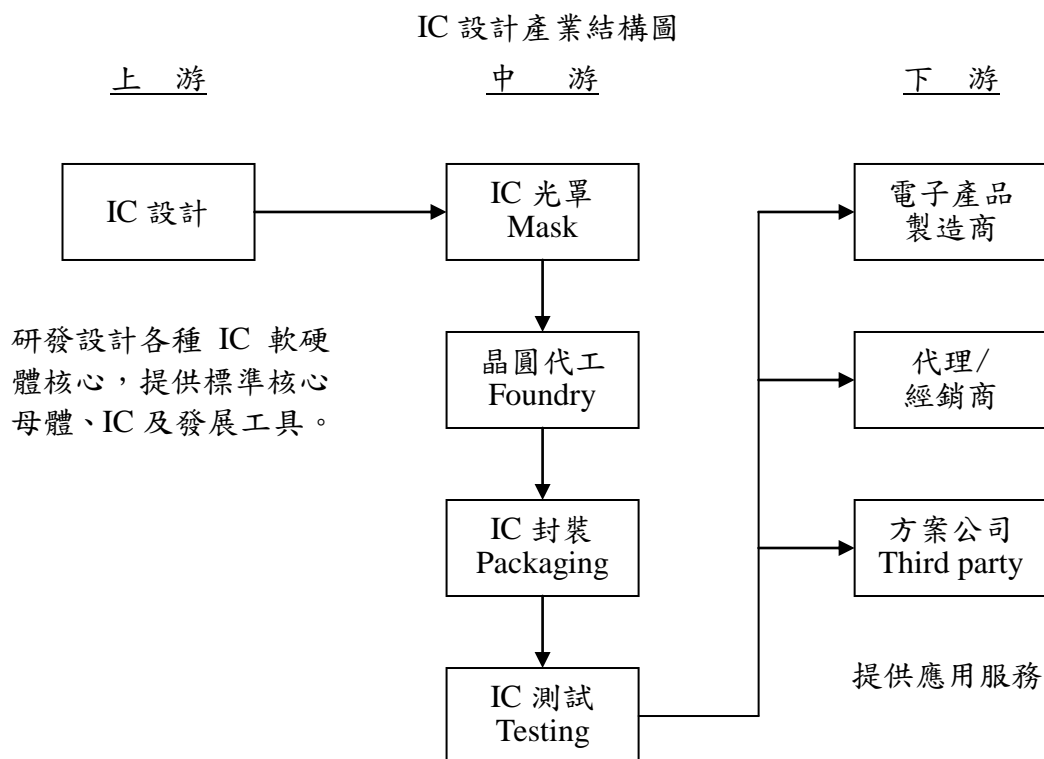
另外，根據設計分會理事長魏少軍教授於“中國整合電路設計業 2017 年會”表示中國積體電路設計業仍面臨嚴峻挑戰，一是提供的產品尚無法滿足市場需求，中國之微控制器及存儲器等高端晶片尚未成熟，相關晶片佔中國集成電路進口近 70%；二是中國積體電路設計業的主流設計尚未擺脫跟隨，總體技術路線跟在別人後面亦步亦趨的現狀沒有根本改變，產品創新能力有待提高；三是在 CPU、DSP 和 FPGA 等高端晶片上，由於技術水準差距較大，尚不具備與國際主要玩家同台競爭的實力，同時迫於壓力，不得不把主攻方向轉向特定市場，久而久之競爭能力和意識下滑；四是整體產業勢力仍然不強，行業銷售總和佔全球 7.5%；五是人才情況不容樂觀，2017 年設計業的人均產值剛剛超過 20 萬元。

展望 2018 年，根據 TrendForce 研究報告預估 2018 年產值有望突破人民幣 2,400 億元，維持約 20% 的年增速。由於中國積體電路設計產業在提升自給率、政策支援、規格升級與創新應用三大要素的驅動下，將保持高速成長態勢，其中，中低階產品在中國本土市場占有率持續提升，國產化的趨勢將越加明顯。另一方面，國家及地方政府將持續擴大資金與政策支援力道，第二期大基金正在募集中，且會加大對積體電路設計產業的投資佔比，同時選擇一些創新的應用終端企業進行投資。此外，科技的發展也引領終端產品規格升級，物聯網、AI、汽車電子等創新應用對積體電路產品的需求不斷擴大，也將為 2018 年積體電路設計產業帶來成長新動力。



資料來源：TrendForce, 2017/12

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、智能家電、工業設備、健康量測及物聯網產品等領域使用：

主要產品	用途
微控制器(MCU)產品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以 ARM Cortex-M0+為核心之系列 32 位元 Flash MCU。 2. 以 ARM Cortex-M3 為核心之系列 32 位元 Flash MCU。 3. HT8 為核心之系列 8 位元 Flash MCU。 4. BS 系列 8 位元觸控 Flash MCU。 5. 各式 ASSP 及 ASIC MCU。 6. CAN Bus interface MCU。
RF SoC 微控制器(MCU)產品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無線對講機、電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線遙控和防盜。 2. 低功耗藍牙(BLE)透傳控制的健康量測產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。 3. Sub-1GHz 展頻無線通信 LoRa 模塊產品、智能四錶等 IoT 產品及應用。
家電產品類	各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU 及各類家電觸控按鍵 MCU。
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge、PDF Data Logger 等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音&家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器、穿戴式產品顯示器及定電流 LED 顯示器等。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、煙感器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(刮鬍刀、鼻毛刀、潔面儀、電動剪髮器)及手電筒等 ASSP MCU。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身分證等有掃描辨識需求之相關金融機具，例：點驗鈔機、清分機、ATM 機、EPD Flash MCU 及身分證鑑別儀等。
物聯網產品類	基於 Wi-Fi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 Flash MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。並輔以雙核 32 位元 DSP 提供人臉辨識、車牌辨識等系統方案。
安防產品類	感煙/感溫火災探測報警器、PM2.5 感測器、CO/GAS 探測報警器及 PIR/uWave 感測器等。
健康量測產品類	血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、紅外線測溫、霧化器、接近感應器等。

4. 競爭情形

今年來由於市場資金投資標的轉向、IC 設計門檻提高、人才不足、手機供應鏈被取代等因素，成為 IC 設計廠商家數不增反減的主要原因。另外，終端晶片市場價格易跌難漲，及晶片毛利率節節敗退的主因，主要來自於競爭，競爭一多，降價壓力自然大，少則壓力較輕，甚至競爭者為鞏固市場佔有率，策略性調降晶片售價，反觀中國，成立公司的門檻低，加上中國政府發布《國家積體電路產業發展推進綱要》和《中國製造 2025》，為中國 IC 產業實現跨越式發展注入了強大動力，截至 2017 年，中國已有約 1,380 家設計企業 IC 設計公司，台灣面對的同業競爭壓力隨之升高。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	106 年度	107 年第一季
研發費用	742,929	188,305
營業收入	4,614,917	1,085,701
研發費用佔營業收入比率(%)	16%	17%

註 1：當年度截至 107 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料

2. 開發成功之技術或產品

本公司以每年約營業額的 15%~20% 投入新產品與新技術研發，藉由新產品的持續導入來創造公司營業額的穩定成長與利潤的提升。

2017 年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下：

(1) 新一代 8 位元 MCU

- A. 1.8V ~ 5.5V 低工作電壓 Flash 型系列：支援更低的工作電壓，內建 AD 及 LCD 功能，適用電池類產品。
- B. 內建多級運算放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器、自動感應水龍頭等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，Flash Touch MCU 系列可多次 ICP(In Circuit Programming)燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 低功耗標準型系列(TinyPower™ MCU)：本系列產品具備與國際大廠同等級之低功耗能力，符合環保潮流，適合於各種採用電池電源之可攜式產品。
- E. 健康量測產品：鎖定血壓、血糖、血氧、體溫、體重與體脂肪、保健與照

護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與先進 USB 與語音介面，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。

- F. 完成伺服馬達(Servo Motor，或稱為舵機)專用 MCU 之開發，從控制方式可分成 PWM 舵機與 UART 舵機，皆已完成調參平台開發，用戶可使用該平台輕易達成舵機產品開發。在機器人之 UART 舵機的通訊協定也已開發完成，已被智能機器人大廠評估。
- G. 完成無刷直流馬達(Brushless DC, BLDC) Motor 控制 MCU，應用於節能風扇上，達到節能、線性控速與低噪音效果。
- H. 無線充電產品系列：除已開發完成 5W 無線充電低功率產品外，新增符合 WPC 中功率無線充電 ASSP MCU，可完全符合 Qi 15W 中功率需求。

以上各系列 MCU 最低均達工業等級規格(寬溫運作範圍達到 -40°C ~ $+85^{\circ}\text{C}$)，抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛客戶的認可。

(2) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + Voice Flash MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，軟體語音解壓縮技術，並內置 HOLTEK 電容式觸控按鍵使用，及軟體 LCD 功能，減化客戶應用技術門檻及整合多項分離 IC 器件應用，提高產品的便利性及完整性。
- C. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與高精度 12-bit 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。
- D. 超聲波霧化器 Flash MCU：內建自動追頻、無水上電、缺水檢測等功能，能配合各種不同頻率之霧化片(100KHz、1.7MHz、2.4MHz、3MHz 等)，完整支援霧化器所需，有效降低客戶成本。
- E. 完成 2.0 代動力型充電器控制 Flash MCU：內建二組 OPA、DAC，經由軟體改變 DAC，MCU 透過 OPA 控制一次側 PWMIC，進行電池恆壓(CV)/恆流(CC)硬體控制，適用於 e-bike 或電動工具鉛酸/鋰電池充電器產品。
- F. 電源管理暨驅動產品：
 - (A) 高耐壓/高精準度/低功耗/大電流驅動線性穩壓器：工作電壓高達 40V，超高 $\pm 1\%$ 精準度，低於 1uA 工作電流及最高達 500mA 相關線性穩壓產品，可廣泛使用於消防安全、工業控制、金融商品、車用電子等應用領域，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
 - (B) 低功耗/大電流驅動升壓型轉換器：超低 0.7V 工作電壓，最高達 3A 輸出電流，適用於乾電池及鋰電池相關應用產品，如電動刮鬍刀、健康

醫療檢測、行動電源、無線聯網的水/電能/燃氣/熱能錶應用等，可延長電池壽命及提供系統穩定可靠電源。

- (C) 高耐壓/大電流驅動降壓型轉換器：工作電壓高達 52V，最大 3A 輸出電流，可廣泛使用於智能電錶、電動機車、無線路由器等應用領域，提供系統穩定可靠電源。
- (D) 低功耗/低成本交流-直流電壓轉換器：最大耐壓達 700V，精簡外圍線路提供具成本競爭力方案，廣泛使用於小家電領域產品，如電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲等。
- (E) 高功因/大電流驅動 AC-DC LED 照明驅動器：內建 QR 模式操作，最高達 0.98 功率因素，最高可驅動 200 瓦 LED 燈具負載，廣泛應用在球泡燈、筒燈、平板燈、智能 LED 燈具等應用。
- (F) LED 照明驅動 IC：使用於一般 LED 照明，可應用在 T8 燈管、E27 球泡燈等。

G. 電源管理產品：

- (A) $\pm 3\%$ 精準度 30mA/100mA/250mA/300mA/500mA 低功耗穩壓 IC：廣泛使用於各類型電子產品，如：可攜式或插電式省電型產品等，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
- (B) $\pm 1\%$ 精準度 30mA/100mA 低功耗穩壓 IC：提供高輸入耐壓及低功耗電源穩壓 IC，精準的輸出電壓可提升系統產品特性，適合用於更高階電子產品。
- (C) 100mA/200mA/300mA/350mA 同步整流直流升壓轉換：使用於可攜式高效率需求產品。
- (D) 2A/3A 非同步 Step-Down DC-DC：使用於直流降壓大電流輸出產品，如網通、數位相框、LCD TV、USB 充電等產品。
- (E) AC-DC Converter IC：應用在市電(交流電)轉換成直流電的家電產品，包括電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲電源等。
- (F) LED 照明驅動 IC：使用於一般 LED 照明，可應用在 T8 燈管、E27 球泡燈等。

H. Real Time Clock IC：可使用在各種需要計數時間的產品，例如：電錶、水錶、煤氣錶、考勤及門禁設備、計費電話、收銀機、MP3、數位相框、辦公室自動化產品、家電產品、電腦產品等。

I. Remote Control Encoder IC：可使用在汽車防盜、機車/電動車防盜、家庭防盜及大門、窗簾、門鈴、家電之遙控。

J. 超聲波流量計 ASSP MCU：整合 TDC 等類比 IP 並提供通訊介面(SPI/UART/I²C)，內建流量演算法及溫度量測等相關技術，降低客戶應用技術門檻，提高產品之便利性。

K. 完成 USB PD 32 位元 MCU 開發，應用於 30W~45W 車充產品，整合同步式升降壓管理與安全保護機制，達到高轉換效率、電路精簡等效果。

L. 完成快速無線充電 ASIC MCU 開發，針對無線充電特殊規格設計，可應用於多線圈與 10W 無線充電方案。

- M. 完成 400mA 線性充電 IP 開發，此 IP 與 8-bit MCU SoC 整合後，可應用於鋰電池各項產品。
- N. 高壓總線資料傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比 IP，提供解調變資料輸入及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，以提高產品的便利性及完整性。
- O. 雙核 32 位元 DSP IC：整合雙核 DSP、影像處理加速器、類神經網路及 DDR 控制器等，提供影像辨識如鈔票、證件、人臉、車牌等相關辨識的應用方案。

(3) 電腦週邊產品

- A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
- B. USB Bridge 系列 IC。
- C. 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)系列。
- D. USB 2.0 Low Speed MCU 系列。
- E. PDF Data Logger MCU。
- F. 電競鍵盤及滑鼠 RGB LED ASSP Flash MCU。

(4) 無線產品

- A. 無線對講機控制器：內建 DSP 與音頻類比電路之 SoC Flash MCU，適用於類比式專用及 FRS 對講機。
- B. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
- C. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 接收超再生及超外差模式電路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。
- D. 2.4GHz 無線 MCU：整合 2.4G RF 電路之 Flash MCU，適用於具備抗干擾能力、雙向傳輸等應用。
- E. 低功耗藍牙(BLE) MCU：整合高性能的射頻、調製解調器及 32 位元 M0+Flash MCU，並內建 DC/DC 及 LDO，支援寬廣範圍的單電源供電，適用於低功耗的健康醫療產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。
- F. 32 位元標準型 MCU 系列：新增 External Bus Interface (EBI)、I²S 界面與 CRC-16/32，EBI 可提供客戶系統的擴充性如外擴 NOR Flash、SRAM、LCD Panel 8080/6800 Modes 及各種 Memory Mapped 的元件。I²S 方便客戶開發多媒體語音應用相關產品，CRC-16/32 則可加速客戶開發的產品取得歐盟家電產品安規認證；新增 Crystal-less USB 的功能可降低客戶開發產品成本。
- G. NFC Flash MCU。

(四)長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司經營團隊擁有超過 30 年豐富的 IC 設計產業經驗，熟知客戶及市場需求，並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援，同時在臺灣/中國/美國建立當地銷售及技術服務據點。因此，本公司擁有高產品競爭力在於提供客戶：

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

(2)生產策略：

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊，以便即時掌控生產的進度及數量，達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略：

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主，加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上，提供客戶多元化的彈性選擇。一次購足的便利性以及優異的性能與價格比，使客戶的產品具有強大之市場競爭力。
- B. 以策略性產品作為消費市場發展主軸，導入利基型產品，提供差異化服務。
- C. 本公司以整體系統成本的角度出發，協助客戶降低整體成本以達到雙贏的目的。

(4)研發策略：

本公司將 MCU 核心架構在不同製程平台，並搭配特殊 IP 技術及重要關鍵技術，達到小型化 SoC，在整合過程加強抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準，已進行 105°C 高溫 AEC-Q100 認證，並朝車用電子規範產品延伸。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略鎖定以家電、健康量測、PC 相關周邊、安防、馬達控制與金融領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質及快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功地將 HOLTEK 微控制器順利導入全球著名家電大廠，建立起 HOLTEK 全球化的專業品牌形象。公司在 8 位元 MCU 已獲得大廠的認同並導入量產，除了持續精

進 8 位元 MCU 產品外，長期亦將持續導入 32 位元 MCU，持續將市佔率擴大，32 位元 MCU 產品於 2017 年已達 1 千萬顆，期許未來能在 MCU 領域追求更卓越的成績。

(2)生產策略：

- A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。
- B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢，並持續提升良率及市場競爭力。

(3)產品策略：

- A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。
- B. 切入更高階或高附加價值之應用領域，如高階大小家電、工業設備、安全防護、車用電子等設備領域。

(4)研發策略：

提升產品設計能力，並因應市場應用需求，建立規格化與模組化之開發技術，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市之時間並提高價格競爭力。

(5)產品發展項目：

- A. 發展全系列 1.8V~5.5V A/D 型及 LCD 型 Flash MCU，擴充更寬廣的電壓應用領域。
- B. 發展全系列 Tiny Power MCU：整合 Tiny Power 技術於各式 MCU 中降低功耗，達成節能效益。
- C. 發展全系列 Flash MCU：如 I/O、A/D、LCD、A/D with LCD、Tiny Power MCU，提供客戶多樣選擇。
- D. 發展更多應用在健康量測領域的專用 MCU：如血糖儀、血壓計、體脂計、血氧計等應用。
- E. 發展觸控專用 MCU，擴大觸控應用領域。
- F. 發展更高階 IP 整合之 MCU：邁向更高階解析度類比數位轉換 (24 位元 Delta Sigma AD Converter)。
- G. 發展局部鎖住(Partial Lock)標準型 MCU：局部鎖住 MCU 提供方案公司彈性的智慧財產保護機制，滿足多方分工但各自保密需求，保護具特殊專才供應商智慧財產，刺激產業正面發展，產品應用多樣化，進而擴大市場需求。
- H. 發展 PC 週邊 USB 產品：除了持續發展 PC 週邊 Keyboard/Mouse 外，規劃 USB Full Speed 系列 MCU，並擴大 USB 產品應用，如 USB Gaming MS & KB/USB Bridge/PDF Data Logger 等。
- I. 發展更具競爭力 Voice MCU：提供更多播放/錄音功能的 Voice MCU，方便客戶開發更高品質的消費性商品，含高功率 1.2W 以上 A/B 類功放整合 Voice 控制及帶電容式觸控 MCU 產品。
- J. 發展全系列高壓 12V A/D 型 Flash MCU：內含 LDO 穩壓電路及高壓輸出，

- 可直接推動繼電器等控制元件。
- K. 發展整合型 Sub-1GHz RF SoC Flash MCU 產品。
 - L. 發展適用於各項通訊技術之 MCU：如通用型 2.4GHz、電力線傳輸、FRS、Zigbee、NFC、UHF 頻段無線通訊等技術以衍生出各式各樣的應用產品，開發適用於此類 SoC 應用產品的 MCU 為未來之發展方向之一。
 - M. 發展 32 位元多腳位標準型 MCU 系列：新增 External Bus Interface，方便客戶系統的擴充性如外擴 NOR Flash、SRAM、LCD Panel 8080/6800 Modes 及各種 Memory Mapped 的元件。
 - N. 發展新一代 32 位元馬達控制及指紋辨識系列 MCU：提升運行速度至 96MHz，系統記憶體 Flash 與 SRAM 都加大一倍，以擴大市場的覆蓋率。另外，增 AES 加解密功能、CRC 運算功能及 IS 語音應用界面與 SDIO 及 EBI 界面，可方便客戶開發各種具語音多媒體功能與有線/無線資料傳輸等功能的相關產品。
 - O. 發展 32 位元低功耗標準型 MCU 系列並結合各項無線傳輸技術：目標是應用在物聯網與穿戴式設備。
 - P. 開發電子貨架標籤(ESL)面板顯示驅動 IC：配合電子紙及 LCD 客戶開發專用 IC；同時推出定電流 LED 顯示器驅動 IC，應用於 Key Board、律動燈、音響。
 - Q. 推出 ARM[®] Cortex[™]-M0+核心之 32 位元 Flash 微控制器 HT32F523xx 系列和 HT32F522xx 系列產品。全系列均搭配多組高速週邊 USART、UART、SPI、I²C、USB 2.0 FS Device (HT32F523xx)、RTC、Comparator 等硬體資源與使用彈性，適合多種應用領域如：物聯網終端裝置、穿戴式裝置、USB 遊戲週邊、智能家電、家庭自動化、智能玩具、健康量測、消費性電子、資料採集與記錄器等。
 - R. 發展新一代 ARM[®] Cortex[™]-M0+核心之 32 位元 Flash MCU，工作電壓在 2.5V ~ 5.5V 擴大應用領域，並加入 CAN BUS、馬達控制、24 位元 ADC、16 位元 DAC、MIDI、觸控按鍵及 LCD 等功能。
 - S. 發展 ASSP MCU 專用型系列：依產品專用需求規格設計 MCU。
 - T. 發展中、低功率鋰電池充、放電管理及驅動控制之整合型 ASSP MCU：內置多路 PWM 控制，可驅動 DC/DC 升壓/降壓電路及負載驅動，內建硬體 OCP 過流保護及 OVP 過壓保護，有效保護鋰電池充、放電的安全性；適用各種鋰電池驅動產品，如個人護理及手電筒等產品。
 - U. 發展電動工具電源管理 ASSP MCU：包括多串(6 串)鋰電池充電管理 ASSP MCU、電動工具調速開關 ASSP MCU 等產品。
 - V. 開發無線充電 ASSP MCU：現已取得 WPC Qi 認證，並持續研發中功率無線充電技術的 ASSP MCU。
 - W. 開發 USB Type C-PD 快速充電 ASSP MCU 產品。
 - X. 開發各類傳感器量測 ASSP MCU，如：胎壓計、溫度計、濕度計等產品。
 - Y. 發展更高規格的 LDO 產品：如更大電流 250mA 輸出與帶有過流、過溫以及逆向電流保護機制之 LDO 系列 IC。

- Z. 發展高輸出電流之 DC/DC 同步升壓轉換器：採用散熱極佳之封裝技術，高度整合外部功率元件，高效率、低功耗與極少的外部元件特色，十分適用於體積限制之行動裝置，如行動電源等產品。
- AA. 發展 AC-DC 電源管理產品線：整合 PWM 及 PFC 的高效率 AC-DC 轉換器。
- BB. 發展小瓦數低成本的 AC-DC 電源管理產品線：整合高壓 MOS(700V) 節省整體電路元件及提供系統可靠度的 IC，目標是應用在小瓦數充電器、手持式裝置充電器以及小瓦數家電。
- CC. 開發下一代移動電源專用管理 IC，搭配硬體電路達成更快速的負載動態響應變化，整合更多的外部電路零件，如提供內部 1% 精準電壓源等，使產品整體電路更精簡，達到產品成本降低，效能提升的高競爭力產品。
- DD. 基於功耗藍牙(BLE)射頻、調製解調器及 32 位元 M0+Flash MCU 的技術，開發高整合度的健康量測、家電及電腦周邊等相關應用的產品。
- EE. 開發車用規格 LDO：40V 耐高壓 LDO 系列產品。
- FF. 發穿戴式產品 LDO：使用 1x1-mm² 超小型封裝。
- GG. 發展高整合同步升壓轉換器：採用散熱極佳之封裝技術，適用於體積限制之行動裝置，如行動電源、燃氣錶等產品。
- HH. 開發交流-直流電壓轉換器：內建自供電功能更精簡成本，適用在各式白色以及智能家電產品。
- II. 開發專用於智能照明高整合 IC：可調光調色智能照明產品，進一步與 MCU 做封裝整合。
- JJ. 開發直流馬達驅動器：使用在水/燃氣/熱能閥控錶、消費性玩具等。
- KK. 開發單相/三相無刷直流馬達 MCU+LDO+驅動器(All-in-one)高整合性之 IC，對於高成本競爭力及有空間限制之消費性或家電產品為一大優勢。
- LL. 鋰電池保護專用 MCU(SoC)及解決方案：可用在工具鋰電池保護 MCU、四旋翼等 3 串鋰電池保護板上。
- MM. 開發 32 位元雙核 DSP 影像辨識 IC：提供鈔票、證件、人臉、車牌等相關辨識的應用。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司銷售地區分佈如下表所示：

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	106 年度		105 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
臺灣地區	557,865	12	554,693	13
中國地區	3,331,746	72	2,906,297	70
其他海外地區	725,306	16	696,798	17
合計	4,614,917	100	4,157,788	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、顯示驅動 IC、電源管理 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。

根據 IC Insights 預測，2017 年 Fabless IC 廠商的營收預估將超過 1,000 億美元，依本公司 2017 年度營業收入淨額新台幣 46.15 億元，約 1.52 億美金(新台幣對美元匯率以 30.4 計算)，於 Fabless IC 市場佔有率約 0.15%，根據本公司 2017 年 MCU 總出貨量成長 21%，MCU 總銷貨金額成長 14%，預估於 2017 年隨著應用面廣度的拓展，推升 MCU 需求面，將持續增加相關國際大廠既有的市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1)供需狀況

由於 MCU 的易用性、即時運行和低功耗特性，可為智慧、安全且不斷發展的 IoT 市場提供最高性能且經濟高效的嵌入式解決方案。由於市場需求不斷擴展，造成全球 MCU 市場供不應求、廠商交期不斷延長，2017 年已有全球多家 MCU 廠商產品出貨交期皆自四個月延長至六個月，預估後市於全球汽車電子、物聯網應用需求不斷爆發、持續成長，矽晶圓廠產能滿載下，2018 年全球 MCU 市場，仍是屬於供貨緊張的狀況。

DIGITIMES Research 指出，隨著汽車持續朝向自動駕駛、智能化方向發展，對 MCU 需求數量將持續擴增；預估 2017~2021 年間，全球車用 MCU 市場銷售額年複合平均成長率將達 3%。其中，32 位元車用 MCU 將為市場重點發展趨勢，銷售金額年複合平均成長率有望達 6.6%。

(2)未來成長性

隨著電子產品要求更智慧化與人性化，均仰賴其中的 MCU 來完成功能的實現，因此，MCU 所扮演的角色已更顯重要，尤其近年來 MCU 價格不斷下降、功能持續增強以及功耗降低的帶動下，使用量持續且穩定的攀升。

此外，根據 Strategy Analytics 研究，截至 2017 年底，全球已有多達二百億個物聯網互連裝置部署、應用，預估未來四年內將再新增一百億個。本公司隨著物聯網的興起，大量的電子產品急需智能化升級，相關應用亦帶來 MCU 和 RF 以及 Sensor 集成，本公司持續提供各式 MCU 應用解決方案，方案技術越來越先進，功能越來越完善。

蘋果 iPhone 8/X 支援無線充電聯盟(WPC) Qi 標準規格，無線充電器出貨已見到爆炸性成長，同樣帶動無線充電晶片強勁出貨，加上非蘋陣營全面支援無線充電功能，使無線充電產品的趨勢明顯確立，也將讓相關市場商機逐漸擴大。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1)研發能力強，產品領先群倫：

長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發更新更有競爭力的 IC。

(2)更新輔助設計器材與測試設備：

藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。

(3)完整的全球行銷網路：

擁有臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、北京、成都、青島、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(4)上游工廠關係穩固：

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。

(5)管理制度良好：

本公司取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準

化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目前掌握之競爭優勢如下：

A. 領先且完整的產品系列

(A) 由於自有 IP 日益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加 IC 功能與客戶產品的競爭力，提高對手競爭障礙。

(B) 產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險。

(C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。

B. 全球行銷網的建立

(A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等。

(B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。

(C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。

(D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。

(E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。

(F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

C. 產品開發能力

(A) 多年經驗累積之優良研發技術。

(B) 強大的研發團隊。

(C) 藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，加速產品及技術升級。

(D) 發展產品多元化，減少景氣波動度影響。

D. 整體環境支援

(A) 產業支援集中，可增強經營效益。

(B) 產業專業分工，可增高合作及依存性。

(C) 產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。

(2) 不利因素及因應之道

A. 國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，必須提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢。

- B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速的服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。
- C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機。
- D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。
- E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，必須持續增加智財權實力，努力提升產品之主導性。
- F. 面臨大陸設計業的蓬勃發展，加上蓄意對智財權的忽視，臺灣 IC 設計同業均已受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。
- G. IC 設計人才普遍缺乏，且培訓時間較長，加上市場產品汰換迅速，經由與大專院校合作延攬優秀人才，並定期舉辦教育訓練培訓研發人才，提供良好的工作環境及晉升管道，維持低人才流動率。
- H. 部份客戶對臺灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司選擇合適之客戶進行長期合作，達到量產階段，以提升本公司在此產業之知名度。另外，產品組合不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。

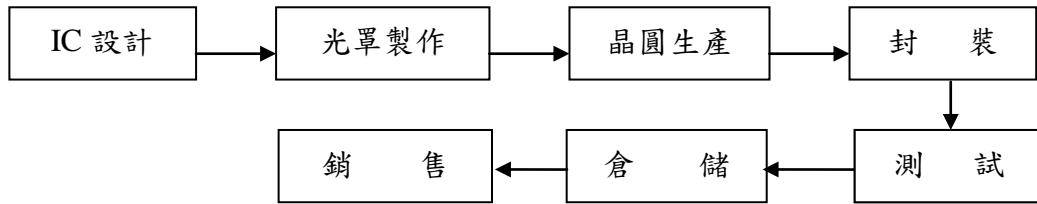
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、健康護理產品、汽機車、工業儀表控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 LED。
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
記憶體產品	使用於電腦、通訊、消費電子、教育娛樂產品及智慧型金融卡等。

2. 產品產製過程

(1)本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2)晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3)封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰、日月光等，確保封裝產能無虞。

(4)測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5)倉儲作業

A. 主要儲存物品：

- (A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。
- (B) 測試狀態分為：已測/未測。
- (C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

- (A) 自動倉儲作業。
- (B) 儲存物品之品質維護。
- (C) 貨物進出的管理與正確性。
- (D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三)主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四) 最近二年度任一年度中占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	105 年度				106 年度				當年度截至 107 年 3 月 31 日止(註 2)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	745,054	35	無	A	896,544	35	無	A	234,025	36	無
2	B	289,121	14	無	B	334,669	13	無	B	90,986	14	無
3	其他	1,098,000	51	無	其他	1,302,191	52	無	其他	323,556	50	無
	進貨淨額	2,132,175	100		進貨淨額	2,533,404	100		進貨淨額	648,567	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：當年度截至 107 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料。

主要供應商變動原因：

本公司與上、下游廠商皆維持良好默契與關係，近二年度主要產能因市場供需狀況及成本因素，致各廠商進貨金額有增減外，尚無明顯之重大變化。

2. 最近二年度銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	105 年度				106 年度				當年度截至 107 年 3 月 31 日止(註 3)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	欣宏	516,928	12	(註 2)	欣宏	571,681	12	(註 2)	欣宏	139,802	13	(註 2)
2	CROWN RICH	382,812	9	(註 2)	CROWN RICH	465,727	10	(註 2)	CROWN RICH	125,125	11	(註 2)
3	NEW WAVE	386,553	9	(註 2)	NEW WAVE	464,762	10	(註 2)	NEW WAVE	95,731	9	(註 2)
4	其他	2,871,495	70		其他	3,112,747	68		其他	725,043	67	
	銷貨淨額	4,157,788	100		銷貨淨額	4,614,917	100		銷貨淨額	1,085,701	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：本公司子公司採權益法評價之被投資公司。

註 3：當年度截至 107 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料。

主要銷貨客戶變動原因：

本公司與客戶均保持良好的合作關係，且透過香港分公司直接出貨拓展海外銷售外，與其他客戶銷貨集中度不大，主要客戶會隨著市場開拓及景氣供需影響銷貨產生增減變動。

(五) 最近二年度生產量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

生產 量值 主要商品	105 年度		106 年度			
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
微控制器 IC	--	515,034	1,505,928	--	643,207	1,866,492
週邊 IC	--	394,871	557,718	--	447,958	583,140
開發工具及設計收入	--	481	31,196	--	259	4,661
總 計	--	910,386	2,094,842	--	1,091,424	2,454,293

註 1：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自有產能限制。

註 2：本公司產品之生產全部委外製造，包括晶圓代工及後段封裝測試，生產量的多寡全部依據當年度之銷售預估，產值與銷售金額成正比。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

銷售 量值 主要商品	105 年度				106 年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
微控制器 IC	47,731	385,553	468,368	2,580,130	54,364	409,523	570,759	2,989,269
週邊 IC	47,272	158,943	349,540	1,007,207	48,641	145,321	394,261	1,053,398
開發工具及設計收入	20	10,197	29	15,758	235	3,021	38	14,385
總 計	95,023	554,693	817,937	3,603,095	103,240	557,865	965,058	4,057,052

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

日期：107年3月31日

年 度		105 年底	106 年底	當年度截至 107年3月31日
員 工 人 數	工 程 人 員	519	500	491
	管 理 人 員	136	140	140
	生 產 測 試 人 員	32	34	27
	合 計	687	674	658
平 均 年 歲		35.72	36.31	36.80
平 均 服 務 年 資		6.50 年	7.08 年	7.34 年
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.7%	0.5%	0.8%
	碩 士	27.1%	28.6%	29.9%
	大 專	64.3%	62.6%	64.3%
	高 中 (含 以 下)	7.9%	8.3%	5.0%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，其未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

(1)公司福利

本公司設有餐廳、員工休閒活動區、運動健身器材區、韻律教室、醫務休息室等設施，並舉辦團體保險、定期員工健康檢查等活動，且設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(2)職工福利

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院等皆有補助。

為促進各種康樂社團，以增進員工團結及情誼，成立各類型之社團活動，並提供社團經費補助，例：桌球社、羽球社、瑜珈社、桌遊社、游泳社等，鼓勵同仁利用工作之餘也能平衡生活，藉以養成運動風氣、提高生活樂趣。

2.進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程

，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1)職前訓練(新人訓練)：

- A.公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解熟悉本公司組織概況、人事規章、品質政策、工業安全與衛生、人物與環境而實施之訓練。
- B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2)在職訓練：

- A.部門自辦訓練：各部門會針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。
- B.公司內部訓練：內部設有教育訓練委員會依據各部門專業需求，聘請專業講師至公司進行長期的專業訓練課程，包括專業技術培訓課程、管理技能培訓課程、品質培訓課程、工安衛生培訓課程、法務智權培訓課程及電腦培訓等多元而充實的訓練課程。
- C.線上學習課程：建立教育訓練平台，整合所有課程訊息、訓練系統及資料查詢，發展 e-learning 及知識管理系統，建立網路教學滿意度調查機制。
- D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。
- E.106 年員工內、外教育訓練實際執行情形：

	總時數	總人數
一般管理	438	88
專業技術	1,285	500
新人訓練	320	32

(3)在職進修：

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4)自我發展：

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3.退休制度與其實施情形

(1)退休金提繳：

- A.本公司訂有退休辦法並設置勞工之退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之 2 % 提撥退休基金，並以專戶存於臺灣銀行。
- B.本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6% 之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

(2)實施情形

本公司勞資雙方依法組織「退休準備金監督委員會」，每季定期由勞資雙方召

開勞工退休準備金監督委員會議，負責管理監督及審核退休準備金之提撥、存儲、支用等事宜。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司每季定期召開勞資會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識後執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

5. 員工行為與倫理守則

本公司訂定「道德行為準則」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範全體同仁對於經管或監督之業務，不得利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，定期對全體新進人員作宣導。

6. 工作環境與員工安全保護措施

本公司於 2006 年取得國際 OHSAS18001 職業安全衛生管理認證，每季定期召開職業安全衛生委員會議，推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動，包括安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全。

(1)門禁安全：除大樓之保全人員 24 小時守衛外，各出入口及角落地區設有監視攝影器，並加強夜間、假日保安全管理，以保障員工人身安全。

(2)消防安全：

A.定期委請廠商進行保養及維修消防設備(例：消防警報器、滅火器)，並設有專責人員定期檢視後做成記錄。

B.每年定期舉辦消防演習及緊急避難措施，推行全員預防認知責任。

(3)環境安全：為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季委請廠商進行抽樣檢測飲用水機之大腸桿菌群，定期實施辦公室清潔與消毒作業，並於坐式廁所提供 75% 酒精，以確保工作環境安全與舒適。

(4)員工健康檢查：本公司每年定期委託醫療機構特別至公司安排員工各項身體健康檢查，並設有專門之醫護人員提供醫護服務，以及每二個月安排專業醫師至公司看診及舉辦健康講座，注重員工身心健康。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學工業園區管理局	90/03/15~ 109/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術授權	ARM Limited	96/06/25~ 永久	ARM® Cortex™-M3 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	ARM Limited	102/09/24~ 永久	ARM® Cortex™-M0+ 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	晶心科技	104/04/01~ 107/03/31	Andestech D10 CPU Softcore 技術授權	不得違反相關法令之規定

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 國際財務報導準則-合併資訊

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 107年3月31日 財務資料(註2)
		102年	103年	104年	105年	106年	
流動資產		3,724,582	3,830,158	3,824,522	3,928,641	4,179,054	4,462,500
不動產、廠房及設備		499,508	487,863	463,561	442,570	414,729	411,298
無形資產		—	—	—	—	—	—
其他資產		705,395	741,545	775,954	763,556	770,487	838,139
資產總額		4,929,485	5,059,566	5,064,037	5,134,767	5,364,270	5,711,937
流動負債	分配前	830,553	858,093	854,700	977,382	1,068,788	1,103,823
	分配後	1,576,908	1,649,682	1,662,120	1,768,971	(註3)	—
非流動負債		124,564	143,866	163,141	173,262	196,636	199,111
負債總額	分配前	955,117	1,001,959	1,017,841	1,150,644	1,265,424	1,302,934
	分配後	1,701,472	1,793,548	1,825,261	1,942,233	(註3)	—
歸屬於母公司業主之 權益		3,962,762	4,038,632	4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,380,076
股本		2,289,780	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資本公積		114,211	142,309	142,309	159,281	142,309	142,309
保留盈餘	分配前	1,543,041	1,588,979	1,591,692	1,568,678	1,699,004	1,924,810
	分配後	796,686	797,390	784,272	777,089	(註3)	—
其他權益		15,730	45,662	32,280	(24,311)	(31,756)	51,275
庫藏股票		—	—	—	—	—	—
非控制權益		11,606	18,975	18,233	18,793	27,607	28,927
權益總額	分配前	3,974,368	4,057,607	4,046,196	3,984,123	4,098,846	4,409,003
	分配後	3,228,013	3,266,018	3,238,776	3,192,534	(註3)	—

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：當年度截至107年3月31日財務資料為經會計師核閱之合併財務報告。

註3：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 107年3月31日 財務資料(註2)
	102年	103年	104年	105年	106年	
營業收入	3,894,361	3,930,519	3,967,840	4,157,788	4,614,917	1,085,701
營業毛利	1,823,338	1,888,747	1,948,478	2,018,145	2,189,460	536,989
營業損益	755,589	817,495	846,550	833,690	943,311	228,913
營業外收入及支出	126,443	121,024	100,153	84,273	126,479	33,156
稅前淨利	882,032	938,519	946,703	917,963	1,069,790	262,069
繼續營業單位 本期淨利	747,800	798,584	818,321	792,722	935,987	227,010
停業單位損失	—	—	—	—	—	—
本期淨利(損)	747,800	798,584	818,321	792,722	935,987	227,010
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	36,453	30,596	(25,886)	(56,403)	(11,703)	15,857
本期綜合損益總額	784,253	829,180	792,435	736,319	924,284	242,867
淨利歸屬於 母公司業主	744,945	791,556	806,806	784,218	926,188	225,806
淨利歸屬於非控制權益	2,855	7,028	11,515	8,504	9,799	1,204
綜合損益總額歸屬於母 公司業主	781,291	822,225	780,920	727,815	914,470	241,547
綜合損益總額歸屬於非 控制權益	2,962	6,955	11,515	8,504	9,814	1,320
每股盈餘	3.32	3.50	3.57	3.47	4.10	1.00

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：當年度截至107年3月31日財務資料為經會計師核閱之合併財務報告。

(二) 國際財務報導準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 107年3月31日 財 務 資 料	
	102年	103年	104年	105年	106年		
流 動 資 產	3,236,313	3,314,680	3,238,852	3,299,082	3,470,083	不	
不動產、廠房及設備	208,066	192,841	185,281	177,908	165,050		
無 形 資 產	—	—	—	—	—		
其 他 資 產	1,423,142	1,468,756	1,541,722	1,540,790	1,595,737	適	
資 產 總 額	4,867,521	4,976,277	4,965,855	5,017,780	5,230,870		
流 動 負 債	分 配 前	781,350	796,996	778,756	883,701	968,014	用
	分 配 後	1,527,705	1,588,585	1,586,176	1,675,290	(註2)	
非 流 動 負 債	123,409	140,649	159,136	168,749	191,617		
負 債 總 額	分 配 前	904,759	937,645	937,892	1,052,450	1,159,631	
	分 配 後	1,651,114	1,729,234	1,745,312	1,844,039	(註2)	
歸屬於母公司業主之 權 益	3,962,762	4,038,632	4,027,963	3,965,330	4,071,239		
股 本	2,289,780	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682		
資 本 公 積	114,211	142,309	142,309	159,281	142,309		
保 留 盈 餘	分 配 前	1,543,041	1,588,979	1,591,692	1,568,678	1,699,004	
	分 配 後	796,686	797,390	784,272	777,089	(註2)	
其 他 權 益	15,730	45,662	32,280	(24,311)	(31,756)		
庫 藏 股 票	—	—	—	—	—		
非 控 制 權 益	—	—	—	—	—		
權 益 總 額	分 配 前	3,962,762	4,038,632	4,027,963	3,965,330	4,071,239	
	分 配 後	3,216,407	3,247,043	3,220,543	3,173,741	(註2)	

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 107年3月31日 財務資料
	102年	103年	104年	105年	106年	
營業收入	3,599,332	3,605,717	3,601,285	3,695,728	4,130,794	不 適 用
營業毛利	1,632,693	1,685,380	1,719,836	1,734,684	1,895,447	
營業損益	730,155	794,650	810,424	786,319	880,236	
營業外收入及支出	147,616	132,769	119,254	115,062	171,629	
稅前淨利	877,771	927,419	929,678	901,381	1,051,865	
繼續營業單位 本期淨利	744,945	791,556	806,806	784,218	926,188	
停業單位損失	—	—	—	—	—	
本期淨利(損)	744,945	791,556	806,806	784,218	926,188	
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	36,346	30,669	(25,886)	(56,403)	(11,718)	
本期綜合損益總額	781,291	822,225	780,920	727,815	914,470	
淨利歸屬於 母公司業主	744,945	791,556	806,806	784,218	926,188	
淨利歸屬於非控制權益	—	—	—	—	—	
綜合損益總額歸屬於母公 司業 主	781,291	822,225	780,920	727,815	914,470	
綜合損益總額歸屬於非控 制 權 益	—	—	—	—	—	
每 股 盈 餘	3.32	3.50	3.57	3.47	4.10	

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
102	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
103	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
104	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
105	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
106	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一) 國際財務報導準則—合併資訊

分析項目 (註3)		最近五年度財務分析 (註1)					當年度截至 107年3月31 日財務資料(註 2)
		102年	103年	104年	105年	106年	
財務 結構 (%)	負債占資產比率	19	20	20	22	24	23
	長期資金占不動產、廠房 及設備比率	796	832	873	900	988	1072
償債 能力 (%)	流動比率	448	446	447	402	391	404
	速動比率	386	387	378	349	335	341
	利息保障倍數	—	—	—	—	—	—
經營 能力	應收款項週轉率(次)	6.84	6.07	5.85	5.91	5.78	5.50
	平均收現日數	53	60	62	62	63	66
	存貨週轉率(次)	3.83	4.02	3.71	3.90	4.39	3.41
	應付款項週轉率(次)	4.47	4.40	4.29	4.12	4.15	3.44
	平均銷貨日數	95	91	98	94	83	107
	不動產、廠房及設備週轉 率(次)	7.82	7.96	8.34	9.18	10.77	10.51
	總資產週轉率(次)	0.79	0.78	0.78	0.81	0.86	0.76
獲利 能力	資產報酬率(%)	16	16	16	15	18	16
	權益報酬率(%)	20	20	20	20	23	21
	稅前純益占實收資本額 比率(%)	39	41	42	41	47	46
	純益率(%)	19	20	20	19	20	21
	每股盈餘(元)	3.32	3.50	3.57	3.47	4.10	1.00
現金 流量	現金流量比率(%)	117	114	90	95	65	111
	現金流量允當比率(%)	126	124	110	111	111	107
	現金再投資比率(%)	9	5	(1)	2	(2)	2
槓桿 度	營運槓桿度	1.96	1.86	1.90	1.99	1.97	2.00
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達20%者可免分析)

1、現金流量比率較105年度下降，主要係106年度營業活動之淨現金流入減少所致。

2、現金再投資比率較105年度下降，主要係106年度營業活動之淨現金流入減少所致。

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：當年度截至107年3月31日財務資料為經會計師核閱之合併財務報告。

註3：分析項目之計算公式如後。

(二) 國際財務報導準則—個體資訊

年 度 分析項目 (註 2)		最近五年度財務分析 (註 1)					當年度截至 107年3月31 日財務資料
		102年	103年	104年	105年	106年	
財務 結構 (%)	負債占資產比率	19	19	19	21	22	不
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,905	2,094	2,174	2,229	2,467	
償債 能力 %	流動比率	414	416	416	373	358	適
	速動比率	356	362	352	325	308	
	利息保障倍數	—	—	—	—	—	
經營 能力	應收款項週轉率(次)	6.81	5.99	5.66	5.92	5.87	用
	平均收現日數	54	61	64	62	62	
	存貨週轉率(次)	4.10	4.38	4.09	4.30	4.93	
	應付款項週轉率(次)	4.53	4.45	4.35	4.11	4.13	
	平均銷貨日數	89	83	89	85	74	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	16.31	17.99	19.05	20.35	24.09	
	總資產週轉率(次)	0.74	0.72	0.73	0.74	0.79	
獲利 能力	資產報酬率(%)	16	16	16	16	18	
	權益報酬率(%)	20	20	20	20	23	
	稅前純益占實收資本額比率(%)	38	41	41	40	47	
	純益率(%)	21	22	22	21	22	
	每股盈餘(元)	3.32	3.50	3.57	3.47	4.10	
現金 流量	現金流量比率(%)	119	108	88	95	59	
	現金流量允當比率(%)	122	118	103	102	103	
	現金再投資比率(%)	8	3	(2)	1	(5)	
槓桿 度	營運槓桿度	1.81	1.73	1.76	1.83	1.85	
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)

- 1、現金流量比率較 105 年度下降，主要係 106 年度營業活動之淨現金流入減少所致。
- 2、現金再投資比率較 105 年度下降，主要係 106 年度營業活動之淨現金流入減少所致。

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：詳見第 89 頁。

四、最近年度財務報告：詳見第 90 頁~第 142 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：詳見第 143 頁~第 190 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

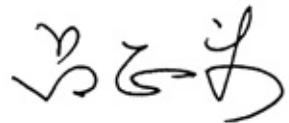
盛群半導體股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核竣事，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

盛群半導體股份有限公司一〇七年股東常會

審計委員會召集人：呂正樂



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 一 日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司及其子公司(以下簡稱「盛群集團」)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群集團民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳合併財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列一關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關人工及系統控制；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群集團是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)。相關說明請詳合併財務報告附註六(四)(重要會計項目說明—存貨)。

關鍵查核事項之說明：

盛群集團帳列存貨一致採用集團制定之呆滯評價政策評估，所應用產品範圍廣泛，各產品汰舊速度快慢不一，依各產品別分類評估應有不同類別之呆滯比率，因此，存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群集團既訂之會計政策；執行存貨回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

其他事項

盛群半導體股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群集團民國一〇六年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾羨鈺



游萬勳



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇七年一月二十九日



盛群半

及其子公司

及

民國一〇二月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,391,728	26	1,149,307	23
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	582,902	11	359,245	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	115,164	2	94,101	2
1180 應收關係人款項(附註七)	755,407	14	633,458	12
130X 存貨(附註六(四))	594,589	11	509,344	10
1476 其他金融資產－流動(附註六(五)及八)	711,632	13	1,163,658	23
1470 其他流動資產	27,632	1	19,528	-
	<u>4,179,054</u>	<u>78</u>	<u>3,928,641</u>	<u>77</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	419,129	8	430,685	8
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	259,446	5	229,750	4
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	414,729	8	442,570	9
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	49,503	1	41,080	1
1900 其他非流動資產	42,409	-	62,041	1
	<u>1,185,216</u>	<u>22</u>	<u>1,206,126</u>	<u>23</u>
資產總計	<u>\$ 5,364,270</u>	<u>100</u>	<u>5,134,767</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
106.12.31 應付票據	\$ 146,854	3	115,324	2
105.12.31 應付帳款	454,078	8	451,120	9
應付關係人款項(附註七)	-	-	465	-
應付薪資及獎金	276,046	5	254,392	5
本期所得稅負債	85,271	2	63,678	1
其他流動負債	106,539	2	92,403	2
	<u>1,068,788</u>	<u>20</u>	<u>977,382</u>	<u>19</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十))	114,988	2	95,146	2
淨確定福利負債(附註六(九))	72,938	1	69,574	2
存入保證金	8,710	-	8,542	-
	<u>196,636</u>	<u>3</u>	<u>173,262</u>	<u>4</u>
	<u>1,265,424</u>	<u>23</u>	<u>1,150,644</u>	<u>23</u>
負債總計	<u>2,261,682</u>	<u>42</u>	<u>2,261,682</u>	<u>44</u>
權益：				
歸屬於母公司業主之權益：				
普通股股本	142,309	3	159,281	3
保留盈餘：				
法定盈餘公積	750,029	14	781,525	15
特別盈餘公積	26,954	1	2,642	-
未分配盈餘	922,021	17	784,511	15
	<u>1,699,004</u>	<u>32</u>	<u>1,568,678</u>	<u>30</u>
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(31,756)	(1)	(24,311)	-
歸屬於母公司業主之權益合計	4,071,239	76	3,965,330	77
非控制權益	27,607	1	18,793	-
權益總計	4,098,846	77	3,984,123	77
負債及權益總計	<u>\$ 5,364,270</u>	<u>100</u>	<u>5,134,767</u>	<u>100</u>



董事長：吳啟勇

(請參閱合併財務報告附註)

經理人：高國棟

會計主管：李文德



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 4,614,917	100	4,157,788	100
5110 營業成本(附註六(四)、(十三)及七)	2,425,457	53	2,139,643	52
營業毛利	2,189,460	47	2,018,145	48
5910 未實現銷貨利益之變動	27,374	1	2,437	-
已實現營業毛利	2,162,086	46	2,015,708	48
營業費用(附註六(十三))：				
6100 推銷費用	108,576	2	100,584	2
6200 管理費用	367,250	8	344,306	8
6300 研究發展費用	742,949	16	737,128	18
	1,218,775	26	1,182,018	28
營業淨利	943,311	20	833,690	20
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	33,956	1	66	-
7060 採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(六))	81,967	2	69,044	2
7100 利息收入(附註六(十四))	10,556	-	15,163	-
	126,479	3	84,273	2
稅前淨利	1,069,790	23	917,963	22
7950 所得稅費用(附註六(十))	133,803	3	125,241	3
本期淨利	935,987	20	792,722	19
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8341 確定福利計畫之再衡量數	(5,148)	-	227	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	875	-	(39)	-
不重分類至損益之項目合計	(4,273)	-	188	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(9,411)	-	(62,980)	(2)
8371 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報告換算之兌換差額	456	-	(5,203)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	1,525	-	11,592	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(7,430)	-	(56,591)	(2)
8300 本期其他綜合損益	(11,703)	-	(56,403)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 924,284	20	736,319	17
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 926,188	20	784,218	19
8620 非控制權益	9,799	-	8,504	-
	\$ 935,987	20	792,722	19
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 914,470	20	727,815	17
8720 非控制權益	9,814	-	8,504	-
	\$ 924,284	20	736,319	17
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.10		3.47	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.06		3.44	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：高國棟



會計主管：李文德



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘		未 分 配 盈 餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權 益 總 額
			特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積					
\$ 2,261,682	142,309	794,631	2,642	794,419	32,280	4,027,963	18,233	4,046,196	
-	-	-	-	784,218	-	784,218	8,504	792,722	
-	-	-	-	188	(56,591)	(56,403)	-	(56,403)	
-	-	-	-	784,406	(56,591)	727,815	8,504	736,319	
-	-	79,442	-	(79,442)	-	-	-	-	
-	-	(92,548)	-	(714,872)	-	(807,420)	-	(807,420)	
-	16,972	-	-	-	-	16,972	-	16,972	
-	-	-	-	-	-	-	(7,944)	(7,944)	
2,261,682	159,281	781,525	2,642	784,511	(24,311)	3,965,330	18,793	3,984,123	
-	-	-	-	926,188	-	926,188	9,799	935,987	
-	-	-	-	(4,273)	(7,445)	(11,718)	15	(11,703)	
-	-	-	-	921,915	(7,445)	914,470	9,814	924,284	
-	-	78,422	-	(78,422)	-	-	-	-	
-	-	-	24,312	(24,312)	-	-	-	-	
-	(16,972)	(109,918)	-	(681,671)	-	(791,589)	-	(791,589)	
-	-	-	-	-	-	(16,972)	-	(16,972)	
-	-	-	-	-	-	-	(7,653)	(7,653)	
-	-	-	-	-	-	-	6,653	6,653	
\$ 2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	(31,756)	4,071,239	27,607	4,098,846	

民國一〇五年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

採用權益法認列之關聯企業之變動數

子公司發放現金股利

民國一〇五年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

採用權益法認列之關聯企業之變動數

子公司發放現金股利

非控制權益增減

民國一〇六年十二月三十一日餘額



董事長：吳啟勇

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：李文德



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,069,790	917,963
調整項目：		
折舊費用	57,019	52,890
攤銷費用	69,914	80,174
利息收入	(10,556)	(15,163)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(81,967)	(69,044)
處分採用權益法之投資利益	(17,215)	(6,867)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	27,374	2,437
其他不影響現金流量之費損淨額	3,558	3,825
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產增加	(222,513)	(144,100)
應收票據及帳款(含應收關係人款項)增加	(148,039)	(63,048)
存貨(增加)減少	(90,600)	62,550
其他營業資產(增加)減少	(2,164)	5,529
應付票據及帳款(含應付關係人款項)增加	34,597	113,893
淨確定福利負債減少	(1,784)	(1,937)
其他營業負債增加	37,824	39,773
營運產生之現金流入	725,238	978,875
收取利息	10,108	19,895
收取之股利	63,626	49,065
支付所得稅淨額	(99,701)	(115,040)
營業活動之淨現金流入	699,271	932,795
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(14,717)	-
取得採用權益法之投資	(12,106)	(3,664)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	17,524
取得不動產、廠房及設備	(34,301)	(52,224)
處分不動產、廠房及設備價款	1,544	1,974
存出保證金增加	(222)	(1,603)
取得子公司淨現金流入數	371	-
其他金融資產減少	448,994	468,246
其他非流動資產增加	(49,271)	(69,918)
投資活動之淨現金流入	340,292	360,335
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	-	1,888
發放股東現金股利	(801,737)	(817,954)
非控制權益增減	5,445	-
籌資活動之淨現金流出	(796,292)	(816,066)
匯率變動影響數	(850)	(8,157)
本期現金及約當現金增加數	242,421	468,907
期初現金及約當現金餘額	1,149,307	680,400
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,391,728	1,149,307

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財報附註)

經理人：高國棟



會計主管：李文德



盛群半導體股份有限公司及其子公司
合併財務報告附註
民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇七年一月二十九日經提報董事會後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一〇六年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇六年生效之國際財務報導準則編製合併財務報告，相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

<u>新發布／修正／修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會發布之生效日</u>
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：適用合併報表例外規定」	105年1月1日
國際財務報導準則第11號之修正「取得聯合營運權益之會計處理」	105年1月1日
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105年1月1日
國際會計準則第1號之修正「揭露倡議」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「農業：生產性植物」	105年1月1日
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103年7月1日
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105年1月1日

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103年1月1日
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替與避險會計之持續適用」	103年1月1日
2010-2012及2011-2013週期之年度改善	103年7月1日
2012-2014年國際財務報導年度改善	105年1月1日
國際財務報導解釋第21號「公課」	103年1月1日

適用上述新認可之國際財務報導準則對合併財務報告未造成重大變動。

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇六年七月十四日金管證審字第1060025773號令，公開發行以上公司應自民國一〇七年起全面採用經金管會認可並於民國一〇七年生效之國際財務報導準則。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第2號之修正「股份基礎給付交易之分類及衡量」	107年1月1日
國際財務報導準則第4號之修正「於國際財務報導準則第4號『保險合約』下國際財務報導準則第9號『金融工具』之適用」	107年1月1日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	108年1月1日
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	107年1月1日
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	106年1月1日
國際會計準則第12號之修正「因未實現損失所產生遞延所得稅資產之認列」	106年1月1日
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉列」	107年1月1日
國際財務報導準則2014-2016週期之年度改善：	
國際財務報導準則第12號之修正	106年1月1日
國際財務報導準則第1號之修正及國際會計準則第28號之修正	107年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易及預收(付)對價」	107年1月1日

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對合併財務報告造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1. 國際財務報導準則第九號「金融工具」

該準則將取代國際會計準則第三十九號「金融工具：認列與衡量」，修正金融工具之分類與衡量及減損。

(1) 金融資產之分類及衡量

該準則包含金融資產之新分類及衡量方法，其反映管理該金融資產之經營模式及現金流量特性。該準則主要將金融資產分類為按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量及透過損益按公允價值衡量三類，並刪除現行準則下持有至到期日、放款及應收款及備供出售金融資產之分類。依該準則，混合合約包含之主契約若屬該準則範圍內之金融資產，則不拆分嵌入之衍生工具，而係評估整體混合金融工具之分類。另國際會計準則第三十九號對於不具活絡市場報價且公允價值因而無法可靠衡量之無報價權益工具投資(及此類工具之衍生工具)之衡量規定具有一項例外，此類金融工具係按成本衡量；國際財務報導準則第九號刪除該項例外，規定所有權益工具(及其衍生工具)應按公允價值衡量。

合併公司評估認為若適用新分類規定，將不會對應收帳款及以公允價值為基礎管理之權益工具投資之會計處理造成重大影響。合併公司於民國一〇六年十二月三十一日分類以成本衡量之金融資產帳面金額259,446千元，係採長期持有之策略，於初始採用國際財務報導準則第九號時，合併公司將其分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量，因此，後續公允價值之利益及損失全數列報於其他綜合損益，不會將減損損失認列於損益，亦不會將處分該金融資產之利益及損失重分類至損益。合併公司評估上述改變可能使民國一〇七年一月一日其他權益項目增加106,743千元。另，合併公司評估適用國際財務報導準則第九號分類與衡量，分類為透過損益按公允價值衡量將不會產生重大影響。

(2) 金融資產及合約資產之減損

該準則以前瞻性之預期信用損失模式取代現行國際會計準則第三十九號已發生減損損失模式，預期信用損失係以機率加權為基礎決定，經濟因素改變如何影響該損失需要相當的判斷。

預期信用損失模式適用於按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(除權益工具投資外)及合約資產。

國際財務報導準則第九號下，係依下列基礎衡量金融資產之減損損失：

- 十二個月預期信用損失：金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失；及
- 存續期間預期信用損失：金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

若金融工具自原始認列後信用風險已顯著增加，則適用存續期間預期信用損失衡量減損；若未顯著增加，則適用十二個月預期信用損失衡量減損。企業若判定金融工具於報導日之信用風險低，得假設該金融資產自原始認列後信用風險未顯著增加，然而，不具重大財務組成部分之應收帳款及合約資產，係按存續期間預期信用損失方法衡量；此外，合併公司亦選擇以此方式衡量具重大財務組成部分之應收帳款和合約資產。

合併公司評估適用國際財務報導準則第九號減損規定將不會產生重大影響。

(3)揭露

該準則包含大量之新揭露規定，尤其有關避險會計、信用風險及預期信用損失之揭露。合併公司之評估包括從現有內部流程分析資料有差異之處，及規劃對系統及內部控制進行修改以擷取所需資料。

(4)過渡處理

除下列項目外，通常係追溯適用國際財務報導準則第九號：

- 合併公司預計採用分類及衡量(包括減損)改變之豁免，無須重編以前期間之比較資訊。因採用該準則造成金融資產及金融負債帳面金額之差額，通常將調整民國一〇七年一月一日之保留盈餘及其他權益項目。
- 下列事項係以初次適用日存在之事實及情況為基礎評估：
 - 判定金融資產係以何種經營模式持有。
 - 先前指定為透過損益按公允價值之金融資產及金融負債之指定及撤銷。
 - 部分非持有供交易之權益工具投資作透過其他綜合損益按公允價值衡量之指定。

2.國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」

該準則將取代現行國際會計準則第十八號「收入」及國際會計準則第十一號「建造合約」以及其他收入相關的解釋，以單一分析模型按五個步驟決定企業認列收入之方法、時點及金額。

(1)銷售商品

針對產品之銷售，現行係於商品出貨時認列收入，於該時點客戶已接受該產品，且相關所有權之重大風險及報酬已移轉予客戶。於該時點認列收入，係因該時點收入及成本能可靠衡量、對價很有可能收回，且不再繼續參與對商品之管理。國際財務報導準則第十五號下，將於客戶取得對產品之控制時認列收入。合併公司初步評估認為該產品之所有權重大風險及報酬移轉予客戶之時點與控制移轉之時點類似，故預期不會產生重大影響。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2) 過渡處理

合併公司預計依累積影響數法適用國際財務報導準則第十五號，因此，無須重編以前期間之比較資訊，初次適用該準則之累積影響數將調整民國一〇七年一月一日之保留盈餘。合併公司評估適用國際財務報導準則第十五號規定將不會產生重大影響。

3. 國際會計準則第十二號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」

修正條文闡明符合特定條件之情況下，將對未實現損失認列遞延所得稅資產，並釐清「未來課稅所得」之計算方式。

合併公司評估上述修正將不會產生重大影響。

(三) 金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會(以下簡稱理事會)已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋。

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第16號「租賃」	108年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」	110年1月1日
國際財務報導解釋第23號「具不確定性之所得稅處理」	108年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	108年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	108年1月1日

對合併公司可能攸關者如下：

發布日	新發布或修訂準則	主要修訂內容
105.1.13	國際財務報導準則第16號「租賃」	<p>新準則將租賃之會計處理修正如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 承租人所簽訂符合租賃定義之所有合約均應於資產負債表認列使用權資產及租賃負債。租賃期間內租賃費用則係以使用權資產折舊金額加計租賃負債之利息攤提金額衡量。 • 出租人所簽訂符合租賃定義之合約則應分類為營業租賃及融資租賃，其會計處理與國際會計準則第17號「租賃」類似。

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除另有說明者外，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1) 依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；及
- (2) 淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2. 功能性貨幣及表達貨幣

合併公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三) 合併基礎

1. 合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及本公司之子公司。

自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。歸屬於子公司非控制權益之損益歸屬於非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

合併公司間之重大交易、餘額及未實現收益與費用，於編製合併財務報告時均已消除。

2. 列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			106.12.31	105.12.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100 %	100 %
MCU	Best Health Electronics Corp. (Best Health)	製造及銷售與技術服務	80 % (註1)	- % (註1)

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			106.12.31	105.12.31
Best Health	悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	製造及銷售與技術服務	100 % (註2)	- % (註2)
MCU	Anchip Technology Corporation (Anchip)	製造及銷售與技術服務	60 % (註3)	40 % (註3)
Anchip	嘉芯安科技(深圳)有限公司(嘉芯安)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售與技術服務	54.75 % (註4)	54.75 % (註4)
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	倍創科技股份有限公司(倍創)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	盛通科技股份有限公司(盛通)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %

註1：合併公司於民國一〇六年第一季設立之100%子公司，並於民國一〇六年九月出售20%股權。

註2：合併公司於民國一〇六年度第四季設立之100%子公司。

註3：合併公司於民國一〇六年九月取得該公司20%股權，故於民國一〇六年九月列入合併個體。

註4：係盛凌直接持有40%股權及透過關聯企業持有36.875%股權所計算之綜合持股比例。

3.未列入合併財務報告之子公司：無

(四)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2. 國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

(五) 資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

1. 預期於其正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗。
2. 主要為交易目的而持有該資產。
3. 預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
4. 該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

1. 預期於其正常營業週期中清償該負債。
2. 主要為交易目的而持有該負債。
3. 預期於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
4. 未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

(六) 現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七) 金融工具

1. 金融資產

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2) 應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(3) 金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含合併公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(4) 金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2. 金融負債

(1) 應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3) 金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(八)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(九)投資關聯企業

關聯企業係指合併公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。合併公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

合併財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與合併公司會計政策一致性之調整後，合併公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

合併公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在合併公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當合併公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

合併公司自其投資不再為關聯企業之日起停止採用權益法，並按公允價值衡量保留權益，保留權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，認列於當期損益。對於先前認列於其他綜合損益中與該投資有關之所有金額，其會計處理之基礎與關聯企業若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同，亦即若先前認列於其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時須被重分類為損益，則當企業停止採用權益法時，將該利益或損失自權益重分類至損益。若合併公司對關聯企業之所有權權益減少，但持續適用權益法，則合併公司將與該所有權權益之減少有關而先前已認列於其他綜合損益之利益或損失，按上述方式依減少比例作重分類調整。

關聯企業發行新股時，若合併公司未按持股比例認購，致使持股比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積及採用權益法之投資；若此項調整係沖減資本公積，但由採用權益法之投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額則借記保留盈餘。惟若屬合併公司未按持股比例認購，致使其對關聯企業之所有權權益減少者，先前於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之金額係按減少比例重分類，其會計處理之基礎與關聯企業若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築物：20~40年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

每年至少於財務年度結束日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十一)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十二)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

合併公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

每年至少於財務年度結束日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十三)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，合併公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

(十四)收入認列

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售訂單個別條款而定。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2. 確定福利計畫

合併公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與本公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於財務報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司有利時，認列資產係以未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於合併公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對合併公司而言，即具有經濟效益。

淨確定福利負債之再衡量數包含(1)精算損益；(2)計畫資產報酬，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額；及(3)資產上限影響數之任何變動，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額。淨確定福利負債再衡量數認列於其他綜合損益項目下。

3. 短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六) 股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量為基礎衡量。

有關股份基礎給付獎酬之非既得條件，已反映於股份基礎給付給與日公允價值之衡量，且預期與實際結果間之差異無須作核實調整。

應給付予員工之股份增值權，係以該股份增值權之公允價值衡量後採現金交割者，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列費用並增加相對負債。相關負債於各報導日及交割日應予重新衡量，其公允價值之任何變動認列為損益項下。

(十七) 所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

1. 有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
2. 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1) 同一納稅主體；或
 - (2) 不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十八)每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。合併公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際財務報導準則編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

(一)存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，合併公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

(二)確定福利義務之衡量

確定福利退休計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價，其採用之精算假設包括折現率、員工離職率及未來薪資增加率等，若該等假設因市場與經濟情況之改變而有所變動，可能會重大影響認列之費用與負債金額。精算所採用之重大精算假設說明及敏感度分析請詳附註六(九)。

合併公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。合併公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

合併公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，合併公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十五)，金融工具。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
現金及活期存款	\$ 295,513	258,523
定期存款	1,096,215	890,784
	<u>\$ 1,391,728</u>	<u>1,149,307</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)金融工具

1.透過損益按公允價值衡量之金融資產

	106.12.31	105.12.31
持有供交易之金融資產－受益憑證	\$ 582,902	359,245

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少4,838千元及2,982千元。

2.以成本衡量之金融資產

	106.12.31	105.12.31
未上市(櫃)公司股票		
Unitech Capital Inc.(Unitech)	\$ 86,750	86,750
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	143,000	143,000
金佶科技股份有限公司(金佶科技)	29,696	-
	\$ 259,446	229,750

(三)應收票據及帳款淨額

	106.12.31	105.12.31
應收票據	\$ 827	1,040
應收帳款	121,730	100,454
	122,557	101,494
減：備抵呆帳	(7,393)	(7,393)
	\$ 115,164	94,101

合併公司於民國一〇六年度及一〇五年度無已逾期但未減損應收票據、應收帳款及其他應收款。

合併公司於民國一〇六年度及一〇五年度針對應收票據及應收帳款並無提列減損損失情形。

(四)存貨

	106.12.31	105.12.31
原料及物料	\$ 116,727	92,545
在製品	244,516	215,616
製成品及商品	233,346	201,183
	\$ 594,589	509,344

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

營業成本組成明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
銷貨成本	\$ 2,421,179	2,134,583
報廢成本	<u>4,278</u>	<u>5,060</u>
	<u>\$ 2,425,457</u>	<u>2,139,643</u>

(五)其他金融資產－流動

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 703,579	1,152,906
受限制銀行存款	3,820	3,714
其他	<u>4,233</u>	<u>7,038</u>
	<u>\$ 711,632</u>	<u>1,163,658</u>

(六)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之關聯企業皆屬個別不重大，其彙總財務資訊列示如下，該等投資係於合併財務報告中所包含之金額：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 508,045	492,227
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(88,916)</u>	<u>(61,542)</u>
	<u>\$ 419,129</u>	<u>430,685</u>

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之份額：		
繼續營業單位本期淨利	\$ 81,967	69,044
其他綜合損益	<u>(456)</u>	<u>5,203</u>
綜合損益總額	<u>\$ 81,511</u>	<u>74,247</u>

合併公司於民國一〇五年三月處分所持有之Innotek Electronics Inc.股權予關聯企業，處分價款及處分利益分別為17,524千元及6,867千元。

合併公司於民國一〇六年第一季採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，因喪失影響力，故轉列至以成本衡量之金融資產，並認列處分利益。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(七)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>機 器 設 備</u>	<u>其 他 設 備</u>	<u>總 計</u>
成本：					
民國106年1月1日餘額	\$ 26,676	519,709	348,181	95,431	989,997
增添	-	1,311	24,540	8,450	34,301
處分	-	-	(15,600)	(18,349)	(33,949)
匯率變動之影響	-	(3,173)	(1,168)	(619)	(4,960)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>517,847</u>	<u>355,953</u>	<u>84,913</u>	<u>985,389</u>
民國105年1月1日餘額	\$ 26,676	538,108	329,111	85,213	979,108
增添	-	1,690	29,434	21,100	52,224
處分	-	-	(3,552)	(8,096)	(11,648)
匯率變動之影響	-	(20,089)	(7,757)	(2,786)	(30,632)
重分類	-	-	945	-	945
民國105年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>519,709</u>	<u>348,181</u>	<u>95,431</u>	<u>989,997</u>
累計折舊：					
民國106年1月1日餘額	\$ -	199,772	285,254	62,401	547,427
本期折舊	-	21,891	22,937	12,191	57,019
處分	-	-	(13,896)	(18,274)	(32,170)
匯率變動之影響	-	(436)	(873)	(307)	(1,616)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>221,227</u>	<u>293,422</u>	<u>56,011</u>	<u>570,660</u>
民國105年1月1日餘額	\$ -	180,555	272,744	62,248	515,547
本期折舊	-	22,394	21,456	9,040	52,890
處分	-	-	(3,506)	(6,817)	(10,323)
匯率變動之影響	-	(3,177)	(5,440)	(2,070)	(10,687)
民國105年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>199,772</u>	<u>285,254</u>	<u>62,401</u>	<u>547,427</u>
帳面價值：					
民國106年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>296,620</u>	<u>62,531</u>	<u>28,902</u>	<u>414,729</u>
民國105年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>319,937</u>	<u>62,927</u>	<u>33,030</u>	<u>442,570</u>
民國105年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>357,553</u>	<u>56,367</u>	<u>22,965</u>	<u>463,561</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(八)營業租賃

1.合併公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
一年內	\$ 10,894	16,159
一年以上至二年	3,989	11,173
二年以上	<u>6,967</u>	<u>3,956</u>
	<u>\$ 21,850</u>	<u>31,288</u>

2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇六年九月起租金每年約為3,251千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(九)員工福利

1.確定福利計畫

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ 123,354	118,013
計畫資產之公允價值	<u>(50,416)</u>	<u>(48,439)</u>
淨確定福利負債	<u>\$ 72,938</u>	<u>69,574</u>

合併公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

合併公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計50,416千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2)確定福利義務現值之變動

合併公司民國一〇六年度及一〇五年度確定福利義務現值變動如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ 118,013	119,433
計畫支付之福利	(1,310)	(2,423)
當期服務成本及利息	1,770	1,542
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損(益)	4,941	(1,714)
— 因人口假設變動所產生之精算損失	-	129
— 因經驗變動所產生之精算(益)損	(60)	1,046
12月31日確定福利義務	<u>\$ 123,354</u>	<u>118,013</u>

(3)計畫資產公允價值之變動

合併公司民國一〇六年度及一〇五年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 48,439	47,695
計畫支付之福利	(1,310)	(2,423)
利息收入	748	652
已提撥至計劃之金額	2,806	2,827
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計劃資產報酬(不含當期利息)	(267)	(312)
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 50,416</u>	<u>48,439</u>

(4)認列為損益之費用

合併公司民國一〇六年度及一〇五年度認列為損益之費用如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
淨確定福利負債之淨利息	<u>\$ 1,022</u>	<u>890</u>
營業成本	\$ 70	62
推銷費用	79	60
管理費用	185	159
研究發展費用	688	609
	<u>\$ 1,022</u>	<u>890</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

合併公司民國一〇六年度及一〇五年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
1月1日累積餘額	\$ 10,737	10,964
本期認列	<u>5,148</u>	<u>(227)</u>
12月31日累積餘額	<u><u>\$ 15,885</u></u>	<u><u>10,737</u></u>

(6)精算假設

合併公司於年度財務報導期間結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
折現率	1.20 %	1.50 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

合併公司預計於民國一〇六年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,880千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為13.1年。

(7)敏感度分析

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日，當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

<u>精算假設</u>	<u>淨確定福利負債</u>	
	<u>增加1%</u>	<u>減少1%</u>
106年12月31日		
折現率	\$ <u>(15,542)</u>	<u>18,433</u>
未來薪資成長率	<u>16,710</u>	<u>(14,503)</u>
105年12月31日		
折現率	\$ <u>(15,588)</u>	<u>18,594</u>
未來薪資成長率	<u>\$ 16,975</u>	<u>(14,645)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2. 確定提撥計畫

本公司及國內子公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。合併公司民國一〇六年度及一〇五年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為20,523千元及20,284千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇六年度及一〇五年度國外分公司及合併子公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為19,089千元及19,186千元。

(十) 所得稅

1. 所得稅費用

合併公司民國一〇六年度及一〇五年度之所得稅費用明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 119,475	97,759
調整前期之當期所得稅	<u>509</u>	<u>4,535</u>
	<u>119,984</u>	<u>102,294</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	<u>13,819</u>	<u>22,947</u>
所得稅費用	<u>\$ 133,803</u>	<u>125,241</u>

合併公司民國一〇六年度及一〇五年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ <u>(875)</u>	<u>39</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ <u>(1,525)</u>	<u>(11,592)</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
稅前淨利	\$ 1,069,790	917,963
依合併公司所在地國內稅率計算之所得稅	181,864	156,054
永久性差異調整	(11,358)	(5,892)
免稅所得	(55,078)	(36,335)
投資抵減預期新增數	-	(1,227)
以前年度所得稅核定及估計差異	(920)	4,535
所得基本稅額	8,619	-
其他	10,676	8,106
	<u>\$ 133,803</u>	<u>125,241</u>

2. 遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	<u>105.1.1</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>105.12.31</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>106.12.31</u>
存貨跌價損失	\$ 10,200	-	-	10,200	-	-	10,200
未實現聯屬公司間利益	17,889	913	-	16,976	(6,525)	-	23,501
淨確定福利負債	12,195	329	39	11,827	303	(875)	12,399
國外營運機構財務報告 換算之兌換損失	-	-	(1,878)	1,878	-	(1,525)	3,403
其他	1,793	1,594	-	199	199	-	-
	<u>\$ 42,077</u>	<u>2,836</u>	<u>(1,839)</u>	<u>41,080</u>	<u>(6,023)</u>	<u>(2,400)</u>	<u>49,503</u>

遞延所得稅負債

	<u>105.1.1</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>105.12.31</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>106.12.31</u>
國外營運機構財務報告 換算之兌換利益	\$ (9,714)	-	(9,714)	-	-	-	-
採權益法認列之國外投 資利益	(74,956)	19,261	-	(94,217)	19,719	-	(113,936)
其他	(79)	850	-	(929)	123	-	(1,052)
	<u>\$ (84,749)</u>	<u>20,111</u>	<u>(9,714)</u>	<u>(95,146)</u>	<u>19,842</u>	<u>-</u>	<u>(114,988)</u>

3. 本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇三年度；另國內合併公司(包含盛凌、優方及盛通)營利事業所得稅結算已核定至民國一〇四年度。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4.兩稅合一相關資訊如下：

	106.12.31	105.12.31
屬民國八十七年度以後之未分配盈餘	<u>\$ 922,021</u>	<u>784,511</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 48,266</u>	<u>63,038</u>
	106年度	105年度
	(預計)	(實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>13.02%</u>	<u>12.8%</u>

前述民國一〇五年度兩稅合一相關資訊係依據財政部民國一〇二年十月十七日台財稅第10204562810號函規定處理之金額。另，所得稅法修正案已於民國一〇七年一月十八日經立法院三讀通過，將營利事業所得稅率自民國一〇七年度起由現行17%提高至20%，該稅率變動不影響民國一〇六年度帳列之當期及遞延所得稅，並取消股東可扣抵稅額帳戶之設置、記載、計算及分配。上列民國一〇六年度預計稅額扣抵比率自民國一〇七年一月一日起不再適用，該等資訊僅供參考。

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

2.資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	106.12.31	105.12.31
發行股票溢價	\$ 142,309	142,309
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	16,972
	<u>\$ 142,309</u>	<u>159,281</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3.保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期末分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期末分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3)盈餘分派

本公司分別於民國一〇六年五月二十六日及一〇五年五月二十七日經股東常會決議民國一〇五年度及一〇四年度之盈餘分派案，分派予業主之股利如下：

	105年度		104年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 3.50	791,589	3.57	807,420

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十二)每股盈餘

歸屬於本公司每股盈餘之計算列示如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
基本每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>926,188</u>	<u>784,218</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>226,168</u>	<u>226,168</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>4.10</u>	<u>3.47</u>
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>926,188</u>	<u>784,218</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)	<u>1,746</u>	<u>2,037</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>227,914</u>	<u>228,205</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.06</u>	<u>3.44</u>

(十三)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一〇六年度及一〇五年度員工酬勞估列金額分別為111,567千元及94,738千元，董事酬勞估列金額分別為12,286千元及10,526千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國一〇六年度及一〇五年度之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度員工酬勞提列金額分別為94,738千元及98,027千元，董事酬勞提列金額分別為10,526千元及10,892千元，皆係以現金發放，其中民國一〇五年度以董事酬勞科目發放金額為10,416千元，差異係帳列科目調整，民國一〇四年度實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十四)營業外收入及支出

合併綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	106年度	105年度
處分採用權益法之投資利益	\$ 17,215	6,867
外幣兌換利益(損失)淨額	338	(28,929)
其他	16,403	22,128
	\$ 33,956	66

(十五)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為3,564,805千元及3,407,555千元。

合併公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於合併公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

合併公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日佔本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為447,529千元及296,073千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵呆帳，管理當局預期未來不致有重大損失。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過5年
106年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 600,932	600,932	600,932	-
存入保證金	8,710	8,710	-	8,710
	\$ 609,642	609,642	600,932	8,710

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約		
		現金流量	1年以內	超過5年
105年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 566,909	566,909	566,909	-
存入保證金	8,542	8,542	-	8,542
	<u>\$ 575,451</u>	<u>575,451</u>	<u>566,909</u>	<u>8,542</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險

(1)匯率風險

A.匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	106.12.31			105.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 9,269	29.71	275,385	11,921	32.2	383,850
人民幣	112,470	4.5394	510,544	62,416	4.5965	286,894
<u>非貨幣性項目</u>						
美金	\$ 11,372	29.71	337,870	9,591	32.2	308,820
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 8,081	29.71	240,082	6,977	32.2	224,660
人民幣	14,933	4.5394	67,786	13,805	4.5965	63,455

B.敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇六年度及一〇五年度之稅後淨利將分別增加或減少3,968千元及3,176千元。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

C. 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇六年度及一〇五年度外幣兌換利益(損失)淨額(含已實現及未實現)分別為338千元及(28,929)千元。

4. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量之金融工具其帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

	106.12.31				
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
持有供交易之非衍生性金融資產	\$ 582,902	582,902	-	-	582,902
以成本衡量之金融資產	259,446	-	-	-	-
放款及應收款					
現金及約當現金	1,391,728	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	870,571	-	-	-	-
其他金融資產－流動	711,632	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	7,972	-	-	-	-
	<u>\$ 3,824,251</u>	<u>582,902</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>582,902</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 600,932	-	-	-	-
存入保證金	8,710	-	-	-	-
	<u>\$ 609,642</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	105.12.31				
	帳面價值	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
持有供交易之非衍生性金融資產	\$ 359,245	359,245	-	-	359,245
以成本衡量之金融資產	229,750	-	-	-	-
放款及應收款					
現金及約當現金	1,149,307	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	727,559	-	-	-	-
其他金融資產—流動	1,163,658	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	7,786	-	-	-	-
	<u>\$ 3,637,305</u>	<u>359,245</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>359,245</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 566,909	-	-	-	-
存入保證金	8,542	-	-	-	-
	<u>\$ 575,451</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

民國一〇六年度及一〇五年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(十六)財務風險管理

1.概要

合併公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達合併公司上述各項風險之暴險資訊、合併公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十五)。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2. 風險管理架構

董事會全權負責發展及控管合併公司之風險管理政策。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

董事會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3. 信用風險

信用風險係合併公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於合併公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十五)。另，截至民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日止，合併公司均無提供任何背書保證。

4. 流動性風險

流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由合併公司之財務部門所監控，持續監督合併公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控合併公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保合併公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇六年十二月三十一日止，合併公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度148,800千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5. 市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

合併公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

- (1) 合併公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十七)資本管理

董事會管理資本之目標係確保合併公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據合併公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定合併公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對合併公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據合併公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定合併公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇六年十二月三十一日止，合併公司資本管理之方式並未改變。

合併公司於報導日之負債權益比率如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
負債總額	\$ <u>1,265,424</u>	<u>1,150,644</u>
權益總額	\$ <u>4,098,846</u>	<u>3,984,123</u>
負債權益比率	<u>30.87%</u>	<u>28.88%</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本合併財務報告之涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下：

<u>關係人名稱</u>	<u>與合併公司之關係</u>
CROWN RICH	合併公司之關聯企業
FINE CHIP	合併公司之關聯企業
FORIC	合併公司之關聯企業
JXY	合併公司之關聯企業
NEW WAVE	合併公司之關聯企業
NEWTEK	合併公司之關聯企業
QUANDING	合併公司之關聯企業
SANTEK	合併公司之關聯企業
TRUETEK	合併公司之關聯企業
BESTWAY	合併公司之關聯企業
欣宏	合併公司之關聯企業

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

關係人名稱	與合併公司之關係
金佶	其他關係人
金濤高科	合併公司之關聯企業
宏達	合併公司之關聯企業
高聖	合併公司之關聯企業
鈺威	合併公司之關聯企業

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	106年度	105年度
欣宏	\$ 571,681	516,928
CROWN RICH	465,727	382,812
NEW WAVE	464,762	386,553
其他	1,863,657	1,690,578
	<u>\$ 3,365,827</u>	<u>2,976,871</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

截至民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為88,916千元及61,542千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	106.12.31	105.12.31
欣宏	\$ 121,816	106,927
NEW WAVE	114,810	109,968
CROWN RICH	110,054	72,253
NEWTEK	100,849	79,178
其他	307,878	265,132
	<u>\$ 755,407</u>	<u>633,458</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2.進貨

合併公司向關係人進貨金額如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
其他關係人	\$ <u>584</u>	<u>533</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

合併公司支付關係人耗材費、雜項購置及委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
關聯企業	\$ <u>491</u>	<u>1,815</u>

合併公司因上述進貨及其他交易產生之應付關係人款項如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
其他關係人	\$ <u>-</u>	<u>465</u>

3.其他交易

民國一〇五年度關聯企業代合併公司支付專門技術購置款計3,223千元，截至一〇五年十二月三十一日，因前述交易產生之應付款項皆已付訖。

(三)主要管理階層人員交易

主要管理階層人員報酬如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
短期員工福利	\$ 28,622	25,609
退職後福利	<u>432</u>	<u>432</u>
	\$ <u>29,054</u>	<u>26,041</u>

八、質押之資產

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	\$ <u>3,820</u>	<u>3,714</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

十二、其他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功能別 性質別	106年度			105年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合計
員工福利費用						
薪資費用	31,114	703,743	734,857	26,666	651,286	677,952
勞健保費用	2,384	36,625	39,009	2,166	35,796	37,962
退休金費用	1,475	39,159	40,634	1,464	38,896	40,360
其他員工福利費用	1,398	19,427	20,825	1,373	18,614	19,987
折舊費用	4,894	52,125	57,019	6,201	46,689	52,890
攤銷費用	-	69,914	69,914	-	80,174	80,174

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇六年度合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高 持股比率	備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值		
本公司	第一金台灣債券基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產—流 動	13,336	202,799	-	202,799	-	
本公司	統一強棒基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產—流 動	6,342	105,374	-	105,374	-	
本公司	寶來得寶基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產—流 動	22,990	274,729	-	274,729	-	
Holtek Semiconduc tor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	以成本衡量之金融資 產	2,500	86,750	5.00 %	-	5.00 %	
盛凌投資股 份有限公司	譜永投資股份有限 公司	-	以成本衡量之金融資 產	23,124	143,000	3.03 %	-	3.03 %	
盛凌投資股 份有限公司	金佶科技股份有限 公司	-	以成本衡量之金融資 產	3,522	29,696	19.04 %	-	22.01 %	

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			期末		
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面成本	處分損益	單位數	金額
本公司	統一強棒基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	10,366	171,419	40,785	676,230	44,809	743,395	742,441	954	6,342	105,208 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(725,672)	(18) %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	216,424	28 %	
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	725,672	100 %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(216,424)	(100) %	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(432,002)	(10) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	92,435	12 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	432,002	44 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(92,435)	(61) %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(380,298)	(9) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	67,292	9 %	
優方	本公司	優方之母公司	進貨	380,298	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(67,292)	(100) %	
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(200,054)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	38,473	5 %	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	200,054	81 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(38,473)	(62) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(247,336)	(6) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	59,129	8 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	247,336	54 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(59,129)	(58) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(218,835)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	22,315	3 %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	218,835	38 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(22,315)	(17) %	
本公司	鈺威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(136,788)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	16,442	2 %	
鈺威	本公司	對鈺威採權益法評價之投資公司	進貨	136,788	6 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(16,442)	(11) %	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(223,427)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	58,637	7 %	

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、 帳款之比率	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法 評價之投資公司	進貨	223,427	48 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(58,637)	(55) %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權 益法評價之被投資公 司	銷貨	(138,764)	(3) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	18,216	2 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法 評價之投資公司	進貨	138,764	45 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(18,216)	(35) %	
本公司	Santek	本公司之子公司採權 益法評價之被投資公 司	銷貨	(101,721)	(2) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	19,819	3 %	
Santek	本公司	對Santek採權益法評 價之投資公司	進貨	101,721	71 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(19,819)	(76) %	
本公司	Bestway	本公司之子公司採權 益法評價之被投資公 司	銷貨	(111,592)	(3) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	30,594	4 %	
Bestway	本公司	對New Wave採權益法 評價之投資公司	進貨	111,592	63 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(30,594)	(69) %	

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項 之公司	交易對象 名稱	關係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 呆帳金額
					金 額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	216,424	3.74	-	即期收款	58,442 (註)	-

註1：係截至民國一〇七年一月十日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9. 從事衍生性商品交易：無。

10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人 之關係	交易往來情形			
				科 目	金 額	交易條件	佔合併總營收 或資產之比率
0	本公司	HOLTEK BVI	母公司對子公司	銷貨收入	725,672	月結90天	15.72 %
0	本公司	HOLTEK BVI	母公司對子公司	應收帳款	216,424	-	4.03 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	380,298	月結60天	8.24 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	應收帳款	67,292	-	1.25 %
0	本公司	Holtek (USA)	母公司對子公司	銷貨收入	40,139	月結60天	0.87 %

註：係揭示交易金額佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易。

(二) 轉投資事業相關資訊：

民國一〇六年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外 各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	515,668	100.00 %	28,316	28,316	本公司之 子公司 註2

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比例	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	121,653	100.00 %	2,740	2,740 註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	21,846	100.00 %	2,222	2,222 註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	21,846	100.00 %	2,222	註1,2	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	550,256	100.00 %	80,727	80,727 註2	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00 %	26,220	40.00 %	10,704	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00 %	11,147	100.00 %	2,439	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	45,347	40.00 %	19,207	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00 %	13,223	40.00 %	8,927	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00 %	17,701	40.00 %	13,637	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00 %	20,505	40.00 %	9,447	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Bestway Electronic Inc.	新棠(香港)有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	-	8,675	-	- %	-	100.00 %	2,098	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00 %	62,758	40.00 %	36,754	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61 %	68,253	40.61 %	37,281	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比例	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00 %	50,432	40.00 %	42,635	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	7,039	7,039	1	40.00 %	3,602	40.00 %	(3,463)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	2,937	2,028	1	60.00 %	1,703	60.00 %	(315)	註1,2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濤高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	17,380	40.00 %	2,465	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	滋達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.00 %	9,496	33.00 %	8,206	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	3,664	3,664	1	40.00 %	2,953	40.00 %	(1,566)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	20,965	-	5	80.00 %	21,703	100.00 %	(108)	註1,2	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	400,000	400,000	40,000	100.00 %	437,476	100.00 %	33,140	註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	89,140	77,035	7,200	40.00 %	113,362	40.00 %	38,779	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00 %	121,071	100.00 %	23,380	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	43,810	43,810	800	100.00 %	33,558	100.00 %	2,629	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦週邊及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	17,151	36.88 %	21,894	註1	本公司之孫公司
盛凌投資股份有限公司	鉛威股份有限公司	新北市	電子零組件加工製造、買賣進出口	37,500	37,500	5,641	22.39 %	63,673	22.39 %	8,724	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	高聖科技股份有限公司	新北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦週邊及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	2,350	2,350	235	39.17 %	-	39.17 %	3,761	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦週邊及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	18,605	40.00 %	21,894	註1,2	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件、電子材料批發	6,140	6,140	200	100.00 %	34,675	100.00 %	18,805	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	金佶科技股份有限公司	新竹市	模具批發、精密儀器批發、資訊軟體批發、電子材料批發、資訊軟體零售及電子材料零售、國際貿易及資訊軟體服務業、資訊處理服務及產品設計業、網路認證服務業	-	28,489	-	- %	-	- %	(20,312)	註1,3	本公司之子公司採成本法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比例	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
盛凌投資股份有限公司	天宇微機電股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	20.00 %	(1,228)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	盛通科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、資訊軟體服務及國際貿易	40,000	20,000	4,000	100.00 %	25,306	100.00 %	(5,079)	註1,2	本公司之孫公司
盛通科技股份有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	14,054	8,924	30	100.00 %	10,643	100.00 %	(796)	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	倍創科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發、無售店面零售業、國際貿易	10,000	10,000	1,000	100.00 %	9,936	100.00 %	(67)	註1,2	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：期末餘額已於民國106年3月31日轉列為以成本衡量之金融資產，所列被投資公司本期損益係民國106年1月至3月本期損益。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	(419)	100 %	100 %	(419)	115,065	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路、電子元器件及單片機晶片之批發及進出口業務與諮詢服務業務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	28,510	100 %	100 %	28,510	297,373	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	3,441	40 %	40 %	1,376	15,075	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	4,599	40 %	40 %	1,839	19,067	-

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	16,249	40 %	40 %	6,500	14,760	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	295	40 %	40 %	118	22,449	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(316)	40 %	40 %	(126)	6,168	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	10,018	40.61 %	40.61 %	4,068	23,863	-
信霖電子商貿(上海)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	1,714	40 %	40 %	685	43,555	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	17,859	40 %	40 %	7,144	34,338	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	5,833	40 %	40 %	2,333	16,489	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	2,743	100 %	100 %	2,743	121,614	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(2,001)	40 %	40 %	(800)	4,082	-
嘉芯安科技(深圳)有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	377	60 %	60 %	133	1,316	-
集芯源電子科技有限公司	電子元器件及單片機、晶片技術研發與諮詢服務	6,843	(註1)	-	-	-	-	5	40 %	40 %	2	6,802	-

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
悠健電子(東莞)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(1,326)	80 %	80 %	(1,061)	21,367	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註2、3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
471,089 (美金15,111千元)	521,075 (美金17,539千元)	2,442,743 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；經濟部投審會核准投資金額係以資產負債表日匯率換算新台幣金額。

註3：係包括核准自台灣匯出投資金額計447,243千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計73,832千元(美金2,485千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,071,239千元×60%＝2,442,743千元。

註5：經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一〇六年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項(於編製合併報告時業已沖銷)，請詳(一)「重大交易事項相關資訊」第10項「母子公司間業務關係及重要交易往來情形」之說明。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊及部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報表一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	106年度		105年度	
	金額	佔當期 營業收入 淨額之%	金額	佔當期 營業收入 淨額之%
積體電路銷貨收入	\$ 4,607,916	100	4,149,033	100
設計收入	7,001	-	8,755	-
	<u>\$ 4,614,917</u>	<u>100</u>	<u>4,157,788</u>	<u>100</u>

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

	106年度		105年度	
	金額	佔當期 營業收入 淨額之%	金額	佔當期 營業收入 淨額之%
來自外部客戶收入：				
中國	\$ 3,331,746	72	2,906,297	70
台灣	557,865	12	554,693	13
其他國家	<u>725,306</u>	<u>16</u>	<u>696,798</u>	<u>17</u>
	<u>\$ 4,614,917</u>	<u>100</u>	<u>4,157,788</u>	<u>100</u>
	106.12.31		105.12.31	
	金額	佔當期總 資產之%	金額	佔當期總 資產之%
非流動資產：				
台灣	\$ 188,647	4	231,192	5
中國	268,385	5	266,049	5
其他國家	<u>106</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 457,138</u>	<u>9</u>	<u>497,241</u>	<u>10</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(四)主要客戶

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	<u>106年度</u>		<u>105年度</u>	
	<u>金額</u>	<u>佔當期 營業收入 淨額之%</u>	<u>金額</u>	<u>佔當期 營業收入 淨額之%</u>
欣宏	\$ 571,681	12	516,928	12
CROWN RICH	465,727	10	382,812	9
NEW WAVE	<u>464,762</u>	<u>10</u>	<u>386,553</u>	<u>9</u>
	<u>\$ 1,502,170</u>	<u>32</u>	<u>1,286,293</u>	<u>30</u>

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群半導體股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入—關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列；與關係人間之重大交易事項請詳個體財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列一關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關人工及系統控制；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群半導體股份有限公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)。相關說明請詳個體財務報告附註六(四)(重要會計項目說明—存貨)。

關鍵查核事項之說明：

盛群半導體股份有限公司帳列存貨一致採用公司制定之呆滯評價政策評估，所應用產品範圍廣泛，各產品汰舊速度快慢不一，依各產品別分類評估應有不同類別之呆滯比率，因此，存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群半導體股份有限公司既訂之會計政策；執行存貨回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群半導體股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群半導體股份有限公司民國一〇六年度個別財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺

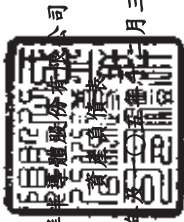


游萬勳



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇七年一月二十九日



盛群電腦股份有限公司

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 921,425	18	791,238	16
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	582,902	11	359,245	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	101,082	2	82,364	2
1180 應收關係人款項(附註七)	684,513	13	539,163	11
130X 存貨(附註六(四))	486,732	9	419,340	8
1476 其他金融資產－流動(附註六(五)及八)	670,131	13	1,089,727	22
1470 其他流動資產	23,298	-	18,005	-
	<u>3,470,083</u>	<u>66</u>	<u>3,299,082</u>	<u>66</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	1,508,655	29	1,441,423	29
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	165,050	3	177,908	3
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	49,503	1	41,080	1
1900 其他非流動資產	37,579	1	58,287	1
	<u>1,760,787</u>	<u>34</u>	<u>1,718,698</u>	<u>34</u>
資產總計	<u>\$ 5,230,870</u>	<u>100</u>	<u>5,017,780</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
106.12.31 應付票據	\$ 146,854	3	115,322	3
106.12.31 應付帳款	403,295	8	403,102	8
106.12.31 應付關係人款項(附註七)	7,331	-	5,318	-
106.12.31 應付薪資及獎金	250,133	5	231,616	5
106.12.31 本期所得稅負債	82,152	2	59,320	1
106.12.31 其他流動負債	78,249	1	69,023	1
	<u>968,014</u>	<u>19</u>	<u>883,701</u>	<u>18</u>
非流動負債：				
106.12.31 遞延所得稅負債(附註六(十))	110,137	2	90,633	2
106.12.31 淨確定福利負債(附註六(九))	72,938	1	69,574	1
106.12.31 存入保證金	8,542	-	8,542	-
	<u>191,617</u>	<u>3</u>	<u>168,749</u>	<u>3</u>
負債總計	<u>1,159,631</u>	<u>22</u>	<u>1,052,450</u>	<u>21</u>
權益(附註六(十一))：				
106.12.31 普通股股本	2,261,682	43	2,261,682	45
106.12.31 資本公積	142,309	3	159,281	3
106.12.31 保留盈餘：				
106.12.31 法定盈餘公積	750,029	14	781,525	15
106.12.31 特別盈餘公積	26,954	1	2,642	-
106.12.31 未分配盈餘	922,021	18	784,511	16
	<u>1,699,004</u>	<u>33</u>	<u>1,568,678</u>	<u>31</u>
	<u>(31,756)</u>	<u>(1)</u>	<u>(24,311)</u>	<u>-</u>
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	4,071,239	78	3,965,330	79
權益總計	<u>5,071,239</u>	<u>97</u>	<u>4,965,330</u>	<u>99</u>
負債及權益總計	<u>\$ 5,230,870</u>	<u>100</u>	<u>5,017,780</u>	<u>100</u>



董事長：吳啟勇

(附註六)



經理人：高國棟

會計主管：李文德



單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 4,130,794	100	3,695,728	100
5110 營業成本(附註六(四)、(十三)及七)	<u>2,235,347</u>	<u>54</u>	<u>1,961,044</u>	<u>53</u>
營業毛利	1,895,447	46	1,734,684	47
5910 未實現銷貨利益之變動	<u>38,452</u>	<u>1</u>	<u>(5,282)</u>	<u>-</u>
已實現營業毛利	<u>1,856,995</u>	<u>45</u>	<u>1,739,966</u>	<u>47</u>
營業費用(附註六(十三))：				
6100 推銷費用	98,272	3	95,296	3
6200 管理費用	249,816	6	228,508	6
6300 研究發展費用	<u>628,671</u>	<u>15</u>	<u>629,843</u>	<u>17</u>
	<u>976,759</u>	<u>24</u>	<u>953,647</u>	<u>26</u>
營業淨利	<u>880,236</u>	<u>21</u>	<u>786,319</u>	<u>21</u>
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	17,166	-	(24,177)	-
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	147,145	4	127,628	3
7100 利息收入(附註六(十四))	<u>7,318</u>	<u>-</u>	<u>11,611</u>	<u>-</u>
	<u>171,629</u>	<u>4</u>	<u>115,062</u>	<u>3</u>
稅前淨利	1,051,865	25	901,381	24
7950 所得稅費用(附註六(十))	<u>125,677</u>	<u>3</u>	<u>117,163</u>	<u>3</u>
本期淨利	<u>926,188</u>	<u>22</u>	<u>784,218</u>	<u>21</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8341 確定福利計畫之再衡量數	(5,148)	-	227	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	<u>875</u>	<u>-</u>	<u>(39)</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>(4,273)</u>	<u>-</u>	<u>188</u>	<u>-</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(9,426)	-	(62,980)	(1)
8371 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報告換算之兌換差額	456	-	(5,203)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	<u>1,525</u>	<u>-</u>	<u>11,592</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(7,445)</u>	<u>-</u>	<u>(56,591)</u>	<u>(1)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(11,718)</u>	<u>-</u>	<u>(56,403)</u>	<u>(1)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 914,470</u>	<u>22</u>	<u>727,815</u>	<u>20</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 4.10</u>		<u>3.47</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 4.06</u>		<u>3.44</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：吳啟勇

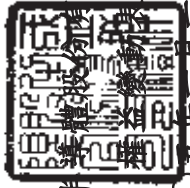


經理人：高國棟



會計主管：李文德





盛群半導體股份有限公司

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇五年一月一日餘額				保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	換算差		
本期淨利	\$ 2,261,682	142,309	794,631	2,642	794,419	32,280	4,027,963	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	784,218	-	784,218	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	188	(56,591)	(56,403)	
盈餘指撥及分配：					784,406	(56,591)	727,815	
提列法定盈餘公積	-	-	79,442	-	(79,442)	-	-	
普通股現金股利	-	-	(92,548)	-	(714,872)	-	(807,420)	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	16,972	-	-	-	-	16,972	
民國一〇五年十二月三十一日餘額	2,261,682	159,281	781,525	2,642	784,511	(24,311)	3,965,330	
本期淨利	-	-	-	-	926,188	-	926,188	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,273)	(7,445)	(11,718)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	921,915	(7,445)	914,470	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	78,422	-	(78,422)	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	24,312	(24,312)	-	-	
普通股現金股利	-	-	(109,918)	-	(681,671)	-	(791,589)	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(16,972)	-	-	-	-	(16,972)	
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	(31,756)	4,071,239	

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日員工酬勞分別為111,567千元及94,738千元、董事酬勞分別為12,286千元及10,526千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟

會計主管：李文德



董事長：吳啟勇





民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,051,865	901,381
調整項目：		
折舊費用	32,959	32,245
攤銷費用	69,433	79,889
利息收入	(7,318)	(11,611)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(147,145)	(127,628)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	38,452	(5,282)
其他不影響現金流量之費損淨額	3,325	3,687
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產增加	(222,513)	(144,100)
應收票據及帳款(含應收關係人款項)(增加)減少	(164,069)	6,058
存貨(增加)減少	(71,927)	69,223
其他營業資產(增加)減少	(3,993)	6,775
應付票據及帳款(含應付關係人款項)增加	33,737	93,202
淨確定福利負債減少	(1,784)	(1,937)
其他營業負債增加	26,638	23,564
營運產生之現金流入	637,660	925,466
收取利息	7,256	16,438
收取之股利	15,585	9,838
支付所得稅淨額	(89,364)	(108,229)
營業活動之淨現金流入	<u>571,137</u>	<u>843,513</u>
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	58,060
取得不動產、廠房及設備	(20,101)	(26,151)
處分不動產、廠房及設備價款	-	1,974
存出保證金增加	(183)	(308)
其他金融資產減少	419,314	405,272
其他非流動資產增加	(48,391)	(69,292)
投資活動之淨現金流入	<u>350,639</u>	<u>369,555</u>
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	-	1,888
發放股東現金股利	(791,589)	(807,420)
籌資活動之淨現金流出	<u>(791,589)</u>	<u>(805,532)</u>
本期現金及約當現金增加數	130,187	407,536
期初現金及約當現金餘額	791,238	383,702
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 921,425</u>	<u>791,238</u>

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：李文德



盛群半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一〇七年一月二十九日經提報董事會後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

本公司自民國一〇六年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇六年生效之國際財務報導準則編製個體財務報告，相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

<u>新發布／修正／修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會發布之生效日</u>
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：適用合併報表例外規定」	105年1月1日
國際財務報導準則第11號之修正「取得聯合營運權益之會計處理」	105年1月1日
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105年1月1日
國際會計準則第1號之修正「揭露倡議」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「農業：生產性植物」	105年1月1日
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103年7月1日
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105年1月1日

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103年1月1日
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替與避險會計之持續適用」	103年1月1日
2010-2012及2011-2013週期之年度改善	103年7月1日
2012-2014年國際財務報導年度改善	105年1月1日
國際財務報導解釋第21號「公課」	103年1月1日

適用上述新認可之國際財務報導準則對個體財務報告未造成重大變動。

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇六年七月十四日金管證審字第1060025773號令，公開發行以上公司應自民國一〇七年起全面採用經金管會認可並於民國一〇七年生效之國際財務報導準則。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第2號之修正「股份基礎給付交易之分類及衡量」	107年1月1日
國際財務報導準則第4號之修正「於國際財務報導準則第4號『保險合約』下國際財務報導準則第9號『金融工具』之適用」	107年1月1日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	108年1月1日
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	107年1月1日
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	106年1月1日
國際會計準則第12號之修正「因未實現損失所產生遞延所得稅資產之認列」	106年1月1日
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉列」	107年1月1日
國際財務報導準則2014-2016週期之年度改善：	
國際財務報導準則第12號之修正	106年1月1日
國際財務報導準則第1號之修正及國際會計準則第28號之修正	107年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易及預收(付)對價」	107年1月1日

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對個體財務報告造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1. 國際財務報導準則第九號「金融工具」

該準則將取代國際會計準則第三十九號「金融工具：認列與衡量」，修正金融工具之分類與衡量及減損。

(1) 金融資產之分類及衡量

該準則包含金融資產之新分類及衡量方法，其反映管理該金融資產之經營模式及現金流量特性。該準則主要將金融資產分類為按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量及透過損益按公允價值衡量三類，並刪除現行準則下持有至到期日、放款及應收款及備供出售金融資產之分類。依該準則，混合合約包含之主契約若屬該準則範圍內之金融資產，則不拆分嵌入之衍生工具，而係評估整體混合金融工具之分類。另國際會計準則第三十九號對於不具活絡市場報價且公允價值因而無法可靠衡量之無報價權益工具投資(及此類工具之衍生工具)之衡量規定具有一項例外，此類金融工具係按成本衡量；國際財務報導準則第九號刪除該項例外，規定所有權益工具(及其衍生工具)應按公允價值衡量。

本公司評估認為若適用新分類規定，將不會對應收帳款及以公允價值為基礎管理之權益工具投資之會計處理造成重大影響。另，本公司評估適用國際財務報導準則第九號分類與衡量，分類為透過損益按公允價值衡量將不會產生重大影響。

(2) 金融資產及合約資產之減損

該準則以前瞻性之預期信用損失模式取代現行國際會計準則第三十九號已發生減損損失模式，預期信用損失係以機率加權為基礎決定，經濟因素改變如何影響該損失需要相當的判斷。

預期信用損失模式適用於按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(除權益工具投資外)及合約資產。

國際財務報導準則第九號下，係依下列基礎衡量金融資產之減損損失：

- 十二個月預期信用損失：金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失；及
- 存續期間預期信用損失：金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

若金融工具自原始認列後信用風險已顯著增加，則適用存續期間預期信用損失衡量減損；若未顯著增加，則適用十二個月預期信用損失衡量減損。企業若判定金融工具於報導日之信用風險低，得假設該金融資產自原始認列後信用風險未顯著增加，然而，不具重大財務組成部分之應收帳款及合約資產，係按存續期間預期信用損失方法衡量。此外，本公司亦選擇以此方式衡量具重大財務組成部分之應收帳款和合約資產。

本公司評估適用國際財務報導準則第九號減損規定將不會產生重大影響。

(3)揭露

該準則包含大量之新揭露規定，尤其有關避險會計、信用風險及預期信用損失之揭露。本公司之評估包括從現有內部流程分析資料有差異之處，及規劃對系統及內部控制進行修改以擷取所需資料。

(4)過渡處理

除下列項目外，通常係追溯適用國際財務報導準則第九號：

- 本公司預計採用分類及衡量(包括減損)改變之豁免，無須重編以前期間之比較資訊。因採用該準則造成金融資產及金融負債帳面金額之差額，通常將調整民國一〇七年一月一日之保留盈餘及其他權益項目。
- 下列事項係以初次適用日存在之事實及情況為基礎評估：
 - 判定金融資產係以何種經營模式持有。
 - 先前指定為透過損益按公允價值之金融資產及金融負債之指定及撤銷。
 - 部分非持有供交易之權益工具投資作透過其他綜合損益按公允價值衡量之指定。

2.國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」

該準則將取代現行國際會計準則第十八號「收入」及國際會計準則第十一號「建造合約」以及其他收入相關的解釋，以單一分析模型按五個步驟決定企業認列收入之方法、時點及金額。

(1)銷售商品

針對產品之銷售，現行係於商品出貨時認列收入，於該時點客戶已接受該產品，且相關所有權之重大風險及報酬已移轉予客戶。於該時點認列收入，係因該時點收入及成本能可靠衡量、對價很有可能收回，且不再繼續參與對商品之管理。國際財務報導準則第十五號下，將於客戶取得對產品之控制時認列收入。本公司初步評估認為該產品之所有權重大風險及報酬移轉予客戶之時點與控制移轉之時點類似，故預期不會產生重大影響。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2) 過渡處理

本公司預計依累積影響數法適用國際財務報導準則第十五號，因此，無須重編以前期間之比較資訊，初次適用該準則之累積影響數將調整民國一〇七年一月一日之保留盈餘。本公司評估適用國際財務報導準則第十五號規定將不會產生重大影響。

3. 國際會計準則第十二號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」

修正條文闡明符合特定條件之情況下，將對未實現損失認列遞延所得稅資產，並釐清「未來課稅所得」之計算方式。

本公司評估上述修正將不會產生重大影響。

(三) 金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會(以下簡稱理事會)已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋。

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第16號「租賃」	108年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」	110年1月1日
國際財務報導解釋第23號「具不確定性之所得稅處理」	108年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	108年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	108年1月1日

對本公司可能攸關者如下：

發布日	新發布或修訂準則	主要修訂內容
105.1.13	國際財務報導準則第16號「租賃」	<p>新準則將租賃之會計處理修正如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 承租人所簽訂符合租賃定義之所有合約均應於資產負債表認列使用權資產及租賃負債。租賃期間內租賃費用則係以使用權資產折舊金額加計租賃負債之利息攤提金額衡量。 • 出租人所簽訂符合租賃定義之合約則應分類為營業租賃及融資租賃，其會計處理與國際會計準則第17號「租賃」類似。

本公司現正持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除另有說明者外，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1) 依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；及
- (2) 淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2. 功能性貨幣及表達貨幣

本公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三) 外幣

1. 外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2. 國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗。
- 2.主要為交易目的而持有該資產。
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期於其正常營業週期中清償該負債。
- 2.主要為交易目的而持有該負債。
- 3.預期於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含本公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(七)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(八)投資關聯企業

關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

個體財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

(九)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築物：20~30年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

每年至少於財務年度結束日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十一)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十二)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

本公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

每年至少於財務年度結束日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十三)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，本公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

(十四)收入認列

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售訂單個別條款而定。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

本公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與本公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於財務報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司有利時，認列資產係以未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於本公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對本公司而言，即具有經濟效益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

淨確定福利負債之再衡量數包含(1)精算損益；(2)計畫資產報酬，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額；及(3)資產上限影響數之任何變動，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額。淨確定福利負債再衡量數認列於其他綜合損益項目下。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量為基礎衡量。

有關股份基礎給付獎酬之非既得條件，已反映於股份基礎給付給與日公允價值之衡量，且預期與實際結果間之差異無須作核實調整。

應給付予員工之股份增值權，係以該股份增值權之公允價值衡量後採現金交割者，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列費用並增加相對負債。相關負債於各報導日及交割日應予重新衡量，其公允價值之任何變動認列為損益項下。

(十七)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十八)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依「證券發行人財務報告編製準則」編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理當局持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

(一)存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，本公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

(二)確定福利義務之衡量

確定福利退休計畫應認列之確定福利成本及淨確定福利負債係使用預計單位福利法進行精算評價，其採用之精算假設包括折現率、員工離職率及未來薪資增加率等，若該等假設因市場與經濟情況之改變而有所變動，可能會重大影響認列之費用與負債金額。精算所採用之重大精算假設說明及敏感度分析請詳附註六(九)。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。本公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

本公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，本公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十五)，金融工具。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	106.12.31	105.12.31
現金及活期存款	\$ 70,837	91,976
定期存款	850,588	699,262
	\$ 921,425	791,238

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產

	106.12.31	105.12.31
持有供交易之金融資產－受益憑證	\$ 582,902	359,245

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少4,838千元及2,982千元。

(三)應收票據及帳款淨額

	106.12.31	105.12.31
應收票據	\$ 827	1,040
應收帳款	107,648	88,717
	108,475	89,757
減：備抵呆帳	(7,393)	(7,393)
	\$ 101,082	82,364

本公司於民國一〇六年度及一〇五年度無已逾期但未減損應收票據、應收帳款及其他應收款。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司於民國一〇六年度及一〇五年度針對應收票據及應收帳款並無提列減損損失情形。

(四)存貨

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
原料及物料	\$ 101,482	80,292
在製品	216,127	187,190
製成品及商品	<u>169,123</u>	<u>151,858</u>
	<u>\$ 486,732</u>	<u>419,340</u>

營業成本組成明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
銷貨成本	\$ 2,230,812	1,955,937
報廢成本	<u>4,535</u>	<u>5,107</u>
	<u>\$ 2,235,347</u>	<u>1,961,044</u>

(五)其他金融資產－流動

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 665,700	1,085,020
受限制銀行存款	3,720	3,714
其他	<u>711</u>	<u>993</u>
	<u>\$ 670,131</u>	<u>1,089,727</u>

(六)採用權益法之投資

本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
子公司	\$ 1,646,899	1,541,281
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(138,244)</u>	<u>(99,858)</u>
	<u>\$ 1,508,655</u>	<u>1,441,423</u>

子公司相關資訊請參閱民國一〇六年度合併財務報告。

本公司民國一〇六年度及一〇五年度所享有子公司利益之份額分別為147,145千元及127,628千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(七)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國106年1月1日餘額	\$ 26,676	264,352	244,767	46,513	582,308
增添	-	1,311	11,512	7,278	20,101
處分	-	-	(8,585)	(11,289)	(19,874)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>265,663</u>	<u>247,694</u>	<u>42,502</u>	<u>582,535</u>
民國105年1月1日餘額	\$ 26,676	262,663	230,446	47,556	567,341
增添	-	1,689	17,409	7,053	26,151
處分	-	-	(3,088)	(8,096)	(11,184)
民國105年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>264,352</u>	<u>244,767</u>	<u>46,513</u>	<u>582,308</u>
累計折舊：					
民國106年1月1日餘額	\$ -	156,236	214,147	34,017	404,400
本期折舊	-	13,452	14,542	4,965	32,959
處分	-	-	(8,585)	(11,289)	(19,874)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>169,688</u>	<u>220,104</u>	<u>27,693</u>	<u>417,485</u>
民國105年1月1日餘額	\$ -	142,925	203,008	36,127	382,060
本期折舊	-	13,311	14,227	4,707	32,245
處分	-	-	(3,088)	(6,817)	(9,905)
民國105年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>156,236</u>	<u>214,147</u>	<u>34,017</u>	<u>404,400</u>
帳面價值：					
民國106年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>95,975</u>	<u>27,590</u>	<u>14,809</u>	<u>165,050</u>
民國105年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>108,116</u>	<u>30,620</u>	<u>12,496</u>	<u>177,908</u>
民國105年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>119,738</u>	<u>27,438</u>	<u>11,429</u>	<u>185,281</u>

(八)營業租賃

1.本公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	106.12.31	105.12.31
一年內	\$ 6,198	10,595
一年以上至二年	191	6,618
	<u>\$ 6,389</u>	<u>17,213</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

- 2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇六年九月起租金每年約為3,251千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(九)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	106.12.31	105.12.31
確定福利義務現值	\$ 123,354	118,013
計畫資產之公允價值	(50,416)	(48,439)
淨確定福利負債	\$ 72,938	69,574

本公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計50,416千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

本公司民國一〇六年度及一〇五年度確定福利義務現值變動如下：

	106年度	105年度
1月1日確定福利義務	\$ 118,013	119,433
計畫支付之福利	(1,310)	(2,423)
當期服務成本及利息	1,770	1,542
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損(益)	4,941	(1,714)
— 因人口假設變動所產生之精算損失	-	129
— 因經驗變動所產生之精算(益)損	(60)	1,046
12月31日確定福利義務	\$ 123,354	118,013

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)計畫資產公允價值之變動

本公司民國一〇六年度及一〇五年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 48,439	47,695
計畫支付之福利	(1,310)	(2,423)
利息收入	748	652
已提撥至計畫之金額	2,806	2,827
淨確定福利負債再衡量數		
— 計畫資產報酬(不含當期利息)	<u>(267)</u>	<u>(312)</u>
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 50,416</u>	<u>48,439</u>

(4)認列為損益之費用

本公司民國一〇六年度及一〇五年度認列為損益之費用如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
淨確定福利負債之淨利息	<u>\$ 1,022</u>	<u>890</u>
營業成本	\$ 70	62
推銷費用	79	60
管理費用	185	159
研究發展費用	<u>688</u>	<u>609</u>
	<u>\$ 1,022</u>	<u>890</u>

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

本公司民國一〇六年度及一〇五年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
1月1日累積餘額	\$ 10,737	10,964
本期認列	<u>5,148</u>	<u>(227)</u>
12月31日累積餘額	<u>\$ 15,885</u>	<u>10,737</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(6)精算假設

本公司於年度財務報導期間結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	106.12.31	105.12.31
折現率	1.20 %	1.50 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

本公司預計於民國一〇六年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,880千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為13.1年。

(7)敏感度分析

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加1%	減少1%
106年12月31日		
折現率	\$ <u>(15,542)</u>	<u>18,433</u>
未來薪資增加	\$ <u>16,710</u>	<u>(14,503)</u>
105年12月31日		
折現率	\$ <u>(15,588)</u>	<u>18,594</u>
未來薪資增加	\$ <u>16,975</u>	<u>(14,645)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2.確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。本公司民國一〇六年度及一〇五年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為20,056千元及19,966千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇六年度及一〇五年度國外分公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為808千元及768千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十)所得稅

1.所得稅費用

本公司民國一〇六年度及一〇五年度之所得稅費用明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 111,687	90,189
調整前期之當期所得稅	<u>509</u>	<u>4,535</u>
	<u>112,196</u>	<u>94,724</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	<u>13,481</u>	<u>22,439</u>
所得稅費用	<u>\$ 125,677</u>	<u>117,163</u>

本公司民國一〇六年度及一〇五年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	<u>\$ (875)</u>	<u>39</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	<u>\$ (1,525)</u>	<u>(11,592)</u>

本公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
稅前淨利	\$ 1,051,865	901,381
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	178,817	153,235
永久性差異調整	(5,796)	(3,045)
免稅所得	(55,078)	(36,335)
投資抵減預期新增數	-	(1,227)
以前年度所得稅核定及估計差異	(885)	4,535
所得基本稅額	<u>8,619</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 125,677</u>	<u>117,163</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2. 遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	105.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	105.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	106.12.31
存貨跌價損失	\$ 10,200	-	-	10,200	-	-	10,200
未實現聯屬公司間利益	17,889	913	-	16,976	(6,525)	-	23,501
淨確定福利負債	12,195	329	39	11,827	303	(875)	12,399
國外營運機構財務報告 換算之兌換損失	-	-	(1,878)	1,878	-	(1,525)	3,403
其他	1,793	1,594	-	199	199	-	-
	<u>\$ 42,077</u>	<u>2,836</u>	<u>(1,839)</u>	<u>41,080</u>	<u>(6,023)</u>	<u>(2,400)</u>	<u>49,503</u>

遞延所得稅負債

	105.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	105.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	106.12.31
國外營運機構財務報告 換算之兌換利益	\$ (9,714)	-	(9,714)	-	-	-	-
採權益法認列之國外投 資利益	(70,951)	18,753	-	(89,704)	19,381	-	(109,085)
其他	(79)	850	-	(929)	123	-	(1,052)
	<u>\$ (80,744)</u>	<u>19,603</u>	<u>(9,714)</u>	<u>(90,633)</u>	<u>19,504</u>	<u>-</u>	<u>(110,137)</u>

3. 本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇三年度。

4. 兩稅合一相關資訊如下：

	106.12.31	105.12.31
屬民國八十七年度以後之未分配盈餘	<u>\$ 922,021</u>	<u>784,511</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 48,266</u>	<u>63,038</u>
	106年度	105年度
	(預計)	(實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>13.02%</u>	<u>12.80%</u>

前述民國一〇五年度兩稅合一相關資訊係依據財政部民國一〇二年十月十七日台財稅第10204562810號函規定處理之金額。另，所得稅法修正案已於民國一〇七年一月十八日經立法院三讀通過，將營利事業所得稅率自民國一〇七年度起由現行17%提高至20%，該稅率變動不影響民國一〇六年度帳列之當期及遞延所得稅，並取消股東可扣抵稅額帳戶之設置、記載、計算及分配。上列民國一〇六年度預計稅額扣抵比率自民國一〇七年一月一日起不再適用，該等資訊僅供參考。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度),實收股本均為2,261,682千元,每股面額10元。

2.資本公積

本公司資本公積餘額如下:

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
發行股票溢價	\$ 142,309	142,309
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	16,972
	<u>\$ 142,309</u>	<u>159,281</u>

依公司法規定,資本公積需優先填補虧損後,始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積,包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定,得撥充資本之資本公積,每年撥充之合計金額,不得超過實收資本額百分之十。

3.保留盈餘

依本公司章程規定,公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案,提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份,其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依公司法規定,公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積,直至與資本總額相等為止。公司無虧損時,得經股東會決議,以法定盈餘公積發給新股或現金,惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2) 特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3) 盈餘分派

本公司分別於民國一〇六年五月二十六日及國一〇五年五月二十七日經股東常會決議民國一〇五年度及一〇四年度之盈餘分派案，分派予業主之股利如下：

	105年度		104年度	
	每股股利	金 額	每股股利	金 額
	(元)		(元)	
分派予普通股業主之現金股利	\$ 3.50	791,589	3.57	807,420

(十二) 每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	106年度	105年度
基本每股盈餘：		
本期淨利	\$ 926,188	784,218
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	226,168	226,168
基本每股盈餘(元)	\$ 4.10	3.47

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>926,188</u>	<u>784,218</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)	<u>1,746</u>	<u>2,037</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>227,914</u>	<u>228,205</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.06</u>	<u>3.44</u>

(十三)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一〇六年度及一〇五年度員工酬勞估列金額分別為111,567千元及94,738千元，董事酬勞估列金額分別為12,286千元及10,526千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國一〇六年度及一〇五年度之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日的收盤價。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度員工酬勞提列金額分別為94,738千元及98,027千元，董事酬勞提列金額分別為10,526千元及10,892千元，皆係以現金發放，其中民國一〇五年度以董事酬勞科目發放金額為10,416千元，差異係帳列科目調整，民國一〇四年度實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十四)營業外收入及支出

綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
外幣兌換損益淨額	\$ 14,267	(33,421)
其他	<u>2,899</u>	<u>9,244</u>
	\$ <u>17,166</u>	<u>(24,177)</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十五)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為2,965,615千元及2,867,116千元。

本公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於本公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

本公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

本公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日佔本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為308,859千元及260,575千元，使本公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵呆帳，管理當局預期未來不致有重大損失。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日分析：

	<u>帳面金額</u>	<u>合 約 現金流量</u>	<u>1年以內</u>	<u>超過5年</u>
106年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 557,480	557,480	557,480	-
存入保證金	<u>8,542</u>	<u>8,542</u>	<u>-</u>	<u>8,542</u>
	<u>\$ 566,022</u>	<u>566,022</u>	<u>557,480</u>	<u>8,542</u>
105年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 523,742	523,742	523,742	-
存入保證金	<u>8,542</u>	<u>8,542</u>	<u>-</u>	<u>8,542</u>
	<u>\$ 532,284</u>	<u>532,284</u>	<u>523,742</u>	<u>8,542</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.市場風險

(1)匯率風險

A.匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	106.12.31			105.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 6,405	29.71	190,291	6,964	32.2	224,228
人民幣	143,985	4.5394	653,605	106,000	4.5965	487,231
<u>非貨幣性項目</u>						
美金	\$ 40,708	29.71	1,209,424	34,312	32.2	1,104,845
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 8,081	29.71	240,082	6,977	32.2	224,660
人民幣	14,933	4.5394	67,786	13,805	4.5965	63,455

B.敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇六年度及一〇五年度之稅後淨利將分別增加或減少4,449千元及3,514千元。

C.貨幣性項目之兌換損益

由於本公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇六年度及一〇五年度外幣兌換利益(損失)淨額(含已實現及未實現)分別為14,267千元及(33,421)千元。

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

本公司透過損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量之金融工具其帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	105.12.31				合 計
	帳面價值	公 允 價 值			
		第一級	第二級	第三級	
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 523,742	-	-	-	-
存入保證金	8,542	-	-	-	-
	<u>\$ 532,284</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

本公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

民國一〇六年度及一〇五年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(十六)財務風險管理

1.概 要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十五)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助本公司董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於本公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十五)。另，截至民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.流動性風險

流動性風險係本公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。本公司管理流動性之方法係盡可能確保本公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使本公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督本公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控本公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保本公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇六年十二月三十一日止，本公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度148,800千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

本公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

(1)本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十七)資本管理

董事會管理資本之目標係確保本公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據本公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定本公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對本公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據本公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定本公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

截至民國一〇六年十二月三十一日止，本公司資本管理之方式並未改變。
本公司於報導日之負債權益比率如下：

	106.12.31	105.12.31
負債總額	\$ 1,159,631	1,052,450
權益總額	\$ 4,071,239	3,965,330
負債權益比率	28.48%	26.54%

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本個體財務報告之涵蓋期間內與本公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與本公司之關係
ANCHIP	本公司之子公司
HOLTEK (USA)	本公司之子公司
HOLTEK (BVI)	本公司之子公司
合泰	本公司之子公司
芯群	本公司之子公司
金科	本公司之子公司
倍創	本公司之子公司
悠健	本公司之子公司
盛通	本公司之子公司
優方	本公司之子公司
CROWN RICH	本公司之關聯企業
FINE CHIP	本公司之關聯企業
FORIC	本公司之關聯企業
JXY	本公司之關聯企業
NEW WAVE	本公司之關聯企業
NEWTEK	本公司之關聯企業
QUANDING	本公司之關聯企業
SANTEK	本公司之關聯企業
TRUETEK	本公司之關聯企業
BESTWAY	本公司之關聯企業

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

關係人名稱	與本公司之關係
欣宏	本公司之關聯企業
金佶	其他關係人
金濤高科	本公司之關聯企業
泓達	本公司之關聯企業
高聖	本公司之關聯企業
鈺威	本公司之關聯企業

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
HOLTEK (BVI)	\$ 725,672	698,706
欣宏	432,002	480,187
其他	<u>1,957,214</u>	<u>1,519,121</u>
	<u>\$ 3,114,888</u>	<u>2,698,014</u>

本公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。本公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

截至民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日止，本公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為138,115千元及99,663千元，帳列採用權益法之投資項下。

本公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
HOLTEK (BVI)	\$ 216,424	171,855
欣宏	92,435	95,448
其他	<u>375,654</u>	<u>271,860</u>
	<u>\$ 684,513</u>	<u>539,163</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.進貨

本公司向關係人進貨金額如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
子公司	\$ 11,349	13,611
關聯企業	<u>584</u>	<u>533</u>
	<u>\$ 11,933</u>	<u>14,144</u>

本公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

本公司支付關係人耗材費、雜項購置及委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
子公司	\$ 18,884	20,475
關聯企業	<u>492</u>	<u>1,814</u>
	<u>\$ 19,376</u>	<u>22,289</u>

本公司因上述進貨及其他交易產生之應付關係人款項如下：

	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
子公司	\$ 7,331	4,853
關聯企業	<u>-</u>	<u>465</u>
	<u>\$ 7,331</u>	<u>5,318</u>

3.其他交易

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日，本公司因出售機器設備予金科及合泰所產生之未實現利益分別為129千元及195千元，帳列採權益法之投資項下。

(三)主要管理階層人員交易

主要管理階層人員報酬如下：

	<u>106年度</u>	<u>105年度</u>
短期員工福利	\$ 23,692	19,514
退職後福利	<u>432</u>	<u>432</u>
	<u>\$ 24,124</u>	<u>19,946</u>

八、質押之資產

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	<u>\$ 3,720</u>	<u>3,714</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

本公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	106年度			105年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	31,114	554,149	585,263	26,666	508,791	535,457
勞健保費用	2,235	32,216	34,451	2,206	30,496	32,702
退休金費用	1,475	20,411	21,886	1,464	20,160	21,624
其他員工福利費用	1,398	16,383	17,781	1,372	15,968	17,340
折舊費用	4,894	28,065	32,959	6,161	26,084	32,245
攤銷費用	-	69,433	69,433	-	79,889	79,889

本公司民國一〇六年度及一〇五年度平均員工人數分別為400人及401人。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇六年度本公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	13,336	202,799	-	202,799	
本公司	統一強棒基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	6,342	105,374	-	105,374	
本公司	寶來得寶基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	22,990	274,729	-	274,729	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	以成本衡量之金融資產	2,500	86,750	5.00 %	-	
盛凌投資股份有限公司	諧永投資股份有限公司	-	以成本衡量之金融資產	23,124	143,000	3.03 %	-	
盛凌投資股份有限公司	金佶科技股份有限公司	-	以成本衡量之金融資產	3,522	29,696	19.04 %	-	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣 之公司	有價證券 種類及 名稱	帳列 科目	交易 對象	關 係	期 初		買 入		賣 出			期 末		
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面 成本	處分 損益	單位數	金額
本公司	統一強棒基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	10,366	171,419	40,785	676,230	44,809	743,395	742,441	954	6,342	105,208 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、 帳款之比率	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(725,672)	(18) %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	216,424	28 %	
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	725,672	100 %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(216,424)	(100) %	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(432,002)	(10) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	92,435	12 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	432,002	44 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(92,435)	(61) %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(380,298)	(9) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	67,292	9 %	
優方	本公司	優方之母公司	進貨	380,298	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(67,292)	(100) %	
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(200,054)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	38,473	5 %	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	200,054	81 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(38,473)	(62) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(247,336)	(6) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	59,129	8 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	247,336	54 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(59,129)	(58) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(218,835)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	22,315	3 %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	218,835	38 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(22,315)	(17) %	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	鉛威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(136,788)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	16,442	2 %	
鉛威	本公司	對鉛威採權益法評價之投資公司	進貨	136,788	6 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(16,442)	(11) %	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(223,427)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	58,637	7 %	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	223,427	48 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(58,637)	(55) %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(138,764)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	18,216	2 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	138,764	45 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(18,216)	(35) %	
本公司	Santek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(101,721)	(2) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	19,819	3 %	
Santek	本公司	對Santek採權益法評價之投資公司	進貨	101,721	71 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(19,819)	(76) %	
本公司	Bestway	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(111,592)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	30,594	4 %	
Bestway	本公司	對Bestway採權益法評價之投資公司	進貨	111,592	63 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(30,594)	(69) %	

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	216,424	3.74	-	即期收款	58,442 (註)	-

註：係截至民國一〇七年一月十日止收回之金額。

9. 從事衍生性商品交易：無。

(二) 轉投資事業相關資訊：

民國一〇六年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	515,668	28,316	28,316	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	121,653	2,740	2,740	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	21,846	2,222	2,222	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	21,846	2,222	註1	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	550,256	80,727	80,727	本公司之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00 %	26,220	10,704	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00 %	11,147	2,439	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	45,347	19,207	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00 %	13,223	8,927	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00 %	17,701	13,637	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00 %	20,505	9,447	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Bestway Electronic Inc.	新榮(香港)有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	-	8,675	-	-	-	2,098	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00 %	62,758	36,754	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61 %	68,253	37,281	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00 %	50,432	42,635	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	7,039	7,039	1	40.00 %	3,602	(3,463)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,937	2,028	1	60.00 %	1,703	(315)	註1	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	17,380	2,465	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	滄達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.00 %	9,496	8,206	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機芯件的技術支持與諮詢服務	3,664	3,664	1	40.00 %	2,953	(1,566)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機芯件的技術支持與諮詢服務	20,965	-	5	80.00 %	21,703	(108)	註1,2	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	400,000	400,000	40,000	100.00 %	437,476	33,140	33,140	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	89,140	77,035	7,200	40.00 %	113,362	38,779	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00 %	121,071	23,380	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機芯件的技術支持與諮詢服務	43,810	43,810	800	100.00 %	33,558	2,629	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	17,151	21,894	註1	本公司之孫公司
盛凌投資股份有限公司	鈺威股份有限公司	新北市	電子零組件加工製造、買賣進出口	37,500	37,500	5,641	22.39 %	63,673	8,724	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	高聖科技股份有限公司	新北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	2,350	2,350	235	39.17 %	-	3,761	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	18,605	21,894	註1	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件、電子材料批發	6,140	6,140	200	100.00 %	34,675	18,805	註1	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	金信科技股份有限公司	新竹市	模具批發、精密儀器批發、資訊軟體批發、電子材料批發、資訊軟體零售及電子材料零售、國際貿易及資訊軟體服務業、資訊處理服務及產品設計業、網路認證服務業	-	28,489	-	-	-	(20,312)	註1,2	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	天宇微機電股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	(1,228)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	盛通科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、資訊軟體服務及國際貿易	40,000	20,000	4,000	100.00 %	25,306	(5,079)	註1	本公司之孫公司
盛通科技股份有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	14,054	8,924	30	100.00 %	10,643	(796)	註1	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	倍創科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發、無店面零售業、國際貿易	10,000	10,000	1,000	100.00 %	9,936	(67)	註1	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：期末餘額已於民國106年3月31日轉列為以成本衡量之金融資產，所列被投資公司本期損益係民國106年1月至3月本期損益。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	(419)	100 %	(419)	115,065	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式	本年期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列 投資損益 (註5)	期末投 資帳面 價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
合泰半導體 (中國)有限 公司	集成電 路、電子 元器件及 單片機芯 片之批發 及進出口 業務與諮 詢服務業 務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	28,510	100 %	28,510	297,373	-
新緯科技(深 圳)有限公司	電子零件 銷售及售 後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	3,441	40 %	1,376	15,075	-
新禾(廈門) 電子有限公 司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	4,599	40 %	1,839	19,067	-
諾華達電子 (深圳)有限 公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	16,249	40 %	6,500	14,760	-
華榮匯電子 科技(北京) 有限公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	295	40 %	118	22,449	-
振揚電子(青 島)有限公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(316)	40 %	(126)	6,168	-
新鼎電子(深 圳)有限公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	10,018	40.61 %	4,068	23,863	-
信霖電子商 貿(上海)有 限公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	1,714	40 %	685	43,555	-
華瑞昇電子 (深圳)有限 公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	17,859	40 %	7,144	34,338	-
全鼎電子(蘇 州)有限公司	電子元器 件及單片 機晶片技 術支持與 諮詢服務 業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	5,833	40 %	2,333	16,489	-
金科集成電 路(蘇州)有 限公司	電子零件 銷售及售 後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	2,743	100 %	2,743	121,614	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列 投資損益 (註5)	期末投 資帳面 價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
健芳電子科 技(上海)有 限公司	電子元器 件及單片 機芯片技 術研發與 諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(2,001)	40 %	(800)	4,082	-
嘉芯安科技 (深圳)有限 公司	電子元器 件及單片 機芯片技 術研發與 諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	377	60 %	133	1,316	-
集芯源電子 科技有限公司	電子元器 件及單片 機芯片技 術研發與 諮詢服務	6,843	(註1)	-	-	-	-	5	40 %	2	6,802	-
悠健電子(東 莞)有限公司	電子元器 件及單片 機芯片技 術研發與 諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(1,326)	80 %	(1,061)	21,367	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准 投資金額(註2、3)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
471,089 (美金15,111千元)	521,075 (美金17,539千元)	2,442,743 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；經濟部投審會核准投資金額係以資產負債表日匯率換算新台幣金額。

註3：係包括核准自台灣匯出投資金額計447,243千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計73,832千元(美金2,485千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,071,239千元×60% = 2,442,743千元。

註5：經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一〇六年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

請詳民國一〇六年度合併財務報告。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	106.12.31	105.12.31	差 異	
			金額	%
流 動 資 產	4,179,054	3,928,641	250,413	6
不 動 產、廠 房 及 設 備	414,729	442,570	(27,841)	(6)
其 他 資 產	770,487	763,556	6,931	1
資 產 總 額	5,364,270	5,134,767	229,503	4
流 動 負 債	1,068,788	977,382	91,406	9
非 流 動 負 債	196,636	173,262	23,374	13
負 債 總 額	1,265,424	1,150,644	114,780	10
股 本	2,261,682	2,261,682	0	0
資 本 公 積	142,309	159,281	(16,972)	(11)
保 留 盈 餘	1,699,004	1,568,678	130,326	8
股 東 權 益 總 額	4,098,846	3,984,123	114,723	3
重大變動項目說明： 1. 非流動負債較105年度期末增加，主要係遞延所得稅負債增加所致。 2. 資本公積較105年度期末減少，主要係轉投資公司持股比率異動所致。				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

年 度	106 年度	105 年度	增(減)金額	變 動 比 例 %
營業收入淨額	4,614,917	4,157,788	457,129	10.99
營業成本	2,425,457	2,139,643	285,814	13.36
營業毛利	2,189,460	2,018,145	171,315	8.49
減:未實現銷貨利益之變動	27,374	2,437	24,937	1023.27
已實現營業毛利	2,162,086	2,015,708	146,378	7.26
營業費用	1,218,775	1,182,018	36,757	3.11
營業利益	943,311	833,690	109,621	13.15
營業外收入及利益	126,479	84,273	42,206	50.08
稅前淨利	1,069,790	917,963	151,827	16.54
所得稅利益(費用)	(133,803)	(125,241)	(8,562)	6.84
本期淨利	935,987	792,722	143,265	18.07
其他綜合損益(稅後淨額)	(11,703)	(56,403)	44,700	(79.25)
本期綜合損益總額	<u>924,284</u>	<u>736,319</u>	<u>187,965</u>	<u>25.53</u>
本期淨利歸屬母公司業主	926,188	784,218	141,970	18.10
本期淨利歸屬非控制權益	9,799	8,504	1,295	15.23
綜合損益歸屬母公司業主	914,470	727,815	186,655	25.65
綜合損益歸屬非控制權益	9,814	8,504	1,310	15.40

增減比例變動分析說明：

1. 106 年度聯屬公司間未實現銷貨毛利增加，主要係出貨至轉投資公司，而轉投資公司尚未出貨至終端客戶之未實現銷貨利益增加所致。
2. 營業外收入及利益增加，主要係外幣兌換利益增加所致。
3. 106 年度其他綜合損益增加，主要係國外營運機構財務報告換算之兌換差額(稅後淨額)較 105 年度增加所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 106 年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,149,307	699,271	(456,850)	1,391,728	—	—
106 年度現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2. 投資活動：存放三個月以上定存減少，致產生投資活動淨現金流入。					
3. 融資活動：發放股東現金紅利，致產生融資活動淨現金流出。					

(二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,391,728	700,000	(900,000)	1,191,728	—	—
107 年現金流量情形分析：					
1. 營業活動：係預期營運持續成長、獲利增加，致使營業活動淨現金流入。					
2. 融資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利增加，致產生融資活動淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，106 年度依權益法認列之投資收益淨額為 81,967 仟元，轉投資狀況請參閱財務報告第 134 頁~第 138 頁附註十三之(二)說明。

1. 轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
2. 未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。
- 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：
 - (1)業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
 - (2)除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
 - (3)開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。
- 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務，而若從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波動之變動風險，因係避險性質，並未對公司損益造成重大影響之虞。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，聚焦在家電產品、健康量測、安全防護、電腦週邊、工業控制、車用電子、儀表顯示等領域之市場應用，每年以投入約營業額之 15%~20% 作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 15%~20% 作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應

科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝測試之代工廠商合作，並無進貨過度集中之情形。

2. 本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

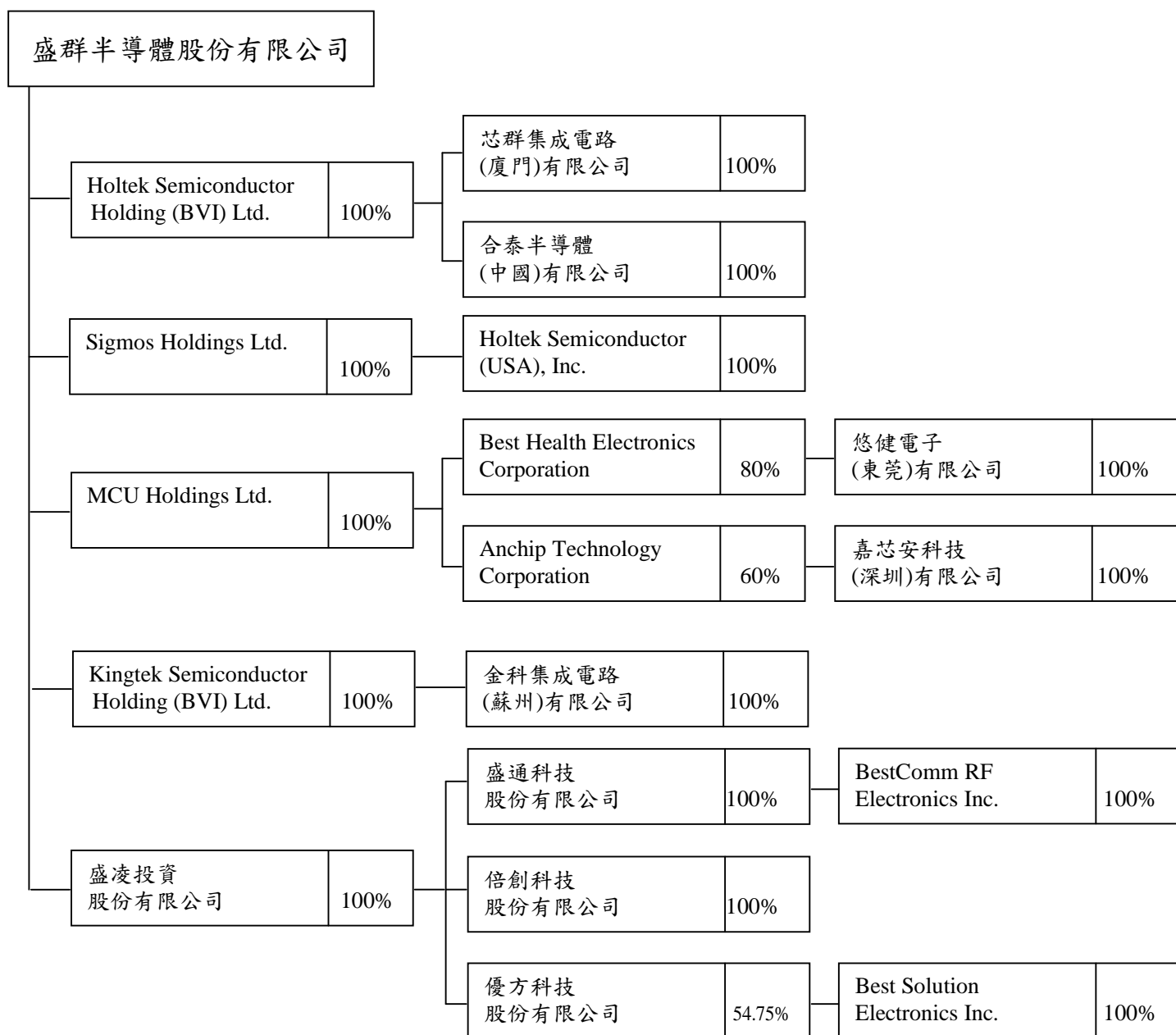
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1.關係企業組織圖



(二)關係企業基本資料

日期：106年12月31日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	88.10	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$15,253,360	投資海外各項事業
Sigmos Holdings Ltd.	89.12	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$200,000	投資海外各項事業
MCU Holdings Ltd.	91.05	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$500,000	投資海外各項事業
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	91.01	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$2,000,000	投資海外各項事業
盛凌投資股份有限公司	92.03	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$400,000,000	專營投資業務
合泰半導體(中國)有限公司	101.07	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)	US\$9,764,280	積體電路買賣及技術服務
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	90.05	19 Hammond, Suite 513, Irvine, CA 92618, USA	US\$200,000	積體電路買賣及技術服務
金科集成電路(蘇州)有限公司	91.04	蘇州工業園區星漢街 5 號 D 幢 3 樓 7/8 單元	US\$2,000,000	積體電路買賣及技術服務
芯群集成電路(廈門)有限公司	97.02	中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室	US\$3,500,000	單片機芯片及其應用工具的技術服務
Best Health Electronics Corporation	106.06	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$6,000,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
悠健電子(東莞)有限公司	106.09	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 301	RMB\$5,000,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
Anchip Technology Corporation	104.11	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$1,000,000	安防應用 IC 銷售及技術服務
嘉芯安科技(深圳)有限公司	105.11	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 401	RMB\$300,000	安防應用 IC 銷售及技術服務
盛通科技股份有限公司	103.01	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$40,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
BestComm RF Electronics Inc.	103.03	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$3,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
倍創科技股份有限公司	105.05	新竹市金山十一街 20 巷 18 號 1 樓	NT\$10,000,000	MCU 模組之銷售及技術服務
優方科技股份有限公司	97.05	臺北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2	NT\$20,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
Best Solution Electronics Inc.	97.08	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$200,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
對各種事業之投資	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	投資芯群集成電路(廈門)及合泰半導體(中國)等公司。
	Sigmos Holdings Ltd.	投資 Holtek Semiconductor (USA), Inc.。
	MCU Holdings Ltd.	為本公司投資業務。
	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	投資金科集成電路(蘇州)有限公司。
	盛凌投資股份有限公司	為本公司投資業務。
積體電路之買賣及技術服務	合泰半導體(中國)有限公司	為本公司推廣產品,建立大陸地區銷售網路及開拓市場,並協助客戶產品之應用及提供產品之售後服務。
	Holtek Semiconductor (USA), Inc.	
	金科集成電路(蘇州)有限公司	
單片機芯片及其應用工具的技術服務	芯群集成電路(廈門)有限公司	為本公司推廣 MCU 產品,建立中國地區 MCU 發展工具之銷售網路及開拓市場,並提供相關技術服務。
健康量測應用 IC 銷售及技術服務	Best Health Electronics Corporation	提供本公司健康量測方案系列產品,包括血糖儀、體脂計及血壓計等專用微控制器 IC。
	悠健電子(東莞)有限公司	
安防應用 IC 銷售及技術服務	Anchip Technology Corporation	提供本公司安防方案系列產品,包括感煙/感溫火災探測及 CO/GAS 探測等專用微控制器 IC。
	嘉芯安科技(深圳)有限公司	
RF 應用 IC 銷售及設計業務	盛通科技股份有限公司	提供本公司 RF 無線方案系列產品,包括 RF IC 及 RF+MCU 整合型 SoC。
	BestComm RF Electronics Inc.	
MCU 模組之銷售及技術服務	倍創科技股份有限公司	提供 MCU 模組銷售及技術服務,藉以擴大大公司 MCU 市場應用範圍。
觸控應用 IC 銷售及設計業務	優方科技股份有限公司	提供本公司觸控方案系列產品,包括標準觸控 IC、微控制器觸控 IC 以及各式高整合 SoC 微控制器觸控 IC。
	Best Solution Electronics Inc.	

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：106年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：吳啟勇	15,253,360	100%
	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：李佩縈		
Sigmos Holdings Ltd.	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：林正鋒	200,000	100%
	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：李佩縈		
MCU Holdings Ltd.	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：林正鋒	500,000	100%
	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：李佩縈		
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟		
盛凌投資股份有限公司	董事長	盛群半導體股份有限公司代表人：吳啟勇	40,000,000	100%
	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟		
	董事	盛群半導體股份有限公司代表人：李佩縈		
	監察人	盛群半導體股份有限公司代表人：李文德		
合泰半導體(中國)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟		
	董事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	蔡榮宗	--	--
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	董事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：李佩縈	2,000,000	100%
	董事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：蔡榮宗		
	總經理	王耀德	--	--
金科集成電路(蘇州)有限公司	董事長	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治		
	董事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈		
	監察人	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李修銘		
	總經理	李佩縈	--	--

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
芯群集成電路(廈門)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈		
	總經理	張家志	--	--
Best Health Electronics Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：李佩縈	4,800	80%
悠健電子(東莞)有限公司	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：李佩縈		
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：洪祥巖		
	監察人	Best Health Electronics Corporation 代表人：李文德		
	總經理	洪祥巖	--	--
AnchipTechnology Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：李佩縈	600	60%
嘉芯安科技(深圳)有限公司	董 事	AnchipTechnology Corporation 代表人：李佩縈	--	100%
	董 事	AnchipTechnology Corporation 代表人：周玲娜		
	董 事	AnchipTechnology Corporation 代表人：毛 強		
	監察人	AnchipTechnology Corporation 代表人：李文德		
	總經理	毛 強	--	--
盛通科技股份有限 公司	董事長	盛凌投資股份有限公司代表人：吳啟勇	4,000,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：李佩縈		
	監察人	盛凌投資股份有限公司代表人：李文德		
	總經理	李文義	--	--
BestComm RF Electronics Inc.	董 事	盛通科技股份有限有限公司代表人：吳啟勇	30,000	100%
	董 事	盛通科技股份有限有限公司代表人：李佩縈		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
倍創科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司代表人：吳啟勇	1,000,000	100%
	董事	盛凌投資股份有限公司代表人：高國棟		
	董事	盛凌投資股份有限公司代表人：李佩縈		
	監察人	盛凌投資股份有限公司代表人：李文德		
	總經理	葉秉霖	--	--
優方科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司代表人：吳啟勇	800,000	40%
	董事	盛凌投資股份有限公司代表人：李佩縈	737,500	36.875%
	董事	欣宏電子股份有限公司代表人：林既貴	212,500	10.625%
	監察人	新耕投資有限公司代表人：周玲娜	125,000	6.25%
	總經理	樂正平		
Best Solution Electronics Inc.	董事	優方科技股份有限公司代表人：李佩縈	200,000	100%

(六)關係企業營運概況

日期：106年12月31日

單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	475,831	732,091	216,424	515,667	726,703	(1)	28,316	1.86
芯群集成電路(廈門)有限公司	113,551	199,321	84,256	115,065	291,810	211	(419)	註 2
合泰半導體(中國)有限公司	292,423	479,614	182,241	297,373	543,072	28,434	28,510	註 2
Sigmos Holdings Ltd.	6,898	21,846	0	21,846	0	0	2,222	11.11
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	6,898	23,463	1,617	21,846	52,251	3,031	2,222	1.11
MCU Holdings Ltd.	16,333	550,257	0	550,257	0	(11)	80,727	161.45
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	69,542	121,653	0	121,653	0	0	2,740	1.37
金科集成電路(蘇州)有限公司	69,712	178,905	57,291	121,614	360,072	3,056	2,743	註 2
盛凌投資股份有限公司	400,000	437,515	39	437,476	0	(13)	33,140	0.83
優方科技股份有限公司	20,000	57,048	10,536	46,512	23,673	7,538	21,894	10.95
Best Solution Electronics Inc.	6,140	104,238	69,563	34,675	399,469	19,800	18,805	94.02
盛通科技股份有限公司	40,000	26,477	1,171	25,306	1,570	(4,326)	(5,079)	(1.27)
BestComm RF Electronics Inc.	14,054	12,873	2,230	10,643	6,228	(775)	(796)	(26.53)
倍創科技股份有限公司	10,000	9,955	19	9,936	47	(122)	(67)	(0.07)
Anchip Technology Corporation	5,071	3,396	558	2,838	2,312	(698)	(315)	(315.38)
嘉芯安科技(深圳)有限公司	1,521	1,451	135	1,316	5,930	376	377	註 2
Best Health Electronics Corporation	26,410	27,293	164	27,129	2,387	1,094	(108)	(18)
悠健電子(東莞)有限公司	23,057	22,521	1,154	21,367	1,461	(1,327)	(1,326)	註 2

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，106.12.31 兌美元 29.71；人民幣 4.5394。

註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。

(七)關係企業合併財務報表：

聲 明 書

本公司民國一〇六年度(自一〇六年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：盛群半導體股份有限公司



董事長：吳啟勇



中 華 民 國 一 〇 七 年 一 月 二 十 九 日

(八)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

盛群半導體股份有限公司



負責人：吳啟勇

